

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决策。

圣邦微电子(北京)股份有限公司

(北京市海淀区西三环北路72号院B座1608房间)



首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

(申报稿)

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐人(主承销商)



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次发行股数不超过 1,500 万股，本次发行的股份来源包括公司发行新股、公司股东公开发售股份。在公司股东实施公开发售股份的情形下，公司全体符合条件股东公开发售的股份数量总和不超过 375 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于 25%。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	【】元/股
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	不超过 6,000 万股
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。

一、本次发行的重要承诺

（一）发行人股东自愿锁定股份的承诺

1、公司控股股东鸿达永泰、公司股东宝利鸿雅、哈尔滨珺霖、弘威国际的承诺

自圣邦股份在中国境内首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的圣邦股份首次公开发行股票前已持有的股份，也不由圣邦股份回购该部分股份。

本公司持有的公司股份，如在锁定期满后两年内减持，每年转让的股份不超过自身所持有公司股份总数的 25%，减持价格不低于 A 股上市发行价（若圣邦股份股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；圣邦股份 A 股上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 A 股上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有圣邦股份的锁定期自动延长 6 个月。

2、公司其他股东盈富泰克、世纪维盛、荣基香港、金华添达、萨锐资本、盈华锐时、高迪达天、鹏成国际、青岛恒升、华扬兴业的承诺

自圣邦股份在中国境内首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业已经直接或者间接持有的圣邦股份的股份，也不由圣邦股份回购该部分股份。

3、公司董事、监事、高级管理人员的承诺

间接持有本公司股份并担任本公司董事、监事或高级管理人员等职务的张世

龙、张勤、林林承诺：

自圣邦股份在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已经持有的持股实体¹的股权/权益，也不由持股实体回购该部分股权/权益。

公司其他董事、监事、高级管理人员林明安、张绚、张海冰、赵媛媛、卞晓蒙、刘明承诺：

自圣邦股份在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已经持有的持股实体的股权/权益，也不由持股实体回购该部分股权/权益。

上述董事、监事、高级管理人员共同承诺：

锁定期满后，在本人在圣邦股份担任董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的持股实体股权/权益不超过本人所持有持股实体股权/权益总数的 25%，且在离职后的半年内不转让本人所持持股实体的股权/权益。

本人如在圣邦股份 A 股上市起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的持股实体股权/权益；如在圣邦股份 A 股上市起第 7 至 12 个月内申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的持股实体股权/权益。

（二）关于发行人各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、购回股份、赔偿损失承诺

公司承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

控股股东和实际控制人承诺，若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重

¹ 间接自然人股东用作持有发行人股份的公司制企业或合伙企业

大遗漏，对判断圣邦股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司发售的原限售股份。

圣邦股份控股股东和实际控制人、圣邦股份及其全体董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺，招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

（三）关于稳定公司股价的预案

为维护公众投资者的利益，公司及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺，公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一年度末经审计的每股净资产（上一年度末审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则公司将于第 20 个交易日收盘后启动稳定公司股价的措施并发出召开临时董事会的通知。

以上承诺的具体内容详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人的相关承诺”之“（三）稳定公司股价的预案”。

（四）公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

公司控股股东鸿达永泰、公司股东宝利鸿雅、哈尔滨珺霖、弘威国际承诺，“本公司/本企业在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持，每年减持股份数量不超过上一年末所持股份数量的 25%，减持价格不低于圣邦股份 A 股上市发行价（若圣邦股份股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），将在减持前 3 个交易日予以公告。

公司其余持股 5%以上的股东承诺，“本公司/本企业在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持，第一年减持股份数量不超过所持股份总数量的 50%，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的 100%（若圣邦股份股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。本公司/本企业将配合圣邦股份在本公司/本企业减持

前 3 个交易日公告减持计划，本公司/本企业持有圣邦股份的股份低于 5%以下时除外。”

（五）关于对承诺履行约束措施的承诺

1、公司承诺

“本公司，圣邦微电子（北京）股份有限公司，如果本公司在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：

- 1、及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
- 3、将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议；
- 4、如果因发行人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法向投资者赔偿相关损失：

（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司未履行相关承诺事项后 10 个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。

（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”

2、控股股东承诺

“本公司，北京鸿达永泰投资管理有限责任公司，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”）的控股股东，如果本公司在圣邦股份《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：

- 1、通过圣邦股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2、向圣邦股份及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

3、将上述补充承诺或替代承诺提交圣邦股份股东大会审议；

4、如果因本公司未履行相关承诺事项，所得收益将归属于圣邦股份，如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失：

（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司未履行相关承诺事项后 10 个交易日内，本公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。

（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”

3、董事、监事、高级管理人员承诺

“作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”）的董事/监事/高级管理人员，如果本人在圣邦股份《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：

1、通过圣邦股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向圣邦股份及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

3、将上述补充承诺或替代承诺提交圣邦股份股东大会审议；

4、如果因本人未履行相关承诺事项，所得收益将归属于圣邦股份，如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失：

（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定本人未履行相关承诺事项后 10 个交易日内，本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。

（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”

（六）本次发行相关机构的承诺

保荐人、发行人律师和发行人会计师均承诺，若因其为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直

接损失的，将依法赔偿投资者由此造成的损失。

以上承诺的具体内容详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人的相关承诺”之“（七）本次发行相关机构的承诺”。

二、本次发行上市后的股利分配政策

2015年6月25日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议并通过了公司上市之后生效的《公司章程（草案）》，对发行上市后的利润分配事项进行了明确规定。

“公司的利润分配，应遵守以下规定：

（一）公司利润分配政策的基本原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红方式，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司每年至少进行一次利润分配，每连续三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（二）公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期分红。

（三）差异化的现金分红政策

1、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。

3、公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3000 万元；

（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于公司当年度实现的可分配利润的 20%；

（4）中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。

满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

（四）公司发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

（五）公司利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根

据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

（六）利润分配方案应履行的审议程序：公司利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。公司利润分配方案由董事会拟定后应由董事会充分论证审议通过后提交股东大会审议批准，股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（七）利润分配政策决策具体机制：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经 1/2 以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事 1/2 以上表决通过，并发表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（八）公司因前述第（三）项规定的重大投资计划或重大现金支出的情形发生而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确认用途及预计投资收益等事项进行专项说明，在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（九）利润分配政策的调整：公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者公司外部经营环境发生重大变化，确需调整本章程规定

的现金分红政策时，董事会需就调整或变更利润分配政策的可行性进行充分论证，形成专项决议后，提交公司股东大会批准，股东大会审议时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，独立董事应当对此发表独立意见，监事会亦应对此发表意见。公司提出调整利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对股东利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明调整的原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（十）公司利润分配方案的实施：公司董事会须在股东大会批准后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。

（十一）公司利润分配方案的披露：

1、公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。公司董事会未做出年度现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可分配利润的 10%的，应当在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，监事会亦应对此发表意见。

2、公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。”

三、本次发行前未分配利润分配方案

公司于 2015 年 6 月 25 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》的议案：首次公开发行 A 股前公司合并报表范围内累积的滚存未分配利润由首次公开发行完成后的新老股

东共同享有。

四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

发行人、发行人控股股东和实际控制人、发行人持股 5%以上的股东、发行人全体董事、监事出具承诺：本次公开发行股票并在创业板上市后，公司将采取多种措施/本人将通过董事会/监事会表决投票，保证公司募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄，并承诺公司将通过 1、积极稳妥地推动募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力；2、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；3、加强技术研发和创新，增加公司持续竞争能力；4、根据公司发展目标积极推进发展战略，不断改善公司经营业绩；5、加强管理，合理控制成本费用支出；6、严格依据《公司章程（草案）》和《股东分红回报规划》等规定进行利润分配，在符合《公司章程（草案）》和《股东分红回报规划》规定的情形下，制定和执行持续稳定的现金分红方案，并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。

五、影响持续盈利能力的主要因素

对公司持续盈利能力产生影响的主要因素包括但不限于：公司保持持续创新的能力、供应商和客户目前较为集中、原材料及封测加工价格波动、市场竞争存在加剧可能性、税收优惠政策变化、汇率波动、募集资金投资项目管理和实施情况、外贸政策或环境发生变化等。同时公司在“第四节 风险因素”中对主要风险因素进行了分析和披露。

经核查，发行人的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大不利变化；发行人的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大不利变化；发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大不利变化；发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大依赖；发行人最近一年的净利润不存在主要来自合并财务报表范围以外的投资收益的情况。保荐机构认为：发行人具备持续盈利能力。

六、保持持续创新能力的风险

随着市场竞争的加剧以及终端客户对产品个性化需求的不断提高，模拟集成电路设计行业所涉及的技术不断更新换代，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为模拟集成电路设计企业核心竞争力中最重要的组成部分。只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，模拟集成电路企业才能获得较高的利润水平。但如果公司未来不能紧跟模拟集成电路开发技术的发展趋势，充分关注客户多样化的需求，不断拓展新的产品线，或者后续研发投入不足等，可能导致公司不能持续充足的提供适应市场需求的产品，进而导致产品毛利率不能稳步保持以获得足够的利润，公司则将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险。

七、供应商、客户较为集中的风险

公司的供应商较为集中，台积电、长电科技、通富微电和成都宇芯为公司的主要供应商，报告期内各期，公司向其采购金额分别为 14,334.95 万元、13,807.25 万元、22,034.41 万元和 5,542.51 万元，占同期采购金额的比例分别为 100.00%、100.00%、99.82%和 99.63%。其中，公司晶圆主要向台积电采购，报告期各期采购金额分别为 5,486.73 万元、5,329.40 万元、9,240.49 万元和 2,337.23 万元，占同期采购晶圆金额比例分别为 100.00%、100.00%、99.74%和 99.69%。尽管公司主要供应商均为行业内具备成熟工艺和产能充足的知名厂商，且公司已与供应商建立了持续稳定的合作关系，但仍不排除这些供应商因内外部原因而导致无法按时交货，从而对公司经营产生不利影响的可能性。

报告期内，公司已与北高智、茂晶、丰宝、棋港、新得利、赛博联等资深电子元器件经销商建立了长期稳定的合作伙伴关系。报告期内各期，公司向前五大客户合计销售金额分别为 14,947.54 万元、15,840.24 万元、20,144.69 万元和 4,881.41 万元，占同期营业收入的比例分别为 65.96%、63.57%、61.81%和 62.34%。如果目前主要客户的经营状况发生重大不利变化，将对公司经营业绩产生一定不利影响。

目 录

本次发行概况	2
发行人声明	3
重大事项提示	4
一、本次发行的重要承诺	4
二、本次发行上市后的股利分配政策	9
三、本次发行前未分配利润分配方案	12
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	13
五、影响持续盈利能力的主要因素	13
六、保持持续创新能力的风险	14
七、供应商、客户较为集中的风险	14
目 录	15
第一节 释 义	19
一、一般释义	19
二、专业术语释义	21
第二节 概 览	28
一、发行人简介	28
二、发行人控股股东和实际控制人简介	28
三、发行人主要财务数据及财务指标	29
四、募集资金用途	31
第三节 本次发行概况	32
一、本次发行的基本情况	32
二、本次发行的有关当事人	33
三、发行人与中介机构关系	34
四、本次发行有关重要日期	35
第四节 风险因素	36
一、保持持续创新能力的风险	36
二、供应商、客户较为集中的风险	36

三、原材料及封测加工价格波动风险.....	37
四、市场竞争加剧的风险	37
五、存货跌价风险	38
六、人力资源风险	38
七、知识产权风险	38
八、税收优惠政策变化的风险	39
九、核心技术泄密风险	39
十、汇率波动风险	40
十一、净资产收益率下降风险	40
十二、募集资金投资项目管理和实施风险.....	40
十三、资产规模迅速扩张带来的管理风险.....	41
十四、外贸政策或环境发生变化的风险.....	41
第五节 发行人基本情况	43
一、发行人设立情况	43
二、发行人海外上市红筹架构的搭建及解除情况.....	44
三、发行人自设立以来的重大资产重组情况.....	55
四、发行人股权关系及组织结构	56
五、发行人控股子公司及分公司情况.....	57
六、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.....	58
七、发行人股本情况	61
八、正在执行的股权激励及其他制度安排.....	63
九、发行人员工情况	63
十、发行人的相关承诺	64
第六节 业务和技术	71
一、发行人主营业务及其变化情况.....	71
二、公司所处行业的基本情况	82
三、行业竞争地位	98
四、公司主营业务情况	104
五、主要资产情况	109
六、技术与研发情况	118

七、特许经营权情况	123
八、境外经营情况	123
九、未来发展与规划	123
第七节 同业竞争与关联交易	127
一、同业竞争	127
二、关联方及关联交易	129
三、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见	131
第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理	133
一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况	133
二、董事、监事的提名与选聘情况	136
三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况	136
四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况	137
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况	137
六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议以及协议的履行情况 ..	138
七、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况	138
八、股东大会、董事会、监事会等机构和人员的运行情况	138
九、发行人内部控制制度情况	140
十、发行人报告内违法违规情况	140
十一、发行人近三年资金占用及担保情况	140
十二、发行人资金管理、对外投资、担保政策及执行情况	140
十三、投资者权益保护的相关措施	141
第九节 财务会计信息与管理层分析	143
一、财务报表	143
二、审计意见	147
三、主要会计政策和会计估计	147
四、主要税项	155
五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表	157
六、主要财务指标	158
七、盈利能力分析	159

八、财务状况分析	175
九、现金流量分析	192
十、期后事项、或有事项及其他重要事项.....	195
十一、股利分配情况	196
第十节 募集资金运用	201
一、本次募集资金投资项目计划	201
二、募集资金投资项目简介	202
第十一节 其他重要事项	211
一、重要合同	211
第十二节 有关声明	214
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	214
二、保荐人（主承销商）声明	215
三、发行人律师声明	216
四、会计师事务所声明	217
五、资产评估机构声明	218
六、验资复核机构声明	219
第十三节 附 件	221
一、备查文件	221
二、文件查阅时间	221
三、文件查阅地址	221

第一节 释 义

在本招股说明书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义：

一、一般释义

圣邦股份、公司、本公司、发行人	指	圣邦微电子（北京）股份有限公司
圣邦有限	指	圣邦微电子（北京）有限公司
香港圣邦	指	圣邦微电子（香港）有限公司
哈尔滨分公司	指	圣邦微电子（北京）股份有限公司哈尔滨分公司
Sea Fine	指	Sea Fine Consulting Limited，一家根据英属维尔京群岛法律组建的公司
SG Micro Limited	指	SG Micro Limited，一家根据开曼群岛法律组建的公司
哈尔滨圣邦	指	哈尔滨圣邦微电子有限公司
Best	指	Best Directions Limited，一家根据英属维尔京群岛法律组建的公司
Coretech	指	Coretech Investment Limited，一家根据英属维尔京群岛法律组建的公司
Infotech	指	Infotech Pacific Ventures L.P.，一家根据开曼群岛法律组建的有限合伙企业，后更名为 IPV Capital, L.P.
ComVentures	指	ComVentures VI L.P.，一家根据美国加利福尼亚州法律组建的合伙企业
Venture IV	指	Venture Lending & Leasing IV, LLC，一家根据美国特拉华州法律组建的公司
Venture V	指	Venture Lending & Leasing V, LLC，一家根据美国特拉华州法律组建的公司
WTI	指	Venture IV 与 Venture V 的合称，Venture IV 与 Venture V 均为 Western Technology Investment（WTI）管理的投资基金
鸿达永泰	指	北京鸿达永泰投资管理有限责任公司
哈尔滨珺霖	指	哈尔滨珺霖投资咨询有限公司
宝利鸿雅	指	北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司
弘威国际	指	Power Trend International Development Limited（弘威国际发展有限公司）
荣基香港	指	Honour Base (Hong Kong) Holdings Limited（荣基香港控股有限公司）
盈富泰克	指	IPV Capital I HK Limited（盈富泰克太平洋香港投资有

		限公司)
世纪维盛	指	CV VI Holding, Limited (世纪维盛控股有限公司)
华扬兴业	指	Bloom China Corporation Limited (华扬兴业有限公司)
萨锐资本、SPM、SPM Capital	指	SPM Capital, LLC (萨锐资本有限公司)
鹏成国际	指	Grand Fame International Limited (鹏成国际有限公司)
金华添达	指	北京金华添达投资管理中心 (有限合伙)
盈华锐时	指	北京盈华锐时投资管理中心 (有限合伙)
高迪达天	指	北京高迪达天投资管理中心 (有限合伙)
青岛恒升	指	青岛恒升广茂投资管理有限公司
鼎新成长	指	北京鼎新成长创业投资中心
BVI	指	The British Virgin Islands, 英属维尔京群岛
Cayman	指	The Cayman Islands, 开曼群岛
台积电、TSMC	指	台湾积体电路制造股份有限公司
联电、UMC	指	联华电子股份有限公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
长电先进	指	江阴长电先进封装有限公司
通富微电	指	南通富士通微电子股份有限公司
成都宇芯	指	宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司
中兴康讯	指	深圳市中兴康讯电子有限公司
中兴	指	中兴通讯股份有限公司
茂晶	指	茂晶有限公司, 包含了同一控制下的茂纶股份有限公司和深圳茂晶骏龙有限公司
茂纶	指	茂纶股份有限公司
新得利	指	新得利电子零件有限公司, 包含了同一控制下的深圳市新得时利电子科技有限公司
丰宝	指	丰宝贸易香港有限公司, 包含了同一控制下的上海市丰宝电子科技有限公司
北高智	指	北高智科技有限公司
棋港	指	棋港电子有限公司
赛博联	指	赛博联电子有限公司, 包含了同一控制下的深圳市赛博联电子有限公司
科通	指	科通国际(香港)有限公司, 包含了同一控制下的科通通信技术(深圳)有限公司
威健	指	威健实业国际有限公司, 包含了同一控制下的威健国际贸易(上海)有限公司
帕太	指	帕太集团有限公司, 包含了同一控制下的帕太国际贸易(上海)有限公司
品佳	指	品佳股份有限公司
德州仪器、TI	指	美国德州仪器有限公司 (Texas Instruments, Inc.)

STM	指	意法半导体股份有限公司（ST Microelectronics N.V.）
ADI	指	美国亚德诺半导体技术有限公司（Analog Devices, Inc.）
Infineon	指	德国英飞凌科技股份公司（Infineon Technologies AG）
Maxim	指	美国美信集成产品公司（Maxim Integrated Products, Inc.）
NXP	指	恩智浦半导体有限公司（NXP Semiconductors N.V.）
Linear	指	美国凌力尔特公司（Linear Technology Corporation）
Renesas	指	日本瑞萨电子公司（Renesas Electronics Corporation）
Qualcomm	指	美国高通公司（Qualcomm）
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
CSIA	指	中国半导体行业协会
Global Sources	指	香港环球资源媒体公司
CCID	指	赛迪顾问股份有限公司
本次发行	指	本公司本次申请在深圳证券交易所创业板发行并上市的行为
保荐人（主承销商）	指	中信证券股份有限公司
发行人律师、公司律师	指	北京市君合律师事务所
发行人会计师、致同、京都天华、审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙），原名为京都天华会计师事务所有限公司
《公司章程》	指	发行人现行有效的《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	发行人完成本次发行后适用的《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《创业板暂行办法》	指	《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
近三年及一期、报告期	指	2012年、2013年、2014年、2015年1-3月
元、万元	指	人民币元、万元

二、专业术语释义

芯片、集成电路、IC	指	是一种微型电子器件或部件，是采用一定的半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、
------------	---	---

		电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起，组合成完整的电子电路，并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。IC 是集成电路（Integrated Circuit）的英文缩写。
模拟芯片	指	处理连续性模拟信号的集成电路芯片被称为模拟芯片。模拟信号是指用电参数，如电流和电压的值，来模拟其他自然量而形成的电信号，模拟信号在给定范围内通常表现为连续的信号。模拟芯片可以作为人与设备沟通的界面，并让人与设备实现互动，是连接现实世界与数字虚拟世界的桥梁，也是实现绿色节能的关键器件。
晶圆	指	又称 Wafer、圆片、晶片，用以制造集成电路的圆形硅晶体半导体材料。
集成电路设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制和验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程。
集成电路封装	指	把晶圆上的半导体集成电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用。集成电路封装不仅起到集成电路芯片内键合点与外部进行电气连接的作用，也为集成电路芯片提供了一个稳定可靠的工作环境，对集成电路芯片起到机械或环境保护的作用，从而使集成电路芯片能够发挥正常的功能，并保证其具有高稳定性和可靠性。
集成电路测试	指	集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作。
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大规模地制造芯片；反之，则需找出其中的原因，并进行相应的优化设计——上述过程一般称之为工程试作流片。在工程试作流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片。
RoHS 标准	指	欧盟制定的《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》，要求产品中不含对人体有害的 4 种重金属和 2 种阻燃剂。
REACH 标准	指	欧盟制定的《关于化学品注册、评估、许可和限制法规》。
IDM	指	垂直整合制造企业。指企业经营范围涵盖集成电路设计、制造、封装测试、销售等各环节。有时也代指此

		种商业模式。
Fabless	指	无生产线设计企业。指企业只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成。有时也代指此种商业模式。
Foundry	指	晶圆代工厂。
光罩	指	又称光掩模（英文称为：Mask、Photomask 或 Reticle），是生产晶圆（晶片）的模具。光罩是根据芯片设计公司设计的集成电路版图来生产制作的，一套光罩按照芯片的复杂程度通常有几层到几十层不等，晶圆制造商根据制作完成的光罩进行晶圆生产。
3C	指	计算机、网络通信、消费类电子。
RF 芯片、射频芯片	指	用于收发和处理无线电射频信号的芯片，其功能包括射频收发、频率合成、功率放大等。RF 是 Radio Frequency 的缩写。
DSP	指	Digital Signal Processing，数字信号处理，是一种通过使用数学技巧执行转换或提取信息，来处理现实信号的方法。
输入失调电压	指	使输出电压为对应输入电压的规定值时，两输入端之间在输入电压之外所附加的直流补偿电压，通常用 "Vos" 表示。
静态电流	指	在没有驱动负载、输入没有周期性循环的状态下，器件的电流损耗。
工作电压	指	芯片正常工作所需要的电压。
信号链	指	参与从信号的接收、放大、转换、传输、发送，一直到对相应功率器件产生执行的一整套信号流程中的所有相关部分。
电源管理	指	具有对电源进行监测、保护以及将电源有效分配给系统等功能的组件。电源管理对于依赖电池电源的移动式设备至关重要，可有效延长电池使用时间及寿命。
电源管理单元（PMU）	指	一种高度集成的电源管理方案，即将传统分立的若干类电源管理器件整合在单个的封装之内，以实现更高的电源转换效率和更低的功耗，以及更少的组件数以节省空间，多用于便携式电子产品中。
运算放大器、运放	指	具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中，通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中，用以实现数学运算，故得名“运算放大器”，简称“运放”。运放是一个从功能的角度命名的电路单元，可以由分立的器件实现，也可以实现在半导体芯片当中。运放种类繁多，广泛应用于

		各种电子设备中。
音频放大器	指	将低功率音频信号放大到合适的水平，用于驱动扬声器的电子放大器，又称音频功率放大器。它通常是一个典型的音频播放系统的最后一级即输出级。
视频驱动器	指	对视频信号进行滤波、放大并起到隔离输出作用的芯片。
数据转换	指	将数据从一种表现形式变为另一种表现形式的过程，如将数字信号转换成模拟信号，反之亦然。
线性稳压器	指	电压稳压器，既放置在电源和负载间，通过改变其有效电阻进而改变固定输出电压的器件。线性稳压器具有成本低、封装小、外围器件少和噪声小的特点。
接口电路	指	专门用于设备和设备之间、电路板和电路板之间以及芯片组和芯片组之间进行信号连接的电路。
用户界面	指	实现人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。
DC/DC 转换器	指	将一个直流电源转换成不同电压或电流的直流电源的转换器。广泛应用于通讯、消费类电子、电力银行、便携式电子设备等。DC/DC 转换器通常分为三类：升压型 DC/DC 转换器、降压型 DC/DC 转换器以及升降压型 DC/DC 转换器。
CPU 电源监测电路	指	对 CPU（或微处理器）电源情况进行监测，并当因某种原因使电源异常而可能导致 CPU 功能不稳定时，使 CPU 停止工作并重置系统，防止系统执行错误指令的电路。
锂电池充电管理芯片	指	对锂电池充电过程进行监测、管理及保护的器件。一般具有减少充电时间、电池温度监测、自动重新充电、最小电流终止充电、低功耗睡眠等功能特性。
微处理器	指	用一片或少数几片大规模集成电路组成的、微缩的处理器。这些电路执行控制部件和算术逻辑部件的功能。
存储器	指	电子系统中的记忆设备，用来存放程序和数据。例如计算机中全部信息，包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中。它根据控制器指定的位置存入和取出信息。
标准通用逻辑电路	指	一种经由标准化组织认定的、对离散信号传递和处理，以二进制为原理、实现数字信号逻辑运算和操作的电路，分组合逻辑电路和时序逻辑电路。
微控制器（MCU）	指	将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上、通常以执行某个控制功能为目的而设计的单芯片微型计算机。
专用 IC（ASIC）	指	一种为专门目的而设计的专用集成电路（Application

		Specific Integrated Circuit)。即应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。
物联网	指	一个动态的全球网络基础设施，它具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合。
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。
半导体照明	指	利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，可以发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
GPS	指	全球卫星定位系统的简称，指利用 GPS 定位卫星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统。
驱动电路	指	主电路和控制电路之间，用来对控制电路的信号进行放大的中间电路（即放大控制电路的信号使其能够驱动下一级电路或器件）。可为被驱动器件提供稳定工作环境，并可通过控制被驱动器件电流大小或开关速度等手段，来实现被驱动器件的控制。
LED 背光	指	以 LED 为发光源，从侧边或是背后照射到显示器件背后的一种照明的形式，常被用于 LCD 显示上。其作用在于为透射式显示元件提供光源，例如为电脑液晶显示器和手机显示屏提供光源。用 LED（发光二极管）来作为液晶显示屏的背光源，和传统的 CCFL（冷阴极管）背光源相比，LED 背光源具有低功耗、低发热量、亮度高、寿命长等特点。
开关电源芯片	指	通过控制开关管开通和关断的时间比率，维持稳定输出电压的一种电源类芯片。其利用电子开关器件（如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等），通过控制电路，使电子开关器件不停地“接通”和“关断”，让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制，借助外部储能原件实现 AC/DC、DC/DC 电压变换，通常具有输出电压可调和自动稳压功能。
电压基准芯片	指	是一类高性能模拟芯片，常用在各种数据采集系统中实现高精度数据采集。理想的基准电压源应不受电源和温度的影响，在电路中能提供稳定的电压，“基准”这一术语说明基准电压源的电压值应比一般电源具有更高的精度和稳定性。根据内部基准电压产生结构不同，电压基准分为：带隙电压基准和稳压管电压基准两类。
电力银行	指	即便携式充电器，指的是一种将交流电转换为低压

		直流电的设备，采用电力电子半导体器件，将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。可随时随地为采用电池供电的电子产品充电，通常带有各种充电接口。
PCB 板	指	印制电路板，又称印刷电路板，是电子元器件电气连接的提供者。
信噪比（SNR）	指	又称讯噪比，即信号与同时输出的噪声功率的比，常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明噪声越小。
电源抑制比（PSRR）	指	输入电源变化量（以伏为单位）与输出变化量（以伏为单位）的比值，常用分贝表示。
BCD 工艺	指	一种单片集成工艺技术。这种技术能够在同一芯片上制作双极性晶体管 Bipolar、CMOS 和 DMOS 器件。
EMI	指	电磁干扰。电磁干扰分为传导电磁干扰（Conducted EMI）、耦合电磁干扰（Coupling EMI）和辐射电磁干扰（Radiated EMI）。
TSOT	指	Thin Small Outline Transistor 小外形晶体管，采用小外形封装结构的表面组装晶体管。是一种表面贴装的封装形式。
TQFN	指	Thin Quad Flat No Leads，是 QFN 封装的一种，厚度较薄，全称薄型无引线四边扁平封装。
DFN	指	Dual Flat No Leads，全称无引线双边扁平封装。
Pop-Click	指	在电子产品上电、掉电或关断时产生的一种噪声。
增益带宽积	指	既有源器件或电路的增益与规定带宽的乘积，是用来简单衡量某些放大器性能的一个参数。
电压转换速率	指	压摆率。其定义是快速的大信号输入时，在输出观察到的、与输入信号幅度和速度几乎无关的、在单位时间（1 微秒或 1 纳秒等）里电压变化的幅度，单位通常有 V/s，V/ms，V/ μ s 和 V/ns 四种。电压转换速率用示波器就可以测量。
导通电阻	指	PN 结或器件在导通时 PN 结或通路上观测到的电阻。
电荷泵	指	开关电容式电压变换器，是一种利用所谓的“飞”（flying）或“泵送”电容（而非电感或变压器）来储能的 DC/DC（变换器）。它们能使输入电压升高或降低，也可以用于产生负电压。
看门狗功能	指	一种防止程序跑飞的功能。一般由定时器电路实现，该定时器又称看门狗定时器。在由单片机构成

		的微型计算机系统中，由于单片机的工作常常会受到干扰，造成程序的跑飞，而陷入死循环，造成系统无法继续工作，使整个系统陷入停滞状态，所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑，便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的芯片即“微处理器电源监控芯片”。具有当软件陷入死循环时中断微处理器功能的微处理器电源监控芯片，俗称“看门狗”或具有“看门狗”功能。
EDA	指	Electronic Design Automation，电子设计自动化。

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

（一）发行人概况

公司前身为圣邦有限，圣邦有限于 2007 年 1 月 26 日成立，于 2012 年 5 月 24 日整体变更为股份有限公司，注册资本为 4,500 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司注册资本为 4,500 万元。

（二）主营业务概况

公司主营业务为模拟芯片的研发和销售。

公司自成立以来一直专注于模拟芯片的研发和销售，主要产品为高性能模拟芯片，覆盖信号链和电源管理两大领域，拥有 600 多款可供销售产品，可广泛应用于通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等众多领域，终端客户近千家。

二、发行人控股股东、实际控制人简介

（一）控股股东

截至 2015 年 6 月 30 日，鸿达永泰持有公司股份 12,661,068 股，持股比例 28.13%，为公司控股股东。鸿达永泰具体情况如下：

成立时间	2011 年 3 月 17 日	主要生产经营地	北京
注册资本	100,000 元	实收资本	100,000 元
股东结构	张世龙持股 100%		

住所	北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦二十层 2007 室
主营业务	股权投资

（二）实际控制人

公司实际控制人为张世龙先生。张世龙、张勤、林林、Wen Li、鸿达永泰（张世龙 100%持股公司）、宝利鸿雅（张勤 100%持股公司）、哈尔滨珺霖（林林 100%持股公司）、弘威国际（Wen Li 100%持股公司）签署了一致行动协议，支持和巩固张世龙的控制权，宝利鸿雅、哈尔滨珺霖和弘威国际为鸿达永泰的一致行动人，于其持有圣邦股份期间，在股东大会行使股东的表决权、向董事会及股东大会行使提案权、行使董事、独立董事及监事候选人提名权等有关经营决策事项时作出与鸿达永泰相同的意思表示，保持一致行动，即不作出与鸿达永泰意思表示相悖或弃权的意思表示，促使并保证所推荐的董事人选在圣邦股份的董事会行使表决权时，与鸿达永泰采取相同的意思表示。张世龙、张勤、林林、Wen Li 通过其持股公司鸿达永泰、宝利鸿雅、哈尔滨珺霖、弘威国际合计持有公司 61.17%股权。

张世龙先生，1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士学位。曾任铁道部专业设计院工程师、德州仪器工程师、哈尔滨圣邦总经理、圣邦有限董事长兼总经理。2012 年 4 月至今，任圣邦股份董事长、总经理。

三、发行人主要财务数据及财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总额	28,305.36	27,751.49	22,138.31	20,729.33
负债总额	7,936.00	8,389.35	5,417.46	4,658.91
归属于母公司所有者的权益	20,369.36	19,362.14	16,720.85	16,070.42
股东权益合计	20,369.36	19,362.14	16,720.85	16,070.42

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
营业收入	7,830.09	32,591.47	24,917.03	22,661.31
营业利润	1,192.98	6,520.89	5,150.12	4,884.33
利润总额	1,192.98	6,899.58	5,370.62	4,933.48
净利润	982.48	6,231.77	4,806.82	4,698.20
归属于母公司的净利润	982.48	6,231.77	4,806.82	4,698.20
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	982.48	5,905.00	4,619.40	4,652.74

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
经营活动产生的现金流量净额	-138.80	7,446.15	6,210.78	5,234.94
投资活动产生的现金流量净额	-20.14	-684.90	-596.79	-753.16
筹资活动产生的现金流量净额	498.20	-3,221.00	-3,856.80	-1,388.62
现金及现金等价物净增加额	378.25	3,566.32	1,514.42	3,076.95

(四) 主要财务指标

主要财务指标	2015年1-3月 /2015.3.31	2014年/ 2014.12.31	2013年/ 2013.12.31	2012年/ 2012.12.31
资产负债率（合并）	28.04%	30.23%	24.47%	22.47%
流动比率	4.09	3.52	4.28	4.51
速动比率	3.08	2.74	3.51	3.52
应收账款周转率	5.84	16.52	12.72	10.93
存货周转率	0.75	4.10	3.43	3.23
息税折旧摊销前利润（万元）	1,262.26	7,140.89	5,565.05	5,132.53
利息保障倍数	663.85	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.03	1.65	1.38	1.16
每股净现金流量（元）	0.08	0.79	0.34	0.68

主要财务指标	2015年1-3月 /2015.3.31	2014年/ 2014.12.31	2013年/ 2013.12.31	2012年/ 2012.12.31
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	4.53	4.30	3.72	3.57
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例	0.89%	1.07%	1.59%	1.10%

四、募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后，将运用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额 （万元）	项目核准批文号
1	电源管理类模拟芯片开发及产业化项目	13,969	京海淀发改（备） [2015]104号
2	信号链类模拟芯片开发及产业化项目	14,399	京海淀发改（备） [2015]105号
3	研发中心建设项目	6,099	京海淀发改（备） [2015]103号
	合计	34,467	-

若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类：	人民币普通股（A 股）
每股面值：	1.00 元
发行股数、股东公开发售股份，占发行后总股本的比例	本次发行股数不超过 1,500 万股，本次发行的股份来源包括公司发行新股、公司股东公开发售股份。在公司股东实施公开发售股份的情形下，公司全体符合条件股东公开发售的股份数量总和不超过 375 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于 25%。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
发行价格：	【】元/股，通过向询价对象询价确定发行价格
发行市盈率：	【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产：	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产：	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率：	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式：	网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他发行方式
发行对象：	符合我国法律和法规规定的所有投资者
承销方式：	余额包销
募集资金总额：	【】万元
募集资金净额：	【】万元
发行费用概算：	共【】万元，其中承销及保荐费【】万元，审计费【】万元，律师费【】万元，发行手续费及股票登记费等约【】万元
发行费用分摊原则	本次发行的承销费由公司及各公开发售股份的股东分别承担，本次新股公开发行承销费用由公司承担，股东公开发售股份的承销费由参与公开发售的股东按照其各自公开发售股份

	数量的比例分别承担；其他费用由公司承担
--	---------------------

二、本次发行的有关当事人

（一）发行人：圣邦微电子（北京）股份有限公司

法定代表人：张世龙

住所：北京市海淀区西三环北路 72 号院 B 座 1608 房间

联系电话：010-51799720

传真：010-51798175

联系人：张勤

（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：010-60838709

传真：010-60836960

保荐代表人：黄苍、孙毅

项目协办人：马孝峰

项目其他经办人：彭捷、肖云都、张楠

（三）发行人律师：北京市君合律师事务所

负责人：肖微

住所：北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层

联系电话：010-85191300

传真：010-85191350

经办律师：石铁军、姜慧芳、金奂佶

（四）审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：徐华

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

联系电话：010-85665711

传真：010-85665020

经办注册会计师：李惠琦、傅智勇

（五）资产评估机构：北京京都中新资产评估有限公司

法定代表人：蒋建英

住所：北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 5 层

联系电话：010-85665881

传真：010-85665330

经办注册评估师：潘仕文、马涛

（六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

联系电话：0755-88668888

（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（八）保荐人（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行

三、发行人与中介机构关系

截至 2015 年 6 月 30 日，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级

管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行有关重要日期

发行安排	日期
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

第四节 风险因素

投资者在评价本次发行及做出投资决定时，除本招股说明书已披露的其他信息外，应慎重考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或有可能影响投资决策的程度进行排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生：

一、保持持续创新能力的风险

随着市场竞争的加剧以及终端客户对产品个性化需求的不断提高，模拟集成电路设计行业所涉及的技术不断更新换代，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为模拟集成电路设计企业核心竞争力中最重要的组成部分。只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，模拟集成电路企业才能获得较高的利润水平。但如果公司未来不能紧跟模拟集成电路开发技术的发展趋势，充分关注客户多样化的需求，不断拓展新的产品线，或者后续研发投入不足等，可能导致公司不能持续充足的提供适应市场需求的产品，进而导致产品毛利率不能稳步保持以获得足够的利润，公司则将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险。

二、供应商、客户较为集中的风险

公司的供应商较为集中，台积电、长电科技、通富微电和成都宇芯为公司的主要供应商，报告期内各期，公司向其采购金额分别为 14,334.95 万元、13,807.25 万元、22,034.41 万元和 5,542.51 万元，占同期采购金额的比例分别为 100.00%、100.00%、99.82%和 99.63%。其中，公司晶圆主要向台积电采购，报告期各期采购金额分别为 5,486.73 万元、5,329.40 万元、9,240.49 万元和 2,337.23 万元，占同期采购晶圆金额比例分别为 100.00%、100.00%、99.74%和 99.69%。尽管公司主要供应商均为行业内具备成熟工艺和产能充足的知名厂商，且公司已与供应商建立了持续稳定的合作关系，但仍不排除这些供应商因内外部原因而导致无法按时交货，从而对公司经营产生不利影响的可能性。

报告期内，公司已与北高智、茂晶、丰宝、棋港、新得利、赛博联等资深电子元器件经销商建立了长期稳定的合作伙伴关系。报告期内各期，公司向前五大客户合计销售金额分别为 14,947.54 万元、15,840.24 万元、20,144.69 万元和 4,881.41 万元，占同期营业收入的比例分别为 65.96%、63.57%、61.81%和 62.34%。如果目前主要客户的经营状况发生重大不利变化，将对公司经营业绩产生一定不利影响。

三、原材料及封测加工价格波动风险

晶圆和封测成本是公司报告期内成本的主要构成部分，占成本的比重超过 95%，其中晶圆采购成本占比约为 35%，封测成本占比约为 60%。

晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术水准及资金规模的要求极高，专业晶圆制造商的选择有限，导致公司原材料供应渠道较为集中，公司与全球知名晶圆制造商台积电建立了长期稳定的合作关系，如果未来公司向其采购晶圆的价格发生较大波动将导致公司采购成本波动，并对公司的经营业绩造成影响。

公司根据行业内封装厂的特点，从中择优选择性价比高的封测厂商，并通过版图设计改进、优化封装测试程序、选择最优封装类型来降低总体封测成本，但封测成本仍将作为公司最主要的成本之一，如果未来封测厂商的加工收费发生较大波动将导致公司采购成本波动，并对公司的经营业绩造成影响。

四、市场竞争加剧的风险

模拟集成电路行业正快速发展，良好的前景吸引了诸多国内企业试图进入这一领域，行业内厂商则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。虽然公司具备较强的创新能力和研发实力，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但与国际大型模拟芯片厂商相比，仍然存在一定差距。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和产品创新，不能有效扩大销售

规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。

五、存货跌价风险

公司存货由原材料、在产品和库存商品构成。报告期内各期末，公司存货分别为 4,246.21 万元、3,719.02 万元、5,751.64 万元和 6,560.50 万元，占总资产的比例分别为 20.48%、16.80%、20.73%和 23.18%，报告期内各期末的存货跌价准备余额分别为 856.38 万元、856.47 万元、950.34 万元和 1,029.26 万元。由于模拟芯片的终端产品不断推陈出新，模拟芯片技术也在不停迭代更新，公司产品线种类也随之不断丰富。随着公司业务规模的不断扩大及存货余额的增加，公司的存货存在跌价上升的风险。

六、人力资源风险

集成电路设计行业属于知识密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力之一。公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，以及经验丰富的生产管理和市场销售团队，这是公司保持持续创新、高效运营、市场优势的基石。如果公司不能建立和保持有效的员工激励制度、完善的职业发展规划体系和优良的企业文化，将导致公司无法吸引到所需的高端人才，甚至导致公司核心骨干人员流失，对公司经营发展造成不利的影响。

七、知识产权风险

公司一直坚持自主创新的研发策略，自成立以来先后在信号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片等核心技术上取得了较大突破，已形成完整的技术体系和产业化体系，是国内目前在高性能模拟芯片领域掌握自主核心技术且产品线覆盖面相对较广的芯片设计企业。虽然已采取严格的知识产权保护措施，但公司仍面临知识产权风险，包括自身知识产权被侵犯的风险和侵犯他人知识产权的风险。对于前者，公司采取持续创新和法律手段相结合的方式保护自身的合法权益；对于

后者，公司一直坚持自主研发，避免侵犯他人知识产权。但仍不能排除关键技术被竞争对手模仿的可能性，以及竞争对手在知识产权方面恶意起诉的可能性。

八、核心技术泄密风险

如果公司关键技术外泄、被窃取或被竞争对手模仿将会对公司经营稳定性造成影响，该等技术的保密工作是公司保持稳定经营和技术优势的重要保证。公司积极采取各项技术保密和保护措施：如制定《保密制度》，与所有员工签订《信息保密和创造归属确认书》，申请专利权和集成电路布图设计登记证书等，严密防范加工过程中的技术泄露。但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流，如果出现核心技术外泄或者核心技术人员外流的情况，将对公司的技术创新和业务发展产生一定的负面影响。

九、税收优惠政策变化的风险

根据北京市海淀区国家税务局《关于对圣邦微电子（北京）有限公司申请享受高新技术企业所得税减免税问题的批复》（海国税减免外字[2008]第 4008 号），公司从 2007 年起减按 15 % 缴纳企业所得税，2007 至 2009 年免缴企业所得税，2010 年至 2012 年减半缴纳企业所得税。

公司于 2009 年 6 月 12 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局认定为高新技术企业，公司于 2012 年通过了高新技术企业复审，并于 2012 年 5 月 24 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，编号为 GF201211000015，有效期三年，在此期间减按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。圣邦股份 2012 年按照 7.5% 征收企业所得税，2013 年和 2014 年执行 15% 的税率。

如果按法定企业所得税税率 25% 计算，公司 2012 年-2014 年享有的企业所得税税收优惠金额分别为 909.17 万元、376.20 万元和 445.22 万元，占当期利润总额的比例分别为 18.43%、7.00% 和 6.45%。2015 年 5 月发行人高新技术企业证

书到期，若公司将来未能通过高新技术企业审查，将对公司经营业绩产生一定影响。

十、汇率波动风险

公司的海外业务基本采用美元作为结算货币。按照行业惯例，公司主要将产品销售到电子元器件传统集散地之一的香港，晶圆主要向台积电采购，通常采用美元结算。报告期内各期，公司美元采购金额占当期采购金额比例分别为 61.17%、60.28%、66.42%和 66.67%，美元销售金额占当期销售比例分别为 93.58%、91.25%、92.00%和 88.16%；公司因结算货币升值导致的汇兑损失分别为 26.43 万元、154.80 万元、-25.85 万元和-19.10 万元，占同期利润总额的比例分别为 0.54%、2.88%、-0.37%和-1.60%。如果未来人民币对美元的汇率波动加大，公司将面临着一定的汇率波动风险。

十一、净资产收益率下降风险

报告期内各期，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）分别为 32.31%、28.76%、33.28%和 4.95%。本次发行完成后，公司净资产规模将大幅度提高。由于募集资金投资项目实施需要一定时间，在项目建成投产后才能逐步达到预计的收益水平，且预计经营期各期，电源管理类及信号链类芯片开发及产业化项目每年的折旧、摊销金额超过 1,000 万元，因此，短期内公司净资产收益率存在下降的风险。

十二、募集资金投资项目管理和实施风险

本次募集资金的投资项目将使公司开发投入及资产规模大幅增加，将涉及工程管理、设备安装、人员招聘与培训、新产品研发等多项内容，对公司的募集资金投资项目的组织和管理提出了较高要求，任何环节的疏漏或不到位都会对募集资金投资项目的按期实施及正常运转产生重要影响。

本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等

因素，并结合公司多年的经营经验而做出的。如果募集资金不能及时到位，或者项目具体建设过程中遇到技术障碍、投资成本变化及客户需求变化及其它不可控因素的影响，将可能导致本次募投项目不能顺利实施或者如期完成，并对公司生产经营和业绩产生一定影响。

十三、资产规模迅速扩张带来的管理风险

近年来，公司业务规模不断扩大，积累了丰富的、适合自身特点的经营管理经验，完善了公司治理结构，内控制度和体系更加完善、合理、有效。本次发行后，随着公司未来规模的迅速扩大，公司经营管理和风险控制难度将随之增加。如公司经营管理的水平、资源整合的步伐、市场开拓的能力和风险控制的力度无法满足资产规模扩大后的更高要求，将对公司的生产经营和业绩提升产生一定的障碍。

十四、外贸政策或环境发生变化的风险

目前，我国大力支持电子元器件产品的出口，实行鼓励的税收政策，包括：（1）免征出口关税；（2）实行出口增值税免抵退政策。报告期内收到的出口退税额分别为 1,228.67 万元，1,634.90 万元，1,667.91 万元和 607.49 万元。目前来看，这些政策在可预期的时间内是稳定且持续的。但若这些出口政策发生不利变化，虽然公司具有较强的产品议价能力，但是业务经营也可能受到一定的影响，进而可能对公司的财务状况和经营情况产生影响。

公司产品主要出口地为香港和台湾，这些地区一向采取自由贸易政策，基本无贸易壁垒。但若未来这些地区贸易政策发生变化，将对公司业务经营产生一定的影响。

十五、产品质量风险

模拟芯片产品的质量是公司竞争的基础。若产品质量不合格或达不到客户要求，可能导致客户不验收或公司无法收到销售款，造成投入损失和客户流失。虽

然本公司已经建立了一整套严格的质量控制体系并严格执行，但由于模拟产品的高度复杂性，公司无法完全避免产品的错误和缺陷，仍可能因此对公司的品牌形象造成影响，导致客户流失，进而对公司经营发展产生不利影响。

第五节 发行人基本情况

中文名称：圣邦微电子（北京）股份有限公司

英文名称：SG Micro Corp

注册资本：4,500 万元

登记注册号：110000410307053

法定代表人：张世龙

成立日期：2007 年 1 月成立，2012 年 5 月整体变更为股份公司

住 所：北京市海淀区西三环北路 72 号院 B 座 1608 房间

邮政编码：100048

信息披露部门：证券部

信息披露负责人：张勤

联系电话：010-51799720

传 真：010-51798175

公司网址：www.sg-micro.com

电子邮箱：investors@sg-micro.com

一、发行人设立情况

公司由圣邦有限整体变更设立。

（一）发行人前身设立情况

公司前身系成立于 2007 年 1 月 26 日的圣邦有限。圣邦有限系由 Sea Fine 以货币出资发起设立，注册资本为 200 万美元。

2007 年 1 月 15 日，中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于外资企业“圣邦微电子（北京）有限公司”章程的批复》，同意圣邦有限设立。2007 年 1 月 25 日，公司取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2007 年 1 月 26 日，北京市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。

（二）股份公司设立情况

2011 年 12 月 29 日，北京市商务委员会出具《北京市商务委员会关于圣邦微电子（北京）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，批准圣邦有限以 2011 年 11 月 30 日为基准日，按照经京都天华审计的净资产 91,497,573.00 元，以 1:0.4918 的比例折合为 4,500 万股，整体变更设立为股份有限公司。2012 年 5 月 24 日，北京市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。

二、发行人海外上市红筹架构的搭建及解除情况

为实现境外融资及上市，公司 2007 年开始搭建海外红筹架构，后期公司改变海外上市计划，于 2011 年开始对红筹架构进行调整。

（一）发行人海外上市红筹架构的搭建

1、Coretech Investment Limited（BVI）的设立

Coretech Investment Limited 设立于 2007 年 1 月 4 日，由注册代理公司 CIA Nominees Ltd.发起设立，发行股份 1 股，每股面值为 1 美元。2007 年 1 月 8 日，Coretech Investment Limited 回购了 CIA Nominees Ltd.的 1 股股份，并向张世龙等发行 2,692,307.70 股，每股面值 0.01 美元，发行后股权结构如下：

股东名称	股 份	股权比例
张世龙	1,509,038.50	56.05%
张 勤	421,346.20	15.65%
林 林	511,538.40	19.00%
Cong Wang（新西兰籍）	125,192.30	4.65%
Anmei Shen（新西兰籍，与 Cong Wang 为夫妻关系）	99,615.40	3.70%
汤涵宇（台湾籍）	6,461.50	0.24%
林哲伟（台湾籍）	19,115.40	0.71%
合 计	2,692,307.70	100.00%

2、SG Micro Limited（Cayman）的设立

SG Micro Limited 设立于 2006 年 12 月 12 日，由注册代理公司 N.D. Nominees

Ltd.发起设立，发行股份 1 股，每股面值 0.001 美元。设立当日，N.D. Nominees Ltd.将其持有的 SG Micro Limited 1 股普通股转让给 CIA Nominees Ltd. 2007 年 1 月 8 日，CIA Nominees Ltd.将其持有的 SG Micro Limited 1 股普通股转让给 Coretech，同时 SG Micro Limited 向 Coretech 新发行 26,923,077 股普通股股份，发行后股权结构如下：

股东名称	股 份	股权比例
Coretech	26,923,077	100.00%
合 计	26,923,077	100.00%

3、Best Directions Limited（BVI）公司的设立

Best Directions Limited 设立于 2006 年 10 月 31 日，由注册代理公司 CIA Nominees Ltd.发起设立，发行股份 1 股，每股面值 1 美元。2007 年 9 月 7 日，Best 回购了 CIA Nominees Ltd.的 1 股股份，并向张世龙发行 50,000 股股份，每股面值为 1 美元。本次股权变更后 Best 股权结构如下：

股东名称	股份	股权比例
张世龙	50,000	100.00%
合 计	50,000	100.00%

4、Sea Fine Consulting Limited（BVI）的设立

Sea Fine Consulting Limited 设立于 2006 年 9 月 28 日，由注册代理公司 CIA Nominees Ltd.发起设立，发行股份 1 股，每股面值 1 美元。2007 年 1 月 5 日，Sea Fine 公司回购了 CIA Nominees Ltd.的 1 美元股份，并向 SG Micro Limited 新发行了 1 股，每股面值 1 美元，股权结构如下：

股东名称	股份	股权比例
SG Micro Limited	1	100.00%
合 计	1	100.00%

6、圣邦有限的设立

2007 年 1 月 26 日，Sea Fine 以货币出资发起设立圣邦有限，设立时股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	股权比例
Sea Fine	200	100.00%
合 计	200	100.00%

7、收购香港圣邦

2007年2月2日，SG Micro Limited 与张世龙、张勤、林林签订股权转让协议，分别收购三人持有香港圣邦的 5,800 股、1,000 股和 3,200 股股份。香港圣邦成为 SG Micro Limited 的全资子公司。

8、SG Micro Limited 股权调整

2007年9月14日，Coretech 将其持有的 SG Micro Limited 的 15,090,385 股普通股转让给 Best，同日，SG Micro Limited 向 Best 回购了 1,076,923 股普通股。

2007年9月14日 Coretech 回购张世龙所持 Coretech 全部股份。本次回购完成后，Coretech 的股权结构如下：

股东名称	股 份	股权比例
张 勤	421,346.20	35.61%
林 林	511,538.40	43.23%
Cong Wang	125,192.30	10.58%
Anmei Shen	99,615.40	8.42%
汤涵宇	6,461.50	0.54%
林哲伟	19,115.40	1.62%
合 计	1,183,269.20	100.00%

9、SG Micro Limited 第一轮境外私募融资

2007年9月18日，SG Micro Limited 向 Infotech Pacific Ventures L.P、ComVentures VI L.P.和 SPM Capital LLC 分别发行了 3,365,384 股、3,365,384 股、128,204 股共 6,858,972 股 A 类优先股，每股价格为 0.78 美元；向 SPM 发行了 192,308 股 A 类优先股的认股权证，执行价格为每股 0.78 美元；预留了 7,487,179 股普通股期权池作为对公司管理人员、员工及顾问的激励。

第一轮融资完成后，SG Micro Limited 股权结构如下：

股东名称	股份	股权性质	股权比例（不含期权、权证）	股权比例（含期权、权证）
Coretech	11,832,692	普通股	36.18%	29.30%
Best	14,013,462	普通股	42.85%	34.70%
Infotech	3,365,384	优先股	10.29%	8.33%
ComVentures	3,365,384	优先股	10.29%	8.33%
SPM	128,204	优先股	0.39%	0.32%
合计（不含期权、权证）	32,705,126		100.00%	
SPM	192,308	优先股权证		0.48%
期权池	7,487,179	普通股期权		18.54%
合计（含期权、权证）	40,384,613			100.00%

注1：“股权比例（不含期权、权证）”是指按照公司实际发行的股份计算的股权比例。

注2：“股权比例（含期权、权证）”是指按照包含已经实际发行的股份和优先股权证和期权等潜在股份在内的全部股权计算的股权比例。

10、SG Micro Limited 向 WTI 发行优先股权证

2008年4月1日，SG Micro Limited，香港圣邦，Sea Fine（以下合称“借款人”）与 Venture Lending & Leasing IV, LLC，Venture Lending & Leasing V, LLC（以下简称为“Venture IV”、“Venture V”，合称“WTI”）签署协议，约定 Venture IV、Venture V 分别向借款人提供 200 万美元的流动资金授信额度。

2009年3月31日，SG Micro Limited 分别向 Venture IV、Venture V 发行优先股权证，Venture IV、Venture V 均有权在发行优先股权证后至 2019 年 3 月 31 日期间以 A 轮优先股价格（0.78 美元每股）或者以 SG Micro Limited 下一轮融资的认股价格（孰低者），随时向 SG Micro Limited 认购一定数额与贷款总额挂钩的优先股。

本次股权调整后，SG Micro Limited 股权结构如下：

股东名称	股份	股权性质	股权比例（不含期权、权证）	股权比例（含期权、权证）
Coretech	11,832,692	普通股	36.18%	29.05%
Best	14,013,462	普通股	42.85%	34.41%
Infotech	3,365,384	优先股	10.29%	8.26%

股东名称	股份	股权性质	股权比例（不含期权、权证）	股权比例（含期权、权证）
ComVentures	3,365,384	优先股	10.29%	8.26%
SPM	128,204	优先股	0.39%	0.31%
合计（不含期权、权证）	32,705,126		100.00%	
SPM	192,308	优先股权证		0.47%
WTI	341,026	优先股权证		0.84%
期权池	7,487,179	普通股期权		18.38%
合计（含期权、权证）	40,725,639			100.00%

注1：“股权比例（不含期权、权证）”是指按照公司实际发行的股份计算的股权比例。

注2：“股权比例（含期权、权证）”是指按照包含已经实际发行的股份和优先股权证和期权等潜在股权在内的全部股权计算的股权比例。

注3：WTI的权证是以最后执行数额计算。2009年3月31日，权证数额并不确定。

11、圣邦有限的增资

2009年7月，圣邦有限注册资本增至400万美元，全部新增出资由Sea Fine认购。本次变更后，圣邦有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	股权比例
Sea Fine	400	100.00%
合 计	400	100.00%

12、圣邦有限收购香港圣邦

2010年2月1日，圣邦有限收购了香港圣邦100%的股权，参见本节“三、发行人自设立以来的重大资产重组情况”。

13、SG Micro Limited 第二轮境外私募融资

2010年6月7日，SG Micro Limited进行了第二轮融资，向Infotech和ComVentures以每股1.56美元的价格分别发行801,282股B类优先股。

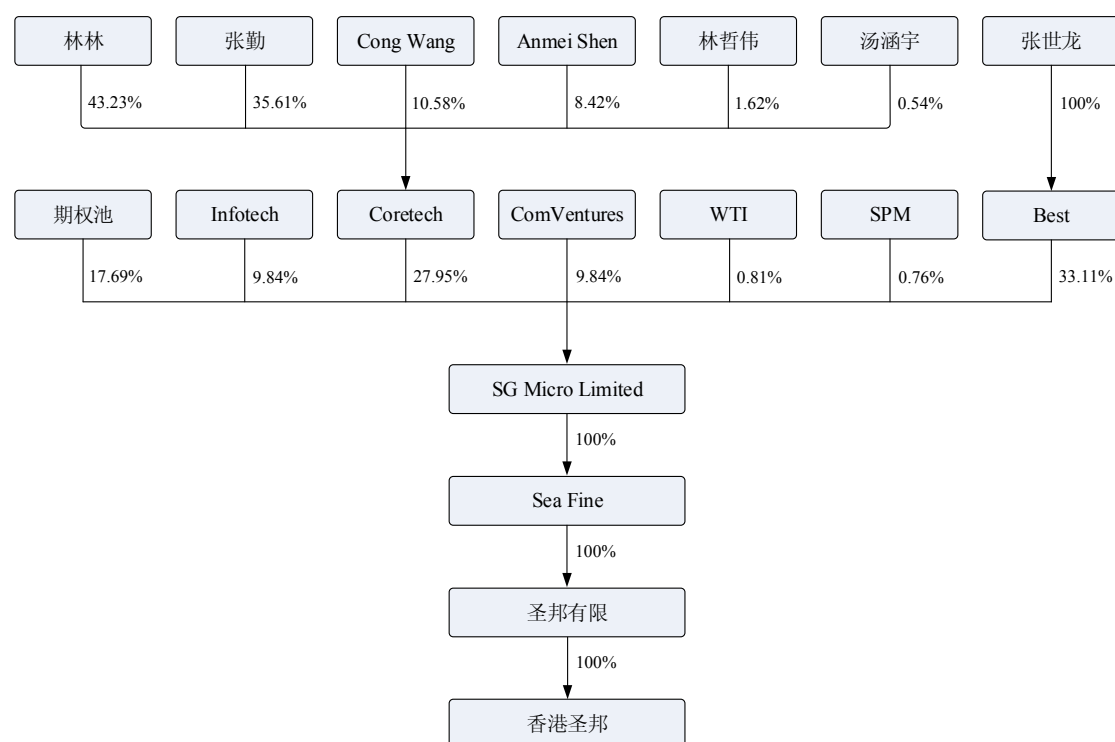
第二轮融资完成后，SG Micro Limited股权结构如下：

股东名称	股份	股权性质	股权比例（不含期权、权证）	股权比例（含期权、权证）
Coretech	11,832,692	普通股	34.49%	27.95%
Best	14,013,462	普通股	40.85%	33.11%
Infotech	3,365,384	A 类优先股	9.81%	7.95%
	801,282	B 类优先股	2.34%	1.89%
ComVentures	3,365,384	A 类优先股	9.81%	7.95%
	801,282	B 类优先股	2.34%	1.89%
SPM	128,204	A 类优先股	0.37%	0.30%
合计（不含期权、权证）	34,307,690		100.00%	
SPM	192,308	A 类优先股权证		0.45%
WTI	341,026	优先股权证		0.81%
期权池	7,487,179	普通股期权		17.69%
合计（含期权、权证）	42,328,203			100.00%

注1：“股权比例（不含期权、权证）”是指按照公司实际发行的股份计算的股权比例。

注2：“股权比例（含期权、权证）”是指按照包含已经实际发行的股份和优先股权证和期权等潜在股份在内的全部股权计算的股权比例。

至此，境外上市红筹架构如下：



注1：期权池系SG Micro Limited 预留的但未实际发行的普通股7,487,179股，其中已授予的期权和未授予的期权分别为4,535,193股、2,951,986股；

注2：SPM持有的股份数额包括A类优先股128,204股以及尚未行权的A类认股权证192,308股；

注3：WTI持有的股份数额系尚未行权的认股权证341,026股。

（二）红筹架构的解除

为实现境内上市，经各方协商一致，决定解除海外红筹架构。2011年1月8日，SG Micro Limited、Sea Fine、Best 及其股东、Coretech 及其股东、圣邦有限与 Infotech、ComVentures、SPM、WTI 签署《关于圣邦微电子（北京）有限公司重组协议》，并后续签署《补充协议》（以下合称“《重组协议》”），对红筹架构的解除及圣邦有限的股权结构的调整作出了约定：

1、SG Micro Limited A 类优先股权证行权

2011年1月20日，WTI 旗下基金 Venture Lending & Leasing IV, LLC 和 Venture Lending & Leasing V, LLC 行使其持有 SG Micro Limited 的认股权证，按照每股 0.78 美元的价格各认购 170,513 股 SG Micro Limited 的 A 类优先股，股份价款总计 266,000 美元。SPM 行使其持有 SG Micro Limited 的 A 类优先股权证行权，按照每股 0.78 美元的价格认购 192,308 股 SG Micro Limited 的 A 类优先股，股份价款总计 150,000 美元。

本次行权完成后，SG Micro Limited 的股权结构如下：

股东名称	股份	股权性质	股权比例（不含期权）	股权比例（含期权）
Coretech	11,832,692	普通股	33.96%	27.95%
Best	14,013,462	普通股	40.22%	33.11%
Infotech	4,166,666	优先股	11.96%	9.84%
ComVentures	4,166,666	优先股	11.96%	9.84%
SPM	320,512	优先股	0.92%	0.76%
WTI	341,026	优先股	0.98%	0.81%
合计（不含期权）	34,841,024		100.00%	
期权池	7,487,179	普通股期权		17.69%
合计（含期权）	42,328,203			100.00%

注1：“股权比例（不含期权）”是指按照公司实际发行的股份计算的股权比例。

注2：“股权比例（含期权）”是指按照包含已经实际发行的股份和优先股权证和期权等潜在股份在内的全部股权计算的股权比例。

2、SG Micro Limited 第一次股份回购

2011年6月27日,SG Micro Limited 以每股 0.78 美元的价格分别向 Infotech 和 ComVentures 回购 1,132,051 股 A 类优先股；以每股 1.56 美元的价格分别向 Infotech 和 ComVentures 回购 801,282 股 B 类优先股，回购价款总计 4,266,000 美元。

本次回购完成后，SG Micro Limited 的股权结构如下：

股东名称	股份	股权性质	股权比例（不含期权）	股权比例（含期权）
Coretech	11,832,692	普通股	38.20%	30.77%
Best	14,013,462	普通股	45.24%	36.44%
Infotech	2,233,333	优先股	7.21%	5.81%
ComVentures	2,233,333	优先股	7.21%	5.81%
SPM	320,512	优先股	1.03%	0.83%
WTI	341,026	优先股	1.10%	0.89%
合计（不含期权）	30,974,358		100.00%	
期权池	7,487,179	普通股期权		19.47%
合计（含期权）	38,461,537			100.00%

注1：“股权比例（不含期权）”是指按照公司实际发行的股份计算的股权比例。

注2：“股权比例（含期权）”是指按照包含已经实际发行的股份和优先股权证和期权等潜在股份在内的全部股权计算的股权比例。

3、圣邦有限股权转让

2011年6月1日,Sea Fine 与 SG Micro Limited 的股东指定的持股实体签署《股权转让协议》，将其持有的圣邦有限 100%的股权按照 SG Micro Limited 股份第一次回购后的持股比例转给 SG Micro Limited 股东指定的持股实体（其中个人股东张世龙应受让的圣邦有限 10.93%的股份由其配偶 Wen Li 在香港设立的持股公司弘威国际受让，个人股东 Anmei Shen 应受让的圣邦有限 3.22%的股份由

其配偶 Cong Wang 在香港设立的持股公司荣基香港受让), 股权转让价款总计 400 万美元。本次股权转让具体价款具体如下:

股东名称	受让出资额(美元)	受让股权比例(%)	转让价款(美元)
鸿达永泰	1,372,387	34.31	0
弘威国际	437,298	10.93	0
哈尔滨珺霖	660,596	16.52	0
宝利鸿雅	544,123	13.60	0
荣基香港	290,314	7.26	0
鹏成国际	33,029	0.83	0
盈富泰克	288,411	7.21	1,742,000
世纪维盛	288,411	7.21	1,742,000
华扬兴业	44,040	1.10	266,000
萨锐资本	41,391	1.03	250,000
总 计	4,000,000	100.00	4,000,000

2011 年 6 月 1 日, 圣邦有限通过股东决议和董事会决议同意上述转让。

4、圣邦有限的增资

鉴于 SG Micro Limited 已预留了 7,487,179 股期权池, 在红筹回归过程中, 由期权授予对象的持股实体在圣邦有限层面履行其在 SG Micro Limited 应享有的期权权益, 同时, 授予员工部分限制性股权作为激励。期权池内剩余部分由公司实际控制人张世龙控制的全资公司鸿达永泰以及公司创始人之一张勤女士控制的全资公司宝利鸿雅认购。

2011 年 7 月 8 日, 圣邦有限通过董事会决议, 同意公司增加注册资本 966,887 美元, 由鸿达永泰、宝利鸿雅、金华添达、盈华锐时、高迪达天、萨锐资本和鹏成国际以 1,247,187 美元认购, 其中 966,887 美元计入公司的注册资本, 余额计入公司的资本公积。

本次增资后, 圣邦有限的股权结构与 SG Micro Limited 第一次股权回购后的含员工期权的股权结构一致。

5、SG Micro Limited 第二次回购

2011 年 9 月 22 日，SG Micro Limited 以每股 0.78 每股的价格回购 Infotech、ComVentures、WTI 和 SPM 持有的全部 A 类优先股，其中向 Infotech 回购 2,233,333 股，向 ComVentures 回购 2,233,333 股，向 WTI 回购 341,026 股，向 SPM 回购 320,512 股。

本次回购后，SG Micro Limited 股权结构如下：

股东名称	股份	股权性质	股权比例
Coretech	11,832,692	普通股	45.78%
Best	14,013,462	普通股	54.22%
合计	25,846,154	普通股	100.00%

6、圣邦有限第二次增资

上述回购完成后，Infotech 及 ComVentures 将其因 SG Micro Limited 回购其股份获得的 4,266,000 美元（为第一次回购价款余额 266,000 美元及第二次回购价款 4,000,000 美元之和）通过设立于香港的盈富泰克和世纪维盛以溢价增资的方式全部投入圣邦有限。

2011 年 9 月 8 日，圣邦有限通过董事会决议，同意公司增加注册资本 499,338 美元，即由 4,966,887 美元增加至 5,466,225 美元，由盈富泰克和世纪维盛以 4,266,000 美元现汇认购，其中 499,338 美元计入公司的注册资本，余额计入公司资本公积。

至此，个人股东和投资方向接持有的圣邦有限股权比例与其原在 SG Micro Limited 所持股权比例一致，红筹回归完成。

境内外股权结构安排比较如下：

境外股权结构安排 SG Micro Limited 股权结构 (包含期权、权证)		境内股权结构安排 圣邦有限股权结构			
直接或间接股份 持有人	持股比例	直接或间接股份 持有人	持股比例	股东	持股比例
张勤	9.95%	张勤	9.95%	宝利鸿雅	12.95%

境外股权结构安排 SG Micro Limited 股权结构 (包含期权、权证)		境内股权结构安排 圣邦有限股权结构			
直接或间接股份 持有人	持股比例	直接或间接股份 持有人	持股比例	股东	持股比例
林林	12.09%	林林	12.09%	哈尔滨珺霖	12.09%
Cong Wang 和 Anmei Shen	5.31%	Cong Wang	5.31%	荣基香港	5.31%
汤涵宇和林哲伟	0.60%	汤涵宇和林哲伟	0.60%	鹏成国际	1.96%
张世龙	33.11%	张世龙	25.11%	鸿达永泰	29.08%
		Wen Li	8.00%	弘威国际	8.00%
Infotech	9.84%	Infotech	9.84%	盈富泰克	9.84%
ComVentures	9.84%	ComVentures	9.84%	世纪维盛	9.84%
WTI	0.81%	WTI	0.81%	华扬兴业	0.81%
SPM	0.76%	SPM	0.76%	SPM	2.67%
期权池	17.69%	盈华锐时	2.48%	盈华锐时	2.48%
		金华添达	2.89%	金华添达	2.89%
		高迪达天	2.08%	高迪达天	2.08%
		七名外籍人士	1.35%	由鹏成国际 持有	-
		张世龙	3.97%	由鸿达永泰 持有	-
		张勤	3.00%	由宝利鸿雅 持有	-
		SPM	1.91%	由 SPM 持有	-
总 计	100.00%	总 计	100.00%	总 计	100.00%

7、境外持股公司的注销

截至 2015 年 6 月 30 日,红筹架构下的持股公司 Sea Fine、SG Micro Limited、Coretech、Best 均已注销。

8、红筹架构建立及解除过程中的外汇登记情况

根据国家外汇管理局《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》，境内居民在境外设立红筹架构并返程投资的，应当办理境外投资外汇登记手续。就发行人境外红筹架构设立及其解除过程所涉及的

外汇登记事宜，境内居民股东张世龙、张勤、林林已经在国家外汇管理局北京外汇管理部办理了外汇登记手续。

三、发行人自设立以来的重大资产重组情况

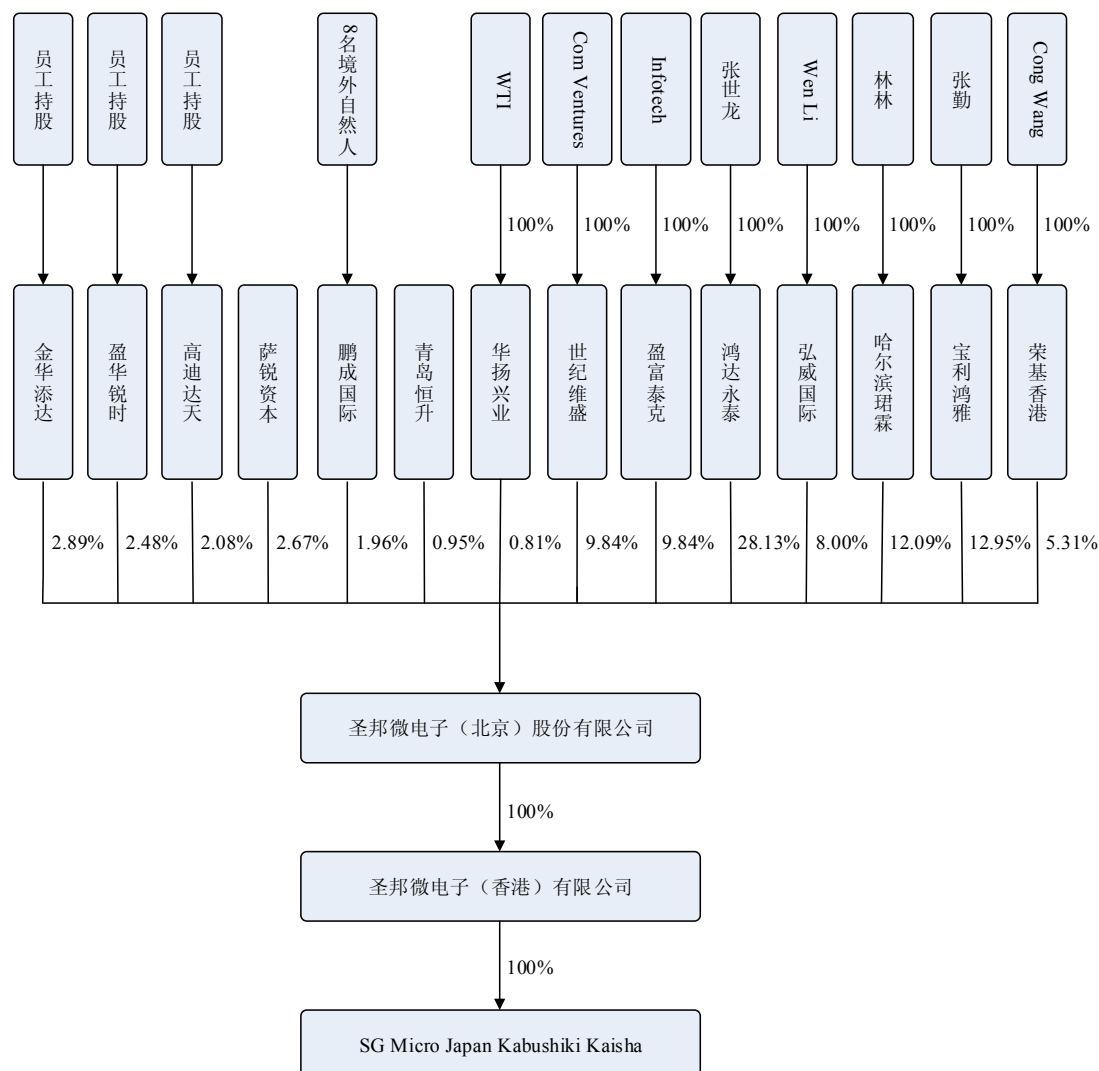
公司自设立以来的重大资产重组为圣邦有限于 2010 年 2 月收购香港圣邦股权。

2009 年 10 月 15 日，圣邦有限董事会审议通过购买香港圣邦全部股份的决议。2009 年 10 月 28 日，公司与 SG Micro Limited 签订股权转让协议，约定以 1 万美元的价格受让 SG Micro Limited 持有的香港圣邦全部股份。2010 年 1 月 22 日，北京市商务委员会出具了《北京市商务委员会关于同意圣邦微电子（北京）有限公司收购圣邦微电子（香港）有限公司股权的批复》。2010 年 1 月 28 日，商务部向圣邦有限颁发了《企业境外投资证书》。2010 年 1 月 29 日，北京市发展和改革委员会出具了《关于圣邦微电子（北京）有限公司收购圣邦微电子（香港）有限公司 100%股权项目核准的批复》。2010 年 2 月 1 日，香港圣邦完成股权变更手续。

本次收购为同一控制下的股权收购。公司及香港圣邦的主营业务均为模拟芯片的研发和销售，收购前后公司主营业务未发生变化。

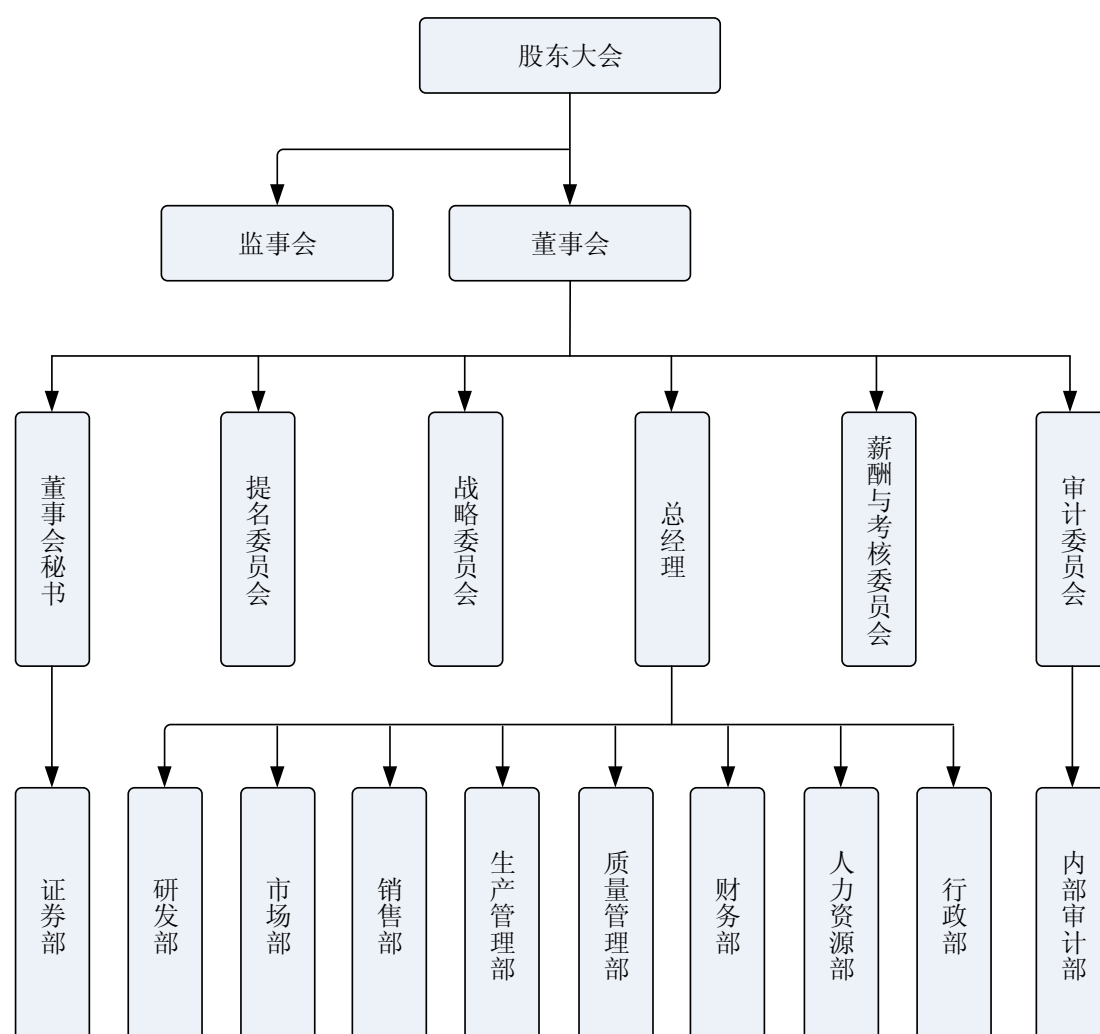
四、发行人股权关系及组织结构

（一）股权结构图



（二）组织结构图

截至 2015 年 6 月 30 日，公司内部组织结构如下图所示：



五、发行人控股子公司及分公司情况

（一）控股子公司

公司拥有一家全资子公司香港圣邦，具体情况如下：

成立时间	2005 年 12 月 5 日	授权股本	10,000 港币
主要生产经营地	香港	已发行股数	10,000 股
股东结构	圣邦股份持股 100%		
住所	Room 606 6/F Tower A Hunghom Commercial Centre 39 Ma Tau Wai Road KL		
主营业务	集成电路产品的委托生产、销售（与公司主营业务一致）		

经致同审计，截至 2014 年 12 月 31 日，香港圣邦总资产为 8,989.57 万元，

净资产为 5,751.39 万元，2014 年实现净利润为 2,223.2 万元。截至 2015 年 3 月 31 日，香港圣邦总资产为 9,582.47 万元，净资产为 6,506.53 万元，2015 年 1-3 月实现净利润为 732.75 万元。

为拓展日本市场，2015 年 6 月香港圣邦在日本注册了一家全资子公司，注册名称为 SG Micro Japan Kabushiki Kaisha（注册号：0104-01-118931），目前尚未实际开展业务。

（二）分公司

公司拥有一家分公司，具体情况如下：

分公司	经营范围	成立日期
哈尔滨分公司	研发集成电路产品、电子产品、计算机软件；技术转让、技术服务、技术咨询。	2011/06/09

六、发行人主要股东及实际控制人的基本情况

（一）实际控制人及一致行动人情况

公司实际控制人为张世龙先生。根据张世龙、张勤、林林、Wen Li、鸿达永泰（张世龙 100%持股公司）、宝利鸿雅（张勤 100%持股公司）、哈尔滨珺霖（林林 100%持股公司）、弘威国际（Wen Li 100%持股公司）签署的一致行动协议，弘威国际、宝利鸿雅和哈尔滨珺霖为鸿达永泰的一致行动人，于其持有圣邦股份期间，在股东大会行使股东的表决权、向董事会及股东大会行使提案权、行使董事、独立董事及监事候选人提名权等有关经营决策事项时作出与鸿达永泰相同的意思表示，保持一致行动，即不作出与鸿达永泰意思表示相悖或弃权的意思表示，促使并保证所推荐的董事人选在圣邦股份的董事会行使表决权时，与鸿达永泰采取相同的意思表示。张世龙、张勤、林林、Wen Li 通过其持股公司鸿达永泰、宝利鸿雅、哈尔滨珺霖、弘威国际合计持有公司 61.17%股权。

张世龙先生，1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，身份证号码 11010819660221****。张世龙先生简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况”之“（一）董事会成员”。

（二）主要股东情况

截至 2015 年 6 月 30 日，持有公司 5%以上股份的主要股东为鸿达永泰、宝利鸿雅、哈尔滨珺霖、世纪维盛、盈富泰克、弘威国际及荣基香港。

1、鸿达永泰

截至 2015 年 6 月 30 日，鸿达永泰持有公司股份 12,661,068 股，持股比例 28.13%，为公司控股股东。鸿达永泰具体情况如下：

成立时间	2011 年 3 月 17 日	主要生产经营地	北京
注册资本	100,000 元	实收资本	100,000 元
股东结构	张世龙持股 100%		
住所	北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦二十层 2007 室		
主营业务	股权投资（与公司主营业务无关）		

经北京中睿恒达会计师事务所审计，截至 2014 年 12 月 31 日，鸿达永泰总资产为 3,676.53 万元，净资产为 3,675.98 万元，2014 年实现净利润为 465.53 万元；截至 2015 年 3 月 31 日，鸿达永泰总资产 3,621.6 万元，净资产 3,609.09 万元，2015 年 1-3 月实现净利润-66.88 万元。

2、宝利鸿雅

截至 2015 年 6 月 30 日，宝利鸿雅持有公司股份 5,829,425 股，持股比例为 12.95%。宝利鸿雅具体情况如下：

成立时间	2011 年 3 月 7 日	主要生产经营地	北京
注册资本	100,000 元	实收资本	100,000 元
股东结构	张勤持股 100%		
住所	北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦十七层 1704		
主营业务	股权投资（与公司主营业务无关）		

3、哈尔滨珺霖

截至 2015 年 6 月 30 日，哈尔滨珺霖持有公司股份 5,438,272 股，持股比例为 12.09%。哈尔滨珺霖具体情况如下：

成立时间	2011 年 3 月 7 日	主要生产经营地	哈尔滨
------	----------------	---------	-----

注册资本	100,000 元	实收资本	100,000 元
股东结构	林林持股 100%		
住所	哈尔滨市高开区南岗集中区红旗大街 162 号创业中心 17 号楼 802 室		
主营业务	股权投资（与公司主营业务无关）		

4、世纪维盛

截至 2015 年 6 月 30 日，世纪维盛持有发行人 4,429,675 股，持股比例为 9.84%。世纪维盛具体情况如下：

成立时间	2011 年 3 月 2 日	授权股本	10,000 港币
主要生产经营地	香港	已发行股数	1 股
股东结构	ComVentures VI, L.P.持股 100%		
住所	Room 902 Chinachem Tower 9/F 34-37 Connaught Road Central HK		
主营业务	股权投资（与公司主营业务无关）		

5、盈富泰克

截至 2015 年 6 月 30 日，盈富泰克持有发行人 4,429,675 股，持股比例为 9.84%。盈富泰克具体情况如下：

成立时间	2010 年 12 月 21 日	授权股本	10,000 港币
主要生产经营地	香港	已发行股数	2 股
股东结构	IPV Capital, L.P.（原 Infotech., 现已更名）持股 100%		
住所	12/F Ruttonjee House 11 Duddell St Central HK		
主营业务	股权投资（与公司主营业务无关）		

6、弘威国际

截至 2015 年 6 月 30 日，弘威国际持有发行人 3,600,000 股，持股比例为 8.00%。弘威国际具体情况如下：

成立时间	2011 年 2 月 8 日	授权股本	10,000 港币
主要生产经营地	香港	已发行股数	10,000 股
股东结构	Wen Li 持股 100%		
住所	Room 606 6/F Tower A Hunghom Commercial Centre 39 Ma Tau Wai Road KL		
主营业务	股权投资（与公司主营业务无关）		

7、荣基香港

截至 2015 年 6 月 30 日，荣基香港持有发行人 2,389,973 股，持股比例为 5.31%。荣基香港具体情况如下：

成立时间	2009 年 10 月 29 日	授权股本	10,000 港币
主要生产经营地	香港	已发行股数	10,000 股
股东结构	Cong Wang 持股 100%		
住所	Flat/Rm 2304 23/F Fu Fai Comm Centre 27 Hillier St Sheung Wan HK		
主营业务	股权投资（与公司主营业务无关）		

（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况

截至 2015 年 6 月 30 日，除鸿达永泰外，公司控股股东、实际控制人未直接或间接控制其他企业。

（四）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或其他有争议的情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司控股股东和实际控制人所持有的公司股份均未发生质押或存在其他有争议的情况。

七、发行人股本情况

（一）本次发行前后公司股本情况

本次发行前，公司的总股本为 4,500 万股，本次拟发行人民币普通股不超过 1,500 万股，其中新股发行数量不超过 1,500 万股，公司现有股东将其在本次发行前持有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售数额不超过 375 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量；本次发行后公司股本总数不超过 6,000 万股。

假设本次发行的 1,500 万股全部为新股发行，本次发行股份将占发行后总股本的 25%，发行前后股东及股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份性质	本次发行前		本次发行后	
			持股数量	股权比例	持股数量	股权比例
1	鸿达永泰	境内法人股	12,661,068	28.13%	12,661,068	21.10%

序号	股东名称/姓名	股份性质	本次发行前		本次发行后	
			持股数量	股权比例	持股数量	股权比例
2	宝利鸿雅	境内法人股	5,829,425	12.95%	5,829,425	9.71%
3	哈尔滨珺霖	境内法人股	5,438,272	12.09%	5,438,272	9.07%
4	盈富泰克	外资股	4,429,675	9.84%	4,429,675	7.38%
5	世纪维盛	外资股	4,429,675	9.84%	4,429,675	7.38%
6	弘威国际	外资股	3,600,000	8.00%	3,600,000	6.00%
7	荣基香港	外资股	2,389,973	5.31%	2,389,973	3.98%
8	金华添达	境内有限合伙	1,298,805	2.89%	1,298,805	2.17%
9	萨锐资本	外资股	1,199,424	2.67%	1,199,424	2.00%
10	盈华锐时	境内有限合伙	1,117,405	2.48%	1,117,405	1.86%
11	高迪达天	境内有限合伙	937,099	2.08%	937,099	1.56%
12	鹏成国际	外资股	881,374	1.96%	881,374	1.47%
13	青岛恒升	境内法人股	425,251	0.95%	425,251	0.71%
14	华扬兴业	外资股	362,554	0.81%	362,554	0.61%
15	社会公众股				15,000,000	25.00%
	合 计		45,000,000	100.00%	60,000,000	100.00%

（二）申报前最近一年发行人新增股东情况

公司申报前最近一年不存在新增股东。

（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自的持股比例

张世龙先生与 Wen Li 女士系夫妻关系，鸿达永泰（张世龙持有 100%股权）和弘威国际（Wen Li 持有 100%股权）分别持有公司 28.13%和 8.00%股权。

张世龙先生与张勤女士系表兄妹关系，宝利鸿雅（张勤持有 100%股权）持有公司 12.95%股权。

（四）股东公开发售股份的情况

本次公开发行股份包括发行人向社会公众公开发行的股份和发行人股东向社会公众公开发售的股份，二者合计拟发行规模不超过 1,500 万股 A 股普通股（以中国证监会实际核准的发行数额为准），涉及发行人股东拟公开发售股份的，发行人将根据募投项目资金需要量合理确定新股发行数量，新股发行数量不足法定上市条件的，将通过发行人股东公开发售以增加公开发行股份的数量。其中，发

行人预计向社会公众公开发行新股数量为不超过 1,500 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 375 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

股东公开发售股份完成后鸿达永泰及张世龙仍为公司控股股东和实际控制人，本次发行人股东公开发售股份后，发行人的治理结构及生产经营不会产生重大不利变化。

请投资者在报价申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。

八、正在执行的股权激励及其他制度安排

截至 2015 年 6 月 30 日，公司不存在正在执行的对相关员工的股权激励及其他制度安排。

九、发行人员工情况

2012 年-2014 年各期末，公司的总人数分别为 192 人、204 人和 201 人。截至 2015 年 3 月 31 日，公司人员的专业结构情况如下：

专业结构	员工人数（人）	比例
管理人员	10	4.90%
技术人员	132	64.71%
销售人员	31	15.20%
生产管理人员	15	7.35%
财务人员	6	2.94%
行政人员	10	4.90%
合计	204	100.00%

截至 2015 年 3 月 31 日，公司员工按照受教育程度划分，具体情况如下：

受教育程度	员工人数（人）	占员工总数比例
研究生及以上	42	20.59%
大学本科	126	61.76%
大专及以下	36	17.65%
合计	204	100.00%

截至 2015 年 3 月 31 日，公司员工按照年龄结构划分，具体情况如下：

年龄	人数	比例
30 岁及以下	66	32.35%
31—40 岁	102	50.00%
41—50 岁	28	13.73%
51 岁及以上	8	3.92%
合计	204	100.00%

十、发行人的相关承诺

（一）发行人股东自愿锁定股份的承诺

参见“重大事项提示”中“一、本次发行的重要承诺”之“（一）发行人股东自愿锁定股份的承诺”。

（二）关于发行人各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、购回股份、赔偿损失的承诺

公司承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）加上同期银行存款利息。

控股股东和实际控制人承诺，若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断圣邦股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司发售的原限售股份。回购价格为发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）加上同期银行存款利息。

圣邦股份控股股东和实际控制人、圣邦股份及其全体董事、监事、高级管理

人员等相关责任主体承诺，招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

（三）关于稳定公司股价的预案

为维护公司上市后的股价稳定，公司制定《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》如下：

1、启动股价稳定措施的具体条件

公司上市后三十六个月内，如非因不可抗力因素所致，公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一年度末经审计的每股净资产（上一年度末审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则公司将于第 20 个交易日（以下简称“启动日”）收盘后公告启动稳定公司股价的措施并发出召开临时股东大会的通知。

自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。

公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照相关承诺履行相应义务。

2、终止股价稳定措施的情形

自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

（1）公司 A 股股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司上一年度末经审计的每股净资产（上一年度末审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；

（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

3、稳定公司股价的具体措施

公司控股股东、董事和高级管理人员及公司承担稳定公司 A 股股票价格的义务。公司控股股东、董事和高级管理人员、公司可以视情况采取以下措施以稳定公司 A 股股票价格，并按照如下顺序进行：

（1）控股股东增持公司 A 股股票

公司控股股东将自启动日起 2 个交易日内，以书面形式向公司提交明确、具体的增持方案，方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告。自公告次日起，控股股东可以开始实施增持计划。

公司控股股东将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统增持本公司社会公众股，增持价格不高于本公司上一年度末经审计的每股净资产（上一年度末审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），增持股份数量不超过本公司股份总数的 2%，且连续 12 个月内增持比例累计不超过本公司股份总数的 5%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后本公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

该次稳定股份措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。

（2）在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员（“负有增持义务的董事、高级管理人员”）增持公司 A 股股票

控股股东增持公司 A 股股票完成后 15 个交易日内，若终止股价稳定措施的情形未出现，则负有增持义务的董事、高级管理人员将以书面形式向公司提交明确、具体的增持方案，方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告。自公告次日起，负有增持义务的董事、高级管理人员可以开始实施增持计划。

负有增持义务的董事、高级管理人员将自增持计划公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统增持本公司社会公众股份，增持价格不高于本公司上

一年度末经审计的每股净资产（上一年度末审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从本公司领取薪酬（税后）和现金分红（税后）总和的 20%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后本公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

该次稳定股份措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。

对于未来新聘的在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时负有增持义务的董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。

（3）公司回购 A 股股票

在负有增持义务的董事、高级管理人员增持公司 A 股股票完成后 15 个交易日内，若终止股价稳定措施的情形未出现，则公司将召开董事会，董事会制定明确、具体的回购方案，方案内容包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。

公司将自回购方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统回购公司社会公众股，回购价格不高于公司上一年度末经审计的每股净资产（上一年度末审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），回购股份数量不超过公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。公司全体董事（独立董事除外）应在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。公司控股股东应在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

该次稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。

（4）其他经证券监督管理部门认可的方式

公司、公司控股股东、负有增持义务的董事、高级管理人员可以根据公司及市场的实际情况，采取其他经证券监督管理部门认可的方式维护公司股价稳定，具体措施实施应以维护上市公司地位、保护公司及广大投资者利益为原则，遵循法律、法规及证券交易所的相关规定，并应按照证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。

4、未履行稳定公司股价措施的约束措施

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如控股股东未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权将对控股股东的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及负有增持义务的董事、高级管理人员增持公司股票，如负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权将对其从公司领取的薪酬和现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。

（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

参见“重大事项提示”中“一、本次发行的重要承诺”之“（五）关于对承诺履行约束措施的承诺”。

（五）关于避免同业竞争的承诺

为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东鸿达永泰及实际控制人张世龙出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。

（六）关于利润分配政策的承诺

公司、公司控股股东和实际控制人、公司持股 5%以上的股东、公司全体董事、公司全体监事作出如下承诺：

“根据 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》（中国证监会公告[2013]43号），本公司2015年第三次临时股东大会审议通过了将于本公司A股挂牌上市之日生效的《公司章程（草案）》。

为维护中小投资者的利益，本公司承诺将严格按照《公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。

发行人控股股东和实际控制人、发行人持股5%以上的股东、发行人全体董事、发行人全体监事承诺将从维护中小投资者利益的角度，根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会/董事会/监事会上进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。”

（七）本次发行相关机构的承诺

中信证券股份有限公司承诺：“因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将依法赔偿投资者损失。”

北京市君合律师事务所承诺：“若因本所作出的上述声明被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法承担赔偿责任。

（一）如就此发生争议，本所应积极应诉并配合调查外，本所将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商。

（二）有管辖权的司法机关依法作出生效判决并判定圣邦微电子《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本所因此应承担赔偿责任的，本所在收到该等判定后十五个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。

（三）经司法机关依法作出的生效判决所认定的赔偿金额确定的赔偿金额后，依据该等司法判决确定的形式进行赔偿。

上述承诺内容系本所真实意思表示，真实、有效，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本所将依法承担相应责任。”

致同会计师事务所承诺：“因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将依法赔偿投资者损失。”

北京京都中新资产评估有限公司承诺：“因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将依法赔偿投资者损失。”

第六节 业务和技术

一、发行人主营业务及其变化情况

（一）主营业务及主要产品

1、主营业务和主要产品简介

公司的主营业务为模拟芯片的研发与销售。

公司自成立以来一直专注于模拟芯片的研发与销售，坚持“以市场为导向、以创新为驱动”的经营理念，经过多年发展，掌握了先进的模拟芯片设计与开发技术，研制出一系列具有高可靠性与一致性的模拟芯片产品，同时与国内外知名终端整机厂商、电子元器件经销商、晶圆制造商以及封装测试厂商建立了高效联动机制，并以关键技术和重点产品为突破口，不断提升核心竞争力，现已成为国内领先的高性能、高品质模拟芯片设计企业。

公司主要产品为高性能模拟芯片，覆盖信号链和电源管理两大领域，拥有 600 多款可供销售产品型号，可广泛应用于通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等众多领域。公司的核心技术以及自主研发的多款产品处于先进水平，如静态电流 300nA 的微功耗运算放大器、工作电流 300nA 的超低功耗比较器、输入失调电压典型值 3 μ V 的高精度运算放大器、六阶视频驱动器、1:500 大动态背光 LED 驱动器等产品，而且在综合性能、质量和可靠性等方面均达到一流水平。

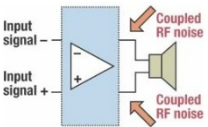
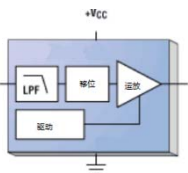
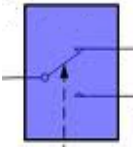
公司一直以“多样性、齐套性、细分化”为产品发展战略目标，自设立以来，不断增加新的产品系列，细化产品功能，拓展应用领域，以满足客户不断增加的多样化需求。同时，公司对每一款产品的质量与性能进行严格把关，一方面选择具有高可靠性、一致性与产品良率的晶圆生产厂和封测厂作为供应商，另一方面对每一款新产品进行全套高标准的测试，通过测试后方可投入生产，丰富产品线的同时保证了产品的质量、可靠性与一致性。公司主要产品为高性能模拟芯片，主要类别及用途具体如下：



公司信号链类模拟芯片产品目前主要为各类放大器芯片（包括运算放大器、音频放大器和视频驱动器等）、模拟开关及接口电路等，电源管理类模拟芯片则涵盖LED驱动电路以及线性稳压器、DC/DC转换器、CPU电源监测电路、锂电池充电管理芯片、过压保护电路及负载开关等非驱动类电源管理产品。

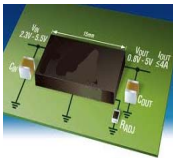
(1) 信号链类模拟芯片

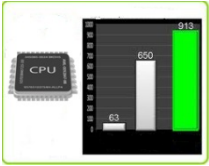
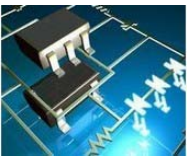
类别	主要产品类型	主要产品系列	主要技术水平及特点	用途
放大器	运算放大器：具有很高的放大倍数的电路单元，能对信号进行数字运算的放大电路，推动自动控制、测量等功能的精密有效执行	高精度运算放大器	输入失调电压典型值最低至 3μV，且具有极低的温度漂移、低补偿和低偏置电流等特点	适用于对于精度有较高要求的便携设备，如便携式医疗设备、手持仪表、数据采集设备等
		高速运算放大器	电压转换速率最高为 500V/μS，带宽 1.5GHz，具有常用的带宽，	适用于对转换速度有要求的应用，如高清电视机顶盒中的数模转换器等

类别	主要产品类型	主要产品系列	主要技术水平及特点	用途
			并适应于常用输入电压范围	
		低功耗运算放大器	静态电流损耗最低可至 300nA，具有常用的带宽和电压转换速率	适用于低电源电压供电的便携设备，如手机、笔记本电脑等
		通用型运算放大器	带宽为 1MHz，静态电流 60μA，具有单通道、双通道及四通道三种规格，以通用为目的而设计，产品应用面广	适用于对信号有放大要求的任何电子设备
		低噪声运算放大器	输入电压噪声密度低至 $1.6\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ ，带宽 3MHz 至 50MHz	适用于低电压、低噪音的系统
		低功耗比较器	工作电压范围 1.4V 至 5.5V，工作电流低至 300nA	适用于需要潜伏或深度睡眠状态的应用
	音频放大器：放大音频信号 		具有优良的抗 EMI/RF 干扰能力、可消除 Pop-Click 噪声	适用于对于音质清晰度和质量有较高要求的电子设备，如手机、PDA、笔记本电脑、手持式媒体播放器、游戏机等产品
	视频驱动器：滤波并放大视频信号 		可以显著增强视频的亮度、色度、同步信号，同时有效去除噪声和干扰	适用于对于高清视频有较高要求的应用，如：DVD、高清 HDTV、个人录像机 RVR 等
其他	模拟开关：切换模拟信号的传输路径 	高速模拟开关	开启时间最快为 10ns，关断时间最快为 8ns，高带宽，并且拥有优异的导通电阻稳定性和平缓度	适用于有高速信号切换的应用，如消费类电子、工业、医疗、仪表、便携式和车载电子产品
		低导通电阻模拟开关	导通电阻可低至 0.4 欧姆	适用于音频信号切换，如工业测量系统、仪表系统、医疗系统

类别	主要产品类型	主要产品系列	主要技术水平及特点	用途
	逻辑电平转换芯片：提供接口及系统内部逻辑单元间电平转换的解决方案 		具备高速率的双向传输性能、兼容 I2C 及 SMBus 总线、低导通电阻、低传输延迟	适用于移动通信终端、双电源系统、数据卡、智能卡、SIM 卡、I2C 接口电路

(2) 电源管理类模拟芯片

产品类别	主要产品类型	主要产品系列	主要技术水平及特点	应用领域
非驱动类电源管理	线性稳压器 (LDO)：保证稳定的电压供给 	高精度、低噪声、低功耗、低压差线性稳压器	可提供超低输出噪声和高电源抑制比，超低的压差可以提升电池的使用寿命	适用于电池供电的低功耗设备，如智能手机、MP3/4 播放器、手持医疗设备等
		低功率、高压稳压器	可接受 2.7V 至 36V 的输入电压，压差仅为 8mV，静态电流仅为 2.2μA	适用于于电池供电的低功耗设备，如手机、MP3 播放器、手持设备等
	DC/DC 转换器：实现直流电源电压的有效转换 	DC/DC 电源管理单元	具有高精度带隙基准，采用低功耗和小封装的优化设计，且所需的外部组件较少	适用于小巧扁平的电路实现方案，如数码相机、智能手机、PDA、便携式医疗设备等
		DC/DC 同步降压转换器	降压转换器输入电压变化范围为 2.5V 至 38V，输出电压可稳定在 1.8V 至 38V	适用于便携式电子设备，如智能手机、MP3/MP4、PDA、GPS、可穿戴式电子设备等
		DC/DC 同步升压转换器	升压转换器输入电压变化范围为 0.9V 至 20V，输出电压可稳定在 3.3V 至 38V	适用于便携式电子设备，如智能手机、MP3/MP4、PDA、GPS、可穿戴式电子设备等
		电荷泵 DC/DC 转换器	可提供 500mA 的输出电流，在其工作范围内具有低静态电流及高功效的特点	适合于小型的、电池供电的应用，如手机、数码相机、LED 显示背光驱动、GPS 接收器
	锂电池充电管理芯片：提供智能型电池管理系统 		采用线性及开关型拓扑结构，是可提供诸多电池安全和管理功能的智能型电池管理系统，结合简单外围电路便可设计低成本的锂电池充电器	适用于小型的、电池供电的应用，如手机、数码相机、笔记本电脑、可穿戴式电子产品等

产品类别	主要产品类型	主要产品系列	主要技术水平及特点	应用领域
	CPU 电源监控电路：提供精密的电源电池供电设备监控能力 		具有精密电源监控能力，在电源电压低至 1V 时仍可正常工作，并具有低功耗、带看门狗功能、集成度高、性价比高、外围电路简单、可靠性高等优点	适用于对 CPU 工作环境要求较高的应用，如计算机、控制器、智能设备、汽车系统等
	负载开关：对负载电流进行分配、限制和调控 		输入电压范围 1.0V 至 5.5V，输出电流 2A，具有低至 5uA 的静态电流	便携式移动终端、智能设备、USB 接口、数字电视、机顶盒等
驱动电路	LED 驱动器：驱动 LED 发光 	白光 LED 驱动器	高效率、低噪声、占位面积与功耗极小、电流匹配精确，并具备多路输出能力	适用于 LED 背光应用，如白光 LED 背光、白光相机闪光、彩色背光、可编程电流源等
		LED 闪光灯驱动器	在控制端施加短脉冲重置时，满足延长闪光时间的需要，并可保证每通道 0.75A 的较高恒流；具有闪光灯超时保护、可编程电流控制功能；双通道支持色温补偿的双闪光灯应用方案	适用于 LED 闪光灯应用，如智能手机闪光灯、白光相机闪光等

2、主营业务收入的构成情况

报告期内，公司主要产品为信号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片，主营业务收入分产品构成情况如下：

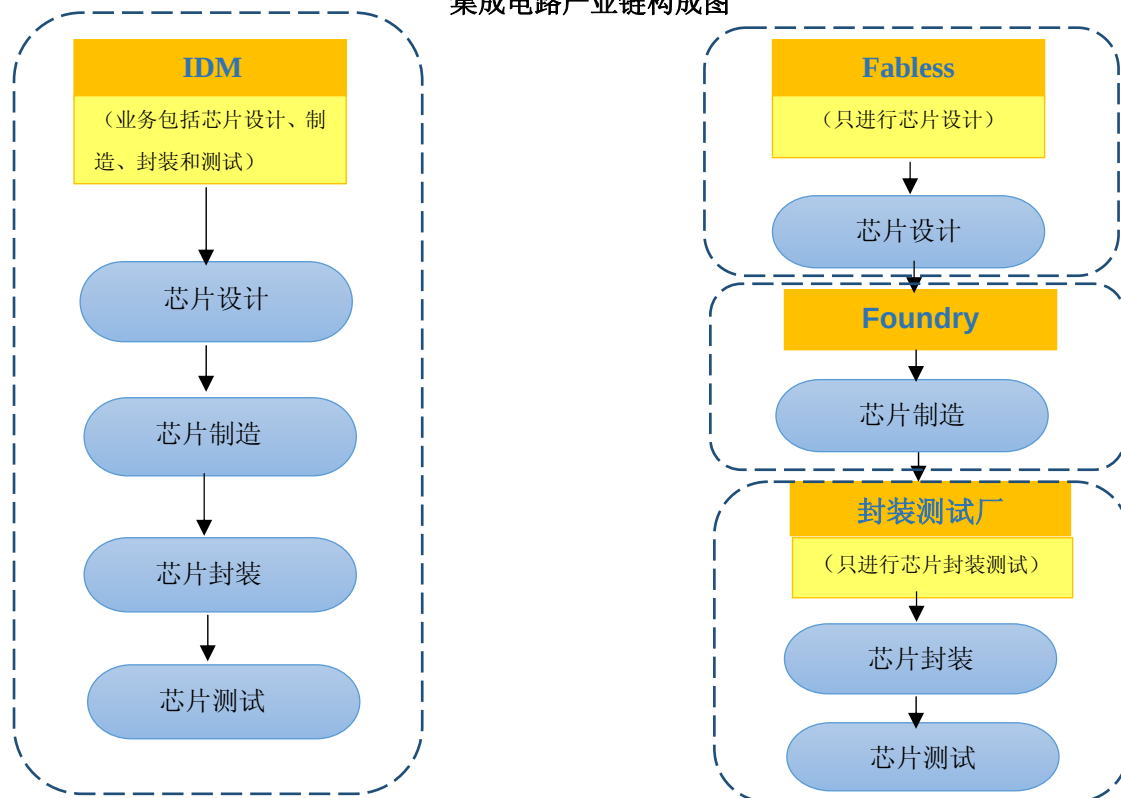
单位：万元，%		2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
信号链产品	金额	3,819.28	14,416.20	13,841.23	12,170.35
	比例	48.78	44.23	55.55	53.71
电源管理产品	金额	4,010.80	18,175.27	11,075.80	10,490.96
	比例	51.22	55.77	44.45	46.29
合计	金额	7,830.09	32,591.47	24,917.03	22,661.31
	比例	100.00	100.00	100.00	100.00

（二）公司主要经营模式

集成电路设计企业经营主要可分为 IDM 模式和 Fabless 模式。IDM 模式即垂直整合制造模式，是指企业除了进行集成电路研发之外，还拥有专属的晶圆、

封装和测试工厂，其业务范围垂直涵盖了集成电路的各个环节。Fabless 模式即无晶圆生产线集成电路设计模式，是指企业只从事集成电路设计和销售，其余环节分别委托给专业的晶圆代工厂、封装测试厂完成。

集成电路产业链构成图



Fabless 厂商专门从事芯片研发与销售业务，只需要组织研发团队和建设测试实验室，无须购置昂贵的生产厂房和设备；且 Fabless 厂商市场敏感度高，更专注市场产品需求变化，能快速响应市场需求，推出适合市场发展的新产品。

公司报告期内采用 Fabless 模式进行芯片的研发、生产与销售，且未来几年将不会产生较大变化。

1、产品研发模式

在 Fabless 运营模式下，产品设计研发环节是公司运营活动的核心。公司紧密跟踪与了解市场需求，通过可行性分析和立项，将市场现时或潜在应用需求转化为研发设计实践，通过电路设计、仿真和版图设计等一系列研发工作，将研发设计成果体现为设计版图；最终经由晶圆代工厂和封装测试厂的配合完成样品的生产、封装，再返回公司经过相关测试，达到量产标准。

（1）研发组织结构

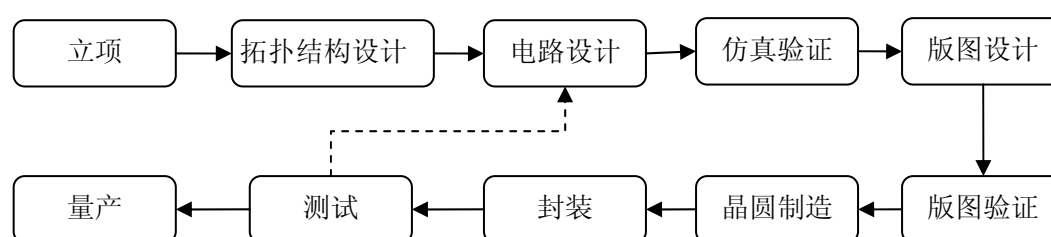
公司历来十分重视研发投入和建设，自成立以来持续不断地加大研发投入力

度、完善研发体制，这是公司长期可持续发展的坚实基础。

目前公司的研发部按产品线分为信号链和电源管理两大部门，承担公司全部新产品的研发任务。设部门主管，并有电路设计、版图设计、产品封装、工程测试等职能团队，并由项目负责人负责对项目进行全程监控和管理，及时解决出现的问题，保证新产品研发按计划顺利进行。

（2）产品研发流程

公司产品的研发过程可分为立项、实施、试产和量产等环节，每一环节都制定了相应的切实有效的细分流程和管理制度。新产品研发流程简图如下：



①产品研发立项阶段

公司市场部搜集整理新产品提案，对目标市场进行分析和调研，向公司提交项目可行性分析报告。由市场和研发等部门对项目可行性分析结果进行评估并正式立项；立项后，研发部安排项目负责人，并根据人员需求和工作量组建项目团队；明确开发目标，根据项目要求确定详细的产品性能参数、技术规格；制定产品开发计划，分阶段落实任务分工及完成标准。公司产品研发与市场需求紧密结合，并在立项与设计过程中确保产品的性能、参数处于行业先进水平。

②产品研发实施阶段

研发实施阶段包括拓扑结构设计、电路设计、仿真验证、版图设计和版图验证等环节。项目开始实施后，项目组研发人员根据产品设计和进度计划安排工作，以召开项目协调会的方式，协调资源，解决问题，确保研发工作顺利进行。在项目的关键节点，研发部组织其他相关部门负责人对阶段性研发成果进行评估和审查，发现问题并予以分析解决，为项目顺利进行提供保障。版图设计及验证完成后，进入流片试产阶段。

③产品试生产阶段

在试生产阶段，晶圆制造商根据公司提供的版图制成光罩。生产管理部向晶

圆制造商采购晶圆，并交与封装测试厂进行样品封装测试。样品返回公司后，研发部对其进行全面高标准的测试和评估，以确认产品达到高可靠性、一致性等设计要求；最后进入用户试用评测，通过后进入量产阶段。

2、采购生产模式

在 Fabless 模式中，芯片设计公司从晶圆制造商采购晶圆，交由封装测试厂封装测试，从而完成芯片生产。目前公司的晶圆制造商为台积电和联电，封装测试服务供应商为江阴长电、通富微电和成都宇芯。

（1）供应商的选择

公司选择供应商主要从工艺水平、加工品质、生产能力、商务条件等方面考虑。首先，供应商需具备成熟、稳定的工艺水平，齐全的工艺种类和封装形式；其次，供应商对产品质量有完备的保证；第三，供应商需拥有充足的产能，并能根据公司要求作出及时配合和调整；最后，能够提供较为优惠的商务条件。

晶圆制造为资本密集型、技术密集型行业，行业集中度较高，台积电是世界最大的晶圆代工厂商，其工艺比较成熟、先进，生产的晶圆具有较高的良率和一致性，较多行业内领先的芯片研发设计公司选用其作为晶圆供应商。因此公司也选择台积电为主要晶圆供应商。联电也是著名晶圆代工厂，同样具有工艺比较成熟、先进，良率和一致性较高的特点，发行人报告期内也与其进行了合作。除台积电和联电外，还有如华虹、中芯国际等其他晶圆制造厂商可供合作。

封测行业由于对资金和技术投入的要求与晶圆制造相比相对较低，行业集中度也相对较低。公司现在的封测供应商如通富微电、成都宇芯、江苏长电均为业内知名封测企业，除上述厂家外，还有如日月光、矽品等一些封测供应商可供合作。

公司与供应商保持了长期稳定的合作关系，双方互利互惠合作发展。一方面，公司对晶圆及封测厂商的技术参数较为熟悉，有利于研发项目的开展和可延续性，同时对于研发及生产过程中出现的问题也更易于分析解决；另一方面，供应商希望得到客户稳定持续的订单，以保证其产能的充分利用，公司对供应商长期稳定的采购，保证了供应商的产能的高效利用。

（2）采购生产流程

销售部会同市场部根据市场及客户需求制订销售计划，生产管理部根据销售

计划制定采购计划和生产计划。生产管理部根据采购计划向晶圆制造商下达订单，晶圆制造商安排生产。晶圆制造完毕，经过晶圆制造商质量检验合格后，送到指定的封装测试厂。其后，生产管理部根据生产计划，向封装测试厂下达订单，封装测试厂根据公司提供的封装要求对晶圆进行封装，然后根据公司提供的测试要求对成品进行检测，最后将成品发送至公司指定地点。

3、销售模式

按照集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。形成这一销售模式的原因有：一是公司终端客户数量较多、分布较广，经销模式有利于提高销售环节的效率；二是经销商自身具有广泛的客户资源，有利于公司产品的有效推广。

报告期内公司销售收入主要来源于经销模式，报告期内经销模式实现销售收入占比逾 95%，且未来几年仍将采用“经销为主，直销为辅”的模式进行产品销售。

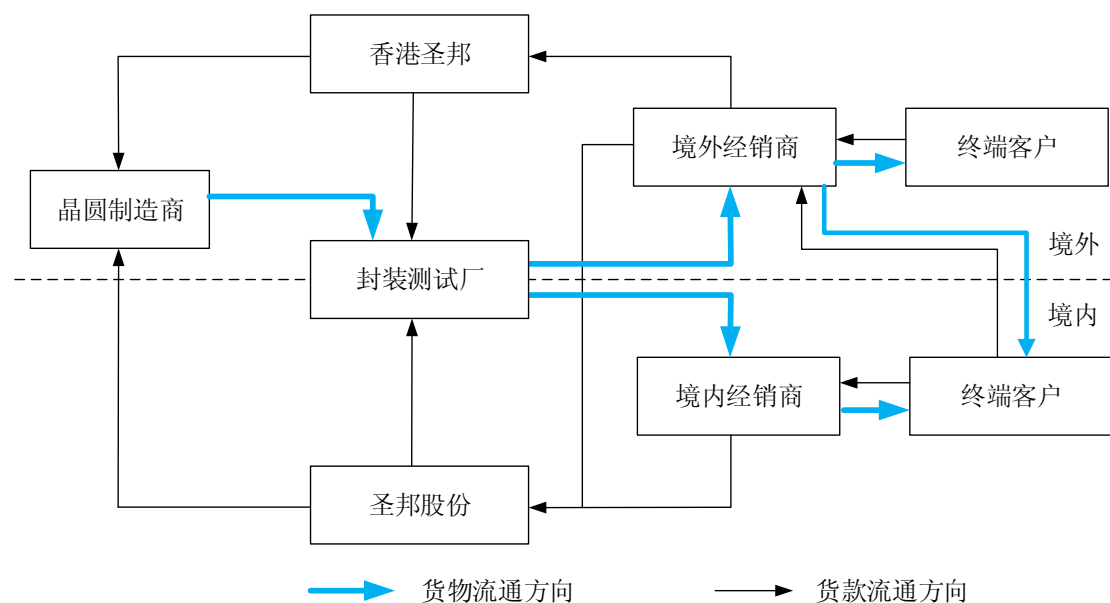
（1）圣邦股份的对外销售流程

圣邦股份作为境内公司，根据市场需求规划，向晶圆制造商下单采购晶圆，并用进口方式将制作完成的晶圆输送至境内封测厂，封测厂产出成品芯片后，送至公司的仓库或递送至公司客户指定的交货地点。①对于境外经销商：货物出口至经销商指定的境外交货点，往往在口岸交货；②对于境内经销商：货物直接递送到经销商指定的境内交货点。

（2）香港圣邦的对外销售流程

香港圣邦作为境外公司，以境外销售为主。根据市场需求规划，向晶圆制造商下单采购晶圆，晶圆制作完成后，由封测厂采用来料加工的方式将货物运送到保税区加工；封测厂产出成品芯片后，暂时存放在封测厂的仓库中，封测厂根据公司的指令，将货物运送到经销商指定的境外交货地点。

圣邦股份和香港圣邦的业务流程如下：



圣邦股份和香港圣邦的终端客户不存在实质性差异。由于香港为传统的亚太电子元器件交易集散地之一，对于业务经营不在香港的终端客户，也可能会有在香港对其终端产品所需的电子元器件向注册地在香港的经销商进行统一购买。

（三）主营业务和主要产品的变化情况

公司主营业务为模拟芯片的研发和销售，自设立以来未发生变化。公司自成立以来就专注于信号链类及电源管理类两大模拟芯片产品线的研发，陆续推出了线性稳压器、运放、模拟开关、音频功放、视频滤波、DC/DC 转换器、锂电池充电器、LED 驱动器等模拟芯片产品。

近年来随着物联网、移动智能终端、可穿戴电子产品等新技术、新应用领域的涌现和快速发展，公司紧随市场需求的变化发展不断推出升级换代产品以及新的产品类别，特别是针对智能终端大屏幕背光 LED 驱动、LED 闪光灯驱动、锂电池电能管理、超微功耗电源管理、过压保护、接口管理、负载管理等产品方向推出了一批具有先进水平的新型模拟芯片产品，如应用于智能手机的支持串并联的高压 LED 背光驱动器、双路大电流闪光灯 LED 驱动器、大动态背光 LED 驱动器、负载开关、OVP 保护电路、逻辑电平转换芯片、小电流充电管理芯片、超微功耗运放和比较器、超小封装 LDO 等。

（四）主要产品的生产工艺流程

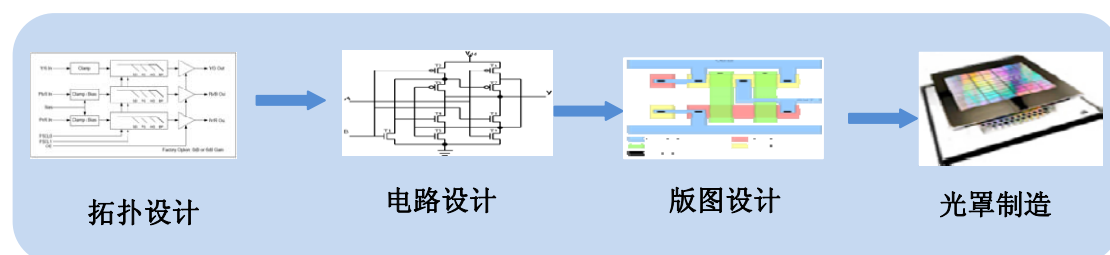
芯片研发环节的样品制造和量产环节的成品制造都涉及到芯片生产工艺流

程，包括光罩制造、晶圆生产、晶圆制造及封装测试等。其中，光罩制造发生在样品生产过程中，晶圆制造和封装测试则在样品和成品的生产中都有所涉及，而晶圆生产环节则为芯片制造提供了原材料。

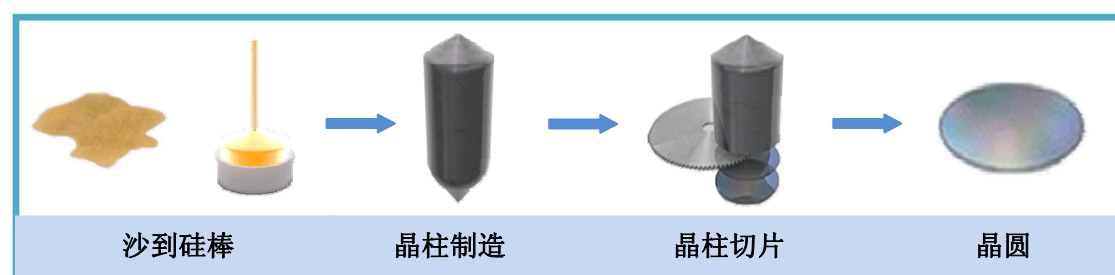
具体的芯片生产流程如下图所示：

1、光罩制造（由圣邦股份、晶圆制造商共同完成）

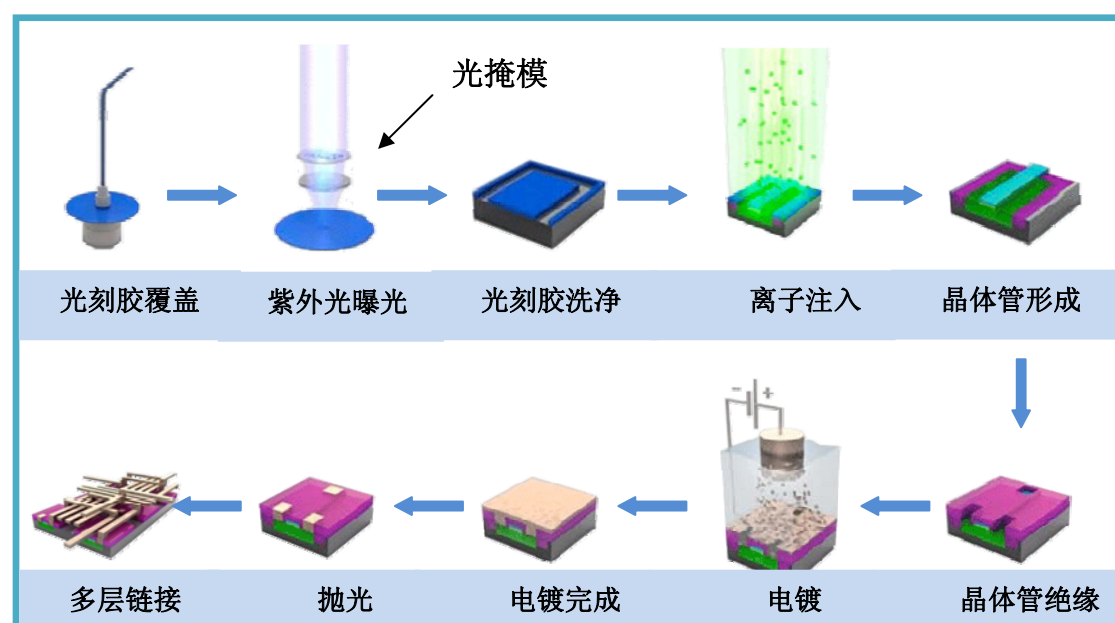
光罩是在生产半导体时，将线路印制在硅晶圆上所使用的模具。芯片设计公司完成产品设计后，将设计版图交付晶圆制造商，晶圆制造商依据版图制作光罩用于后续生产。



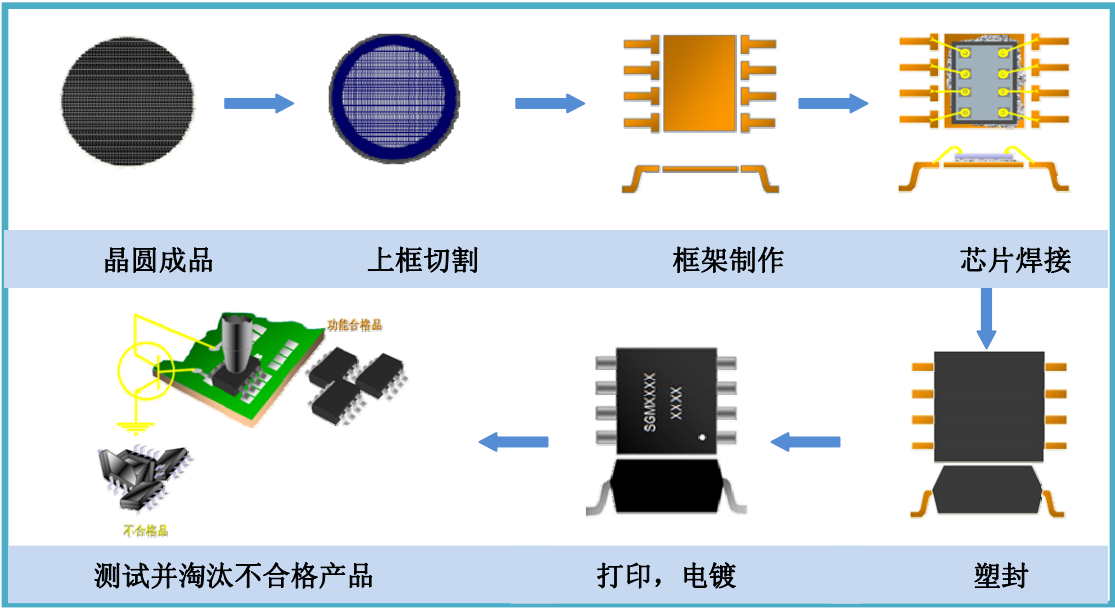
2、晶圆生产（由晶圆供应商完成）



3、晶圆制造（由晶圆制造商完成）



4、封装测试（由封装测试厂商完成）



二、公司所处行业的基本情况

（一）行业主管部门与管理体制

公司的主营业务为模拟芯片的研发与销售。根据中国证监会颁布《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

公司所处行业的主管部门是工业和信息化部。工信部负责制订行业的产业政策、产业规划，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。

中国半导体行业协会（CSIA）是中国集成电路行业的行业自律管理机构，主要负责产业及市场研究，对会员企业提供行业引导、咨询服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

工信部和中国半导体行业协会构成了集成电路行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。《集成电路产业“十二五”发展规划》、《国家集成电路产业发展推进纲要》等一系列政策法规提出集成电路行业是信息技术产业的核心，要大力发展集成电路设计业，上述政策法规对于发行人的经营有着较为积极

的影响。

（二）行业法规与政策

集成电路行业相关政策

序号	时间	颁布部门	政策名称	相关内容
1	2000/6	国务院	国发[2000]18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	通过一系列的投融资政策、税收政策、产业技术政策、出口政策、收入分配政策、人才吸引与培养政策等优惠政策，鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业。
2	2010/10	国务院	国发[2010]32号《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	确定重点发展的战略性新兴产业包括新一代信息技术在内的七大方向；其中新一代信息技术领域重点包括集成电路产业，以及物联网、三网融合等领域。
3	2011/1	国务院	国发[2011]4号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	首次提出鼓励、支持软件企业和集成电路企业加强产业资源整合，将对集成电路产业的支持提升到对软件产业同等的重要地位上；在财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权保护、市场等多方面，给予多项优惠与扶持。
4	2011/6	国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	确定了包括集成电路在内的当前优先发展的137项高技术产业化重点领域。
5	2012/2	工信部	《集成电路产业“十二五”发展规划》	提出着力发展芯片设计业，开发高性能集成电路产品。支持集成电路企业在境内外上市融资，引导金融证券机构积极支持集成电路产业发展，支持符合条件的创新型中小企业在中小企业板和创业板上市。
6	2012/4	财政部、国家税务总局	财税[2012]27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	规定集成电路设计企业，根据不同条件可以享受有关企业所得税减免政策，再次从税收政策上支持集成电路设计行业的发展。
7	2012/7	国务院	国发[2012]28号《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	提出围绕重点整机和战略领域需求，大力提升高性能集成电路产品自主开发能力；加强新一代半导体材料和器件工艺技术研发，培育集成电路产业竞争新优势。

序号	时间	颁布部门	政策名称	相关内容
8	2014/6	工信部	《国家集成电路产业发展推进纲要》	以设计、制造、封装测试以及装备材料等环节作为集成电路行业发展重点，提出从金融、税收、推广、人才、对外合作等方面对集成电路产业进行全方位支持
9	2015/3	财政部、国家税务总局	财税[2015]6号《关于进一步鼓励集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	规定集成电路封装、测试企业以及集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业，根据不同条件可以享受有关企业所得税减免政策，再次从税收政策上支持集成电路行业的发展。

（三）行业发展概况

1、相关概念

（1）模拟集成电路与数字集成电路

集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理连续函数形式模拟信号（如声音、光线、温度等）的集成电路；与之相对应的是数字集成电路，后者是对离散的数字信号（如用0和1两个逻辑电平来表示的二进制码）进行算术和逻辑运算的集成电路，其基本组成单位为逻辑门电路。

例如，若要传输一段亮度由小变大的光线，若用模拟信号进行传输（相应的应采用模拟集成电路），那么在传输过程中的光信号的幅度就会越来越大，且是平滑连续的；若采用数字信号传输，就要采用一种编码，先将每一级光线亮度大小对应一种编码（模数转换过程），编码的信号相对分散，则输出端可看见的光线分级也是离散的。

常见的模拟集成电路通常包括各种放大器、模拟开关、接口电路、无线及射频IC、数据转换芯片、各类电源管理及驱动芯片等，其设计主要是通过有经验的设计师进行晶体管级的电路设计和相应的版图设计与仿真；与此相对应的数字集成电路通常包括CPU、微处理器、微控制器、数字信号处理单元、存储器等，其设计大部分是通过使用硬件描述语言以基本逻辑门电路为单位在EDA软件的协助下自动综合产生，布图布线也是借助EDA软件自动生成。

（2）模拟集成电路的设计、制造、封装与测试

集成电路的产业链主要包括设计、制造、封装与测试。其中：

集成电路设计指在一块较小的单晶硅片上集成许多晶体管及电阻、电容等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法，将元器件组合成完整的电子电路的整个设计过程。模拟集成电路设计的一般过程包括：①电路设计：依据电路功能完成电路的设计；②前仿真：电路功能的仿真，包括功耗，电流，电压，温度，压摆幅，输入输出特性等参数的仿真；③版图设计（Layout）：依据所设计的电路画版图；④后仿真：对所画的版图进行仿真，并与前仿真比较，若达不到要求需修改或重新设计版图；⑤后续处理：将版图文件生成 GDSII 文件交予晶圆生产厂进行试生产。

晶圆的试生产与量产过程参见本节“一、发行人主营业务及其变化情况”之“（四）主要产品的生产工艺流程”。

封装测试是集成电路产业链必不可少的环节。封装是指对通过测试的晶圆进行划片、装片、键合、封装、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到的具有一定功能的集成电路产品的过程。封装一方面是通过将芯片固定于一个特定的芯片安装区域，并用适当的封装外壳将芯片、芯片连线以及相关引脚封闭起来，保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤，并通过封装材料的选择及增加额外固件增强芯片的散热性能；另一方面则是将芯片的输入输出端口联接到外部印制电路板(PCB)、玻璃基板等并实现电气连接与通信的过程。测试主要是对芯片、电路以及老化后的电路产品的功能、性能测试等，其目的是将有结构缺陷以及功能、性能不符合要求的产品筛选出来。目前，国内测试业务主要集中在封装企业中，通常统称为封装测试业或封测业。

2、集成电路设计业发展状况

早期的集成电路行业以生产为导向，制程工艺为核心关键要素。随着技术的进步和市场的不断变化，集成电路行业在经历了多次结构调整之后，已经逐渐由原来“大而全”形式的产业演化成目前“专而精”的多个细分子产业。在传统 IDM 公司继续发挥较大作用的基础上，芯片产业结构进一步专业化细分成为一种趋势，形成了设计业、制造业、封装和测试业独立成行的局面。其中，集成电路设计行业具有更接近和了解市场、更具创新性的特点，作为集成电路行业高增值环节，在整个集成电路行业中的比重逐步加大。近年来，全球芯片产业的发展越来越显示出产业链细分和模式多元化的活力。

（1）全球集成电路设计业的发展概况

自 1958 年美国德州仪器有限公司发明集成电路以来，整个集成电路产品的发展经历了从板上系统（System-on-board）到片上系统（System-on-a-chip）的过程。在此历史过程中，世界集成电路产业为适应技术的发展和市场需求经历了三次变革，集成电路设计业脱颖而出成为集成电路行业的“龙头”：

①第一次变革：以加工制造为主导的集成电路产业发展的初级阶段。

20 世纪 70 年代，集成电路的主流产品是微处理器、存储器以及标准通用逻辑电路。这一时期集成电路制造商在集成电路市场中开始扮演主要角色，集成电路设计只作为附属部门而存在。这时的集成电路设计和半导体工艺密切相关，主要以人工为主。集成电路产业处于以生产为导向的初级阶段。

②第二次变革：Fabless 模式的崛起。

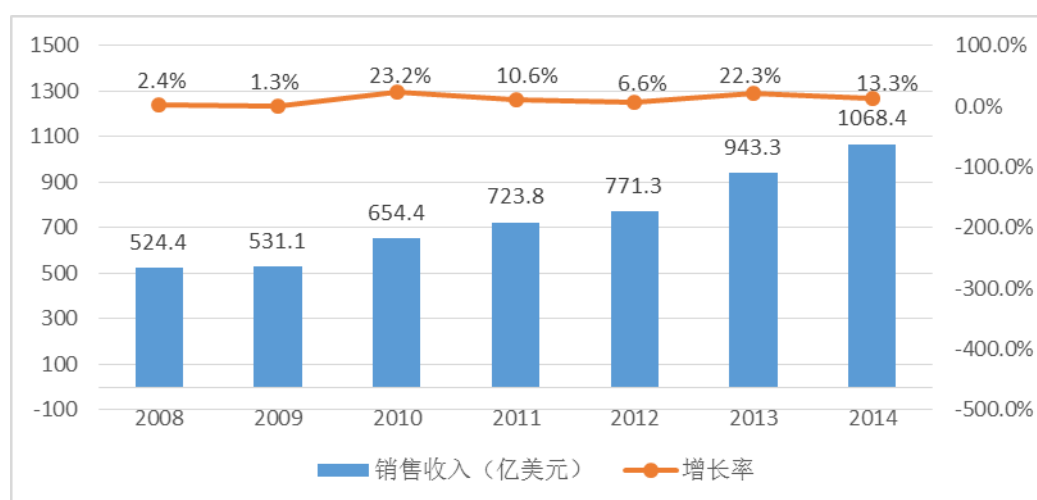
20 世纪 80 年代，随着微处理器和计算机的广泛应用和普及（特别是在通讯、工业控制、消费类电子等领域），集成电路产业已开始进入以客户为导向的阶段，此时，集成电路的主流产品为微处理器、微控制器（MCU）及专用 IC（ASIC）。由于客户个性化需求日益增多，同时集成电路设计软件 EDA 工具发展以及芯片微细加工技术的进步等客观条件已建立，设计过程开始独立于生产过程而存在，无生产线的集成电路设计公司与晶圆代工厂相结合的 Fabless 模式开始成为集成电路产业发展的新模式。

③第三次变革：以集成电路设计为龙头、“三业分离”的产业新格局。

90 年代，随着互联网的兴起，集成电路产业跨入以人才知识竞争、密集资本竞争为导向的新阶段。绝大多数厂商意识到，IDM 模式并不完全有利于自身的发展，“分”才能精，“专注”才成优势。于是，集成电路产业结构向高度专业化转化，逐步形成了设计业、制造业、封装测试业相互独立的局面。近年来，全球集成电路产业的发展越来越显示出这种结构的优势，特别是 2000 年以来，世界半导体工业的增长速度已无法达到从前的增长值，若再仅依靠高投入提升工艺，追求大尺寸硅片，通过大生产来降低成本推动增长，将难以为继。而集成电路设计企业更接近和了解市场，通过不断创新开发出高附加值的产品，直接推动着电子设备的更新换代；同时，在创新中获取利润，在快速发展的基础上积累资本并作出新投入，为整个集成电路产业的增长注入了新活力，并带动了整个半导体产业的发展。由此，集成电路设计业成为了集成电路产业的“龙头”。

集成电路设计业具有较稳定的增长能力和较强的抗周期能力，自 2001 年以来，集成电路设计业保持了年均近 20% 的增长速度，增速几乎是产业整体增速的 10 倍，其在整个半导体产业中的地位也随之快速蹿升。即使在 2009 年金融危机时期，全球设计业实现了 1.28% 的增长，2010 年在市场复苏的带动下实现了 23.22% 的增长，2011 年在全球经济增速放缓的情况下也仍实现了 10.61% 的增长。截至 2014 年，全球集成电路设计企业的营业收入规模为 1,068.4 亿美元，比 2013 年增长 13.3%。

2008-2014 年全球集成电路设计产业市场规模和增长率

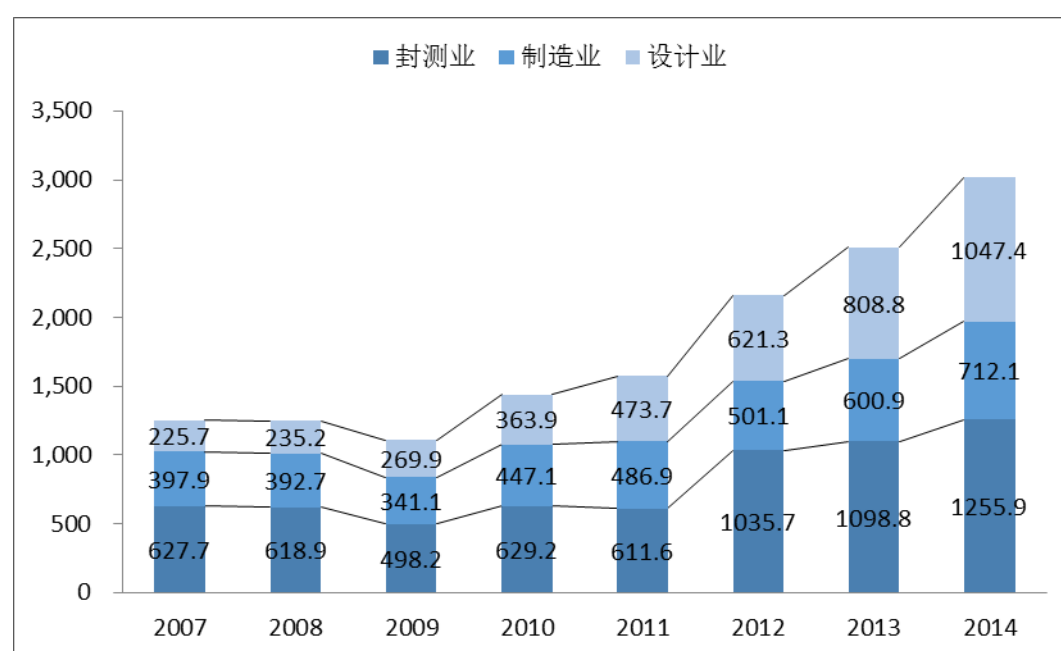


数据来源：赛迪顾问，《2014 年-2015 年中国模拟集成电路市场研究年度报告》

（2）我国集成电路设计业的发展概况

集成电路设计业同样是我国集成电路产业发展的源头和驱动力量。近年来我国集成电路设计业销售收入以及在行业中占比均呈显著上升趋势，2014 年设计业的销售收入为 1,047.4 亿元，同比大幅增长 29.5%，占集成电路行业比重为 34.7%。自 2009 年以来，集成电路设计业占产业链比重稳步增加，由 2009 年的 24.3% 增至 2014 年的 34.7%，我国的集成电路产业链结构逐步优化。

中国 2007-2014 年集成电路子行业销售收入（亿元）



数据来源：CSIA，《中国半导体产业发展状况报告（2015版）》

注：图中数据为中国集成电路企业的销售收入

中国集成电路设计业近十年来取得了长足的进步，一是得益于十多年来国家政策的大力扶持和倾斜，2000 年颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和 2014 年颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》等若干政策的相继推出有力推动了集成电路设计行业的发展和壮大；二是得益于信息技术的进步和企业创新能力的提升，上游晶圆制造业与封装测试业的生产工艺水平的提高，以及设计企业自身研发能力的增强，都为集成电路设计行业从量变到质变的飞跃奠定了坚实的基础；三是得益于集成电路应用领域的拓展和国内市场需求的不断扩大，人们对智能化、集成化、低能耗的需求不断催生新的电子产品及功能应用，国内集成电路设计企业获得了大量的市场机会；四是中国作为全球电子产业制造基地的地位不断巩固，国内集成电路设计企业凭借本地优势，紧贴市场需求，快速响应，客户认可度及品牌影响力不断提升，进而显现为整个中国集成电路设计行业的突飞猛进。

我国目前重点培育和发展的战略性新兴产业都需要以集成电路产业作为支撑和基础，这给未来的集成电路设计业带来很大的发展空间。移动互联网、物联网、三网融合、云计算、新能源、半导体照明、汽车电子、医疗电子和可穿戴设备等新兴领域的发展将为集成电路设计业带来持续不断的新动力。

3、模拟芯片行业的发展状况

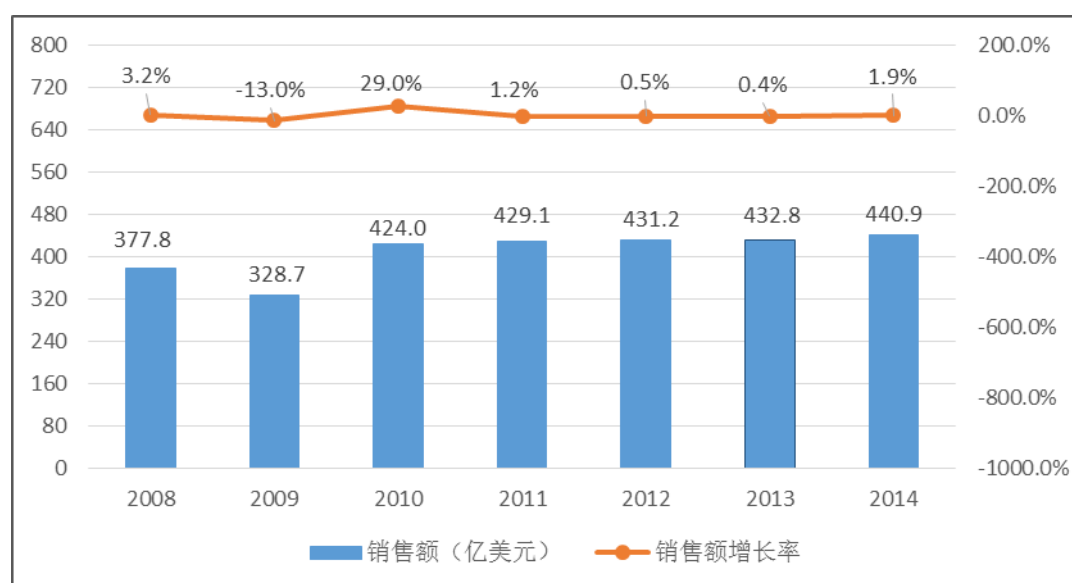
模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟或连续信号的集成电路。在现今的电子产品中，模拟芯片几乎无处不在：以世界博览会为例，从展览会场中的大型视频广告牌、视频监控系统、LED展示板、医疗设备、交通运输系统，到高清电视等，都涵盖了包括运算放大器、LED 背光驱动、音视频驱动、模数/数模转换器、接口电路等在内的多种模拟芯片。

随着客户和市场也正逐步从对器件功能的基础要求上升到对整体系统性能的深层需求，越来越多的产品被要求具备更高的精度、更快的速度、稳定清晰的声音、生动绚丽的图像、更长的电池使用时间等，在这样背景下，以放大器、转换器、电源管理、用户界面为代表的模拟芯片技术成为电子产业创新的一个新引擎。

(1) 全球模拟芯片发展概况

基于终端应用范围宽广的特性，模拟芯片市场不易受单一产业景气变动影响，因此价格波动远没有存储芯片和逻辑电路等数字芯片的变化大，市场波动幅度相对较小。某种意义上来说，模拟芯片是电子产业的晴雨表，基本代表了整个市场的发展状况。2014 年，模拟芯片市场全年实现销售收入 440.9 亿美元，同比增长 1.9%。

2008-2014年全球模拟芯片市场规模与增长

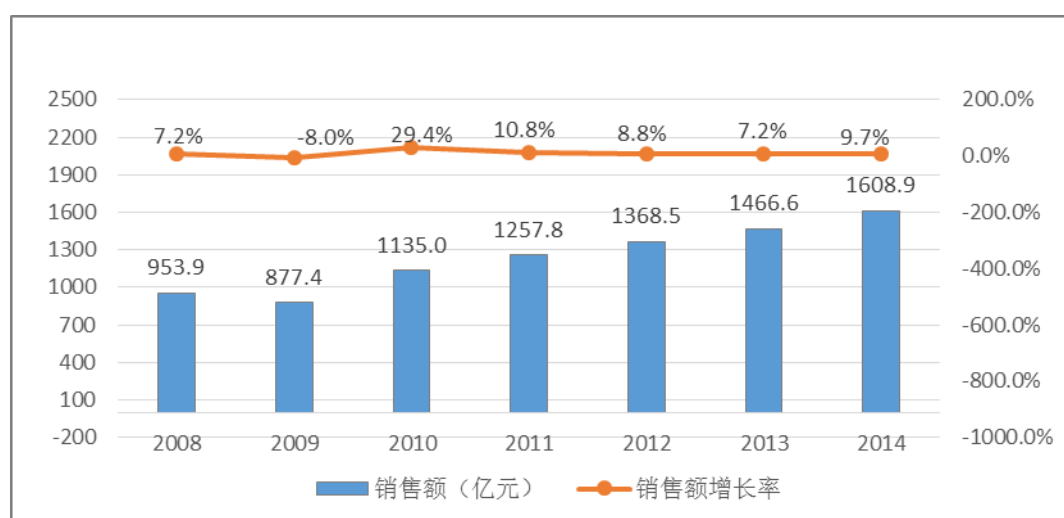


数据来源：赛迪顾问，《2014 年-2015 年中国模拟集成电路市场研究年度报告》

（2）我国模拟芯片发展概况

2013 年我国模拟芯片市场规模为 1,466.6 亿元,与 2012 年相比,增幅为 7.2%,增速有小幅下降。2014 年随着世界经济复苏带动了整机出口的回暖,我国的模拟集成电路市场呈现平稳增长态势。2014 年中国模拟芯片市场销售额达 1,608.9 亿元,实现同比增长 9.7%。综合来看,最近三年我国模拟芯片市场发展呈现出稳定增长的态势,且明显超过全球模拟芯片市场的增速。

2008-2014年中国模拟芯片市场规模与增长



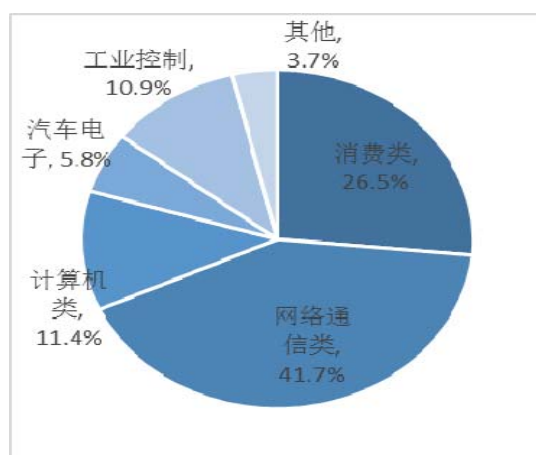
数据来源:赛迪顾问,《2014年-2015年中国模拟集成电路市场研究年度报告》

注:图中数据为中国模拟芯片的销售额,其中包括境外企业的在华销售。

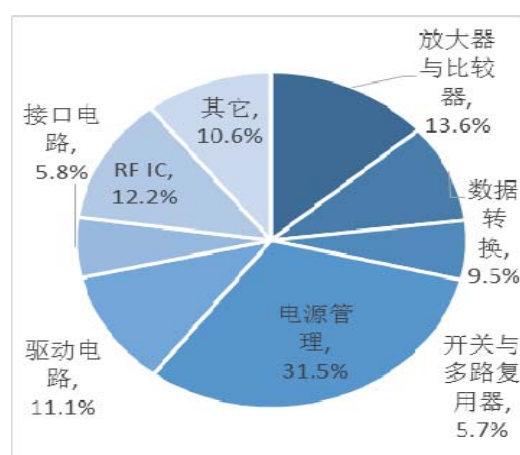
从应用结构来看,网络通信领域依旧是我国模拟芯片最大的应用市场,2014 年市场份额达到 41.7%,这主要得益于宽带中国战略的实施,4G 城市的建设以及移动基站的部署等行业推动因素;同时,移动通信终端和便携式移动互联设备的增长也是网络通信领域市场规模增长的重要因素。汽车电子成为继网络通信领域之后成为带动中国模拟芯片市场增长的第二大领域,2014 年市场规模为 93.3 亿元,实现同比 14.5% 的快速增长。

从产品结构来看,驱动电路受益于中国 LED 等平板显示应用产品的市场渗透率进一步提升,实现了市场规模的进一步增长。2014 年,驱动电路产品全年市场规模为 178.6 亿元,实现同比增长 11.5%。

2014 年中国模拟集成电路终端应用领域结构



2014 年中国模拟集成电路市场产品结构



数据来源：赛迪顾问，《2014年-2015年中国模拟集成电路市场研究年度报告》

（四）公司与上下游行业的关系及影响

集成电路设计行业的上游是晶圆制造商以及封装测试厂商，下游行业是通讯、计算机、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等众多终端应用行业。

1、与上游行业的关联性

集成电路上游晶圆制造商以及封装测试厂商对集成电路设计业的影响：

（1）受托加工企业的晶圆制造和芯片封装的工艺水平、集成电路测试的技术能力直接影响芯片产成品的质量，上游企业的工艺技术水平、稳定性和成熟度越高，产品良率也就越高；

（2）模拟集成电路种类繁多，相应地，需要上游晶圆制造商和封装测试厂商拥有较为齐全的工艺种类和封装形式，供模拟设计企业进行多样化的选择；

（3）成熟的晶圆制造商和封装测试厂商能够与设计企业进行高效的技术交流和及时反馈，为设计企业提供技术支持；

（4）受托加工企业的产能直接决定集成电路设计企业产品的出货量，从而影响集成电路设计企业的交货周期。

目前行业内能够提供优良晶圆制造和芯片封装测试服务的企业较多，产能充足，且其技术工艺和服务水平不断提高，对集成电路设计行业的发展有良好的促进作用。

2、与下游行业的关联性

当前市场对下游整机电子产品的旺盛需求，带动了对上游集成电路产品的需求。从应用领域来看，3C 领域²仍然是中国模拟集成电路产品主要的应用领域，其市场份额一直保持在整体市场的 70%以上。其中网络通信领域依然是中国模拟集成电路市场最大的应用领域，移动终端用户数的增长和移动互联网等新业务的普及引发的换机潮为模拟集成电路行业企业创造了广阔的发展空间。此外，医疗电子、汽车电子、节能照明等行业的兴起都离不开模拟芯片市场的发展。下游行业的增长态势将带动模拟集成电路行业的整体增长。

（五）行业竞争情况

1、集成电路设计子行业地位

集成电路设计行业是集成电路产业链的一个细分行业，该行业的竞争格局具有集成电路行业竞争状况的共性因素，具备完整芯片设计、制造、封装和测试的 IDM 厂商与专业从事芯片设计业务的 Fabless 厂商构成了市场的竞争主体。集成电路设计行业主要有如下几个特征：

（1）IDM 厂商具有较强的全球市场控制力。IDM（Integrated Device Manufacture，集成器件制造）模式集合芯片设计、制造、封装测试和销售各个环节为一体或其中两三个环节为一体，能够充分整合产业链各环节资源，企业通常规模较大，综合实力很强，在行业处于景气上升阶段能够充分发挥其规模经济优势。典型的 IDM 企业包括英特尔（Intel）、三星（Samsung）、意法半导体（ST Microelectronics, STM）等。IDM 企业的市场控制力体现在两方面：一方面，IDM 企业规模庞大，整体投入巨大，全面涉入芯片设计、制造、封装和测试的产业链，个别企业还涉及芯片应用领域，抗风险能力强；另一方面，IDM 企业设计能力及制造技术均处于领先地位，引领行业基础技术走向，在整个半导体产业链上拥有自己的产品，具有产品市场主导权。

（2）Fabless 厂商在芯片设计业市场具备竞争优势，国内芯片设计企业主要采用 Fabless 模式运营。Fabless 厂商专门从事芯片设计业务，具有三方面竞争优势：一是投资规模小，Fabless 厂商只需要组织研发团队和建设测试实验室，

² 3C 领域是指电脑 Computer、通讯 Communication 和消费类电子 Consumer Electronic 三个领域

无须购置昂贵的生产厂房和设备；二是团队素质要求高，芯片设计作为集成电路产业的前段环节，其技术含量高，企业创新能力强，需要配置高素质的人员团队；三是市场敏感性高，Fabless 厂商更专注市场产品需求变化，能快速响应市场需求，推出适合市场发展的新产品。对比 IDM 厂商，Fabless 厂商在新兴市场和细分市场具备竞争优势。

2、模拟集成电路设计行业竞争状况

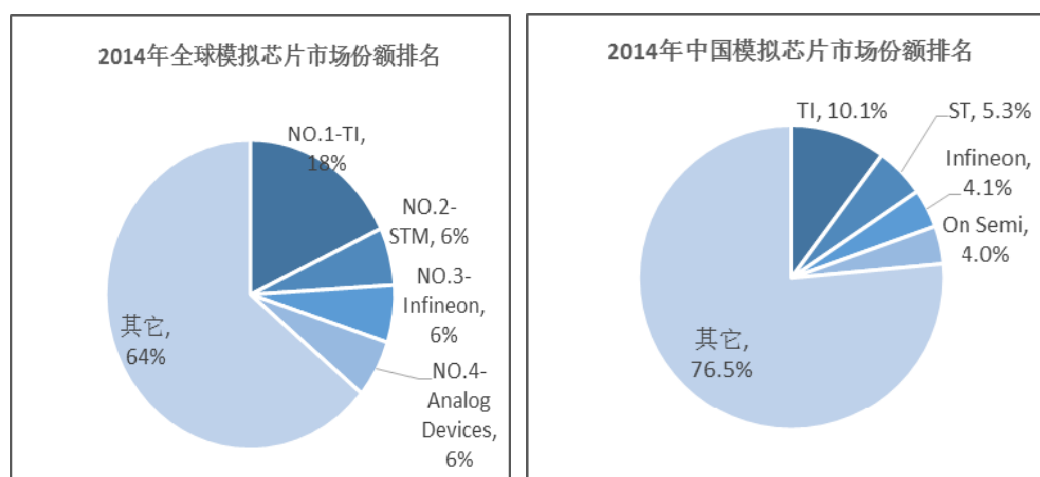
在中国模拟芯片领域，国外品牌和产品仍旧占据市场领先地位。过去国内模拟集成电路企业由于起点低、工艺落后等因素，在技术和生产规模上都与世界领先水平存在着较大的差距。近年来，掌握世界先进技术的本土模拟集成电路企业的崛起使中国高性能模拟集成电路水平与世界领先水平的差距逐步缩小，不少国内高端模拟芯片空白得以填补，在某些产品领域甚至达到和超越了世界先进水平，展现了良好发展势头。国内模拟集成电路企业经过数年发展，技术经验不断积累，产品种类不断丰富，品牌知名度和市场认知度不断提高，管理和服务更加趋于完善，本地支持的优势开始展现，市场前景看好。未来几年里，中国模拟芯片市场将呈现本土企业竞争力不断加强、市场份额持续扩大的局面。

3、模拟集成电路设计行业市场化水平

目前，国内外模拟集成电路设计企业众多，行业已经高度市场化。我国模拟集成电路设计行业已基本实现市场化竞争，形成了企业自主经营，政府职能部门宏观调控，行业协会自律规范的态势。

4、行业内的主要企业

从全球市场来看，2014 年排名前四的模拟芯片供应商占据了约 40% 的市场份额，分别是 TI、STM、Infineon、Analog Devices。从中国市场来看，2014 年排名前四的模拟芯片供应商占据了 23.5% 的市场份额，分别是 TI、STM、Infineon、On Semi，其中排名前三的模拟芯片供应商的市场品牌排名与全球市场保持一致，但市场集中度低于全球市场。



全球市场数据来源：CISA，5.15.2015, (<http://www.csia.net.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=49520>)

中国市场数据来源：赛迪顾问，《2014-2015 年中国模拟集成电路市场研究年度报告》

由上图可见，无论全球市场还是中国市场，模拟芯片供应商以欧美企业为主。

（1）美国企业

美国目前是全球半导体产业最发达的国家，也是世界上模拟芯片技术最领先的国家之一。在 2014 年全球前十大模拟芯片公司中，美国公司占据了 6 家，拥有 TI、ADI、Maxim 等众多知名模拟芯片供应商。

（2）欧洲企业

欧洲同样是半导体产业技术全球领先的区域之一。欧洲具有代表性的模拟芯片厂商是三家半导体大厂，分别是 STM、Infineon 和 NXP。

（3）日本企业

日本历来在全球半导体市场占据重要地位，拥有包括 Renesas 在内的一批优秀的模拟芯片供应商，但由于金融危机、汇率波动和新产品开发滞后等因素，日本模拟芯片企业受到负面影响，市场份额不断下滑，近几年相比韩国及台湾企业已不具明显优势。

（4）亚太（除日本）企业

由于近年来全球模拟芯片研发中心积极向亚太地区转移，大幅度提升了亚太地区的模拟芯片设计水平，逐渐形成本地模拟芯片完整的产业链条，本地的模拟芯片市场得到快速发展。

5、进入本行业的主要障碍

（1）技术壁垒

模拟芯片设计业具有较高的技术壁垒，该技术通常依靠设计企业的长期摸索和实践积累，逐步形成各自核心竞争力。模拟芯片的设计需要企业具备强大的综合设计能力，包括对器件物理特性的掌握和理解、拓扑结构的设计技巧以及版图布线的设计能力等，往往需要 5 年以上的时间积累。此外，企业能够在竞争中胜出并保持优势，有赖于其持续的技术创新以及契合市场需求的高性能产品的持续推出。因此，是否拥有卓越的产品设计技术，能否紧跟模拟芯片设计行业的高速发展以及强大的持续创新能力是进入本行业的一大壁垒。

（2）人才壁垒

集成电路设计属于知识密集型行业，拥有优秀的技术研发和销售团队是企业得以成功的重要因素之一。与数字芯片设计的规范化、抽象化不同，模拟芯片的研发人员不仅需要掌握集成电路设计所需的基础知识，还需要了解模拟芯片设计相关领域的技术细节，因此模拟芯片设计人员的经验积累程度对所设计产品的技术水平和整体性能起到了至关重要的作用，其一般要拥有五至十年设计经验才能够独立完成芯片设计。此外，市场销售人员由于肩负着与终端厂商就技术细节在售前和售后持续沟通的使命，所以其在模拟芯片领域的专业技术背景和相关销售经验也不可或缺。随着本行业不断迅速发展，有经验和技术的高端人才的需求缺口日益扩大，能否吸引优秀的研发、市场和销售人才成为进入本行业的主要障碍之一。

（3）市场壁垒

经过多年发展，我国集成电路设计行业逐渐进入平稳增长的相对成熟阶段，在集成电路芯片应用的各细分市场，客户对自己认可的芯片品牌已形成一定的忠诚度。尤其在模拟芯片领域，整机客户对产品的稳定性、可靠性、一致性要求较高，对模拟芯片的认证要求严格、认证周期较长，且比较注重芯片厂商产品的多样性、齐套性以及后续延展性，因此通常会认可技术先进、产品质量可靠、种类丰富且持续开发能力强的领军企业，行业的新进入者通常难以在短期内取得客户认可，突破现有的市场竞争格局。

6、行业利润水平的变动趋势及变动原因

从集成电路行业的大环境来看，集成电路设计子行业的利润水平受到行业整体发展状况和行业平均利润率水平的影响。尤其是一些面向国内需求、具有自主

创新能力和核心技术积累的设计企业，受益于国家刺激内需的政策拉动，将实现利润水平的持续增长。此外，集成电路设计行业的利润水平还与企业技术水平和创新能力密切相关。集成电路行业更新换代快，只有能够不断满足市场需求的创新型产品才能维持相对较高的利润率。可以预见，未来我国集成电路设计业的利润将进一步向拥有核心技术、具备产品创新能力、具有品牌优势并能准确把握市场需求的优势企业集中。

（六）影响公司发展的有利因素与不利因素

1、有利因素

（1）政府鼓励扶持集成电路产业发展

集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，其战略地位日益凸显。国家高度重视推动集成电路产业发展，自 2000 年以来，制定了一系列配套扶持政策。其中尤其值得关注的是，2011 年 1 月，国务院发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，相对 2000 年颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，该政策被业界称为新 18 号文。新 18 号文首次提出鼓励、支持软件企业和集成电路企业加强产业资源整合，将对集成电路产业的支持提升到和软件产业同等重要的地位上。

继新 18 号文颁布之后，工信部于 2014 年 6 月最新颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》。该纲要提出相关产业链企业要按照“需求牵引，创新驱动，软硬结合，重点突破，开放发展”的原则着力发展集成电路设计业，加速发展集成电路制造业，提升先进封装测试业发展水平，突破集成电路关键装备和材料，同时提出了成立国家集成电路产业发展领导小组以强化顶层设计，设立国家产业投资基金，加大金融支持力度，落实税收支持政策等一系列政策保障措施。该纲要的推出实施将有助于加快企业技术进步，增强企业自主研发能力，提高国内集成电路企业的国际竞争力，促进国内集成电路产业的持续快速健康发展。

（2）我国市场需求带来巨大发展机遇

作为全球最大的集成电路消费市场，中国为半导体行业带来了巨大的成长机会。国际金融危机爆发后，中国半导体产品消费市场的表现要好于全球其他任何一个区域市场。主要原因是中国迅猛发展的城市化进程，日益增加的消费量和绿

色能源倡导。但是，我国自行设计生产的产品只能满足部分本土市场需求。目前，我国使用的模拟集成电路产品约占世界产量的 45%，而我国的模拟芯片产量仅占世界份额的 10%左右。巨大的产业缺口为本土集成电路公司提供了良好发展机遇。本土集成电路公司有机会在第一现场了解市场，可有针对性地进行产品研发，产业链之间合作更加密切，相对国外厂商能够更快速、更准确地响应本土终端客户的需求，未来进步空间广阔。

(3) 产业转移和上下游协同作用

随着全球集成电路产业重心向中国转移，国内外知名的晶圆制造商、封装测试企业纷纷在我国建立或扩充生产线，为国内集成电路设计企业提供了充足的产能基础，对芯片设计业起到了良好的上下游协同作用；此外，全球知名的集成电路企业也纷纷在中国设立研发中心，促进了国内集成电路设计行业的良性竞争，也促进了行业人才的培养和技术的积累。芯片设计与芯片制造、封装测试以及下游应用相辅相成，它们的整合和链接是整个产业的重要推动力，也是打造战略性新兴产业价值链的关键。目前，我国集成电路制造业、封测业以及计算机、通讯设备厂商等不断发展壮大，产业链上下游协同性不断提高，芯片、软件、整机、系统、应用等各环节互动愈发紧密，为从“中国制造”向“中国创造”转型奠定了坚实的基础。

(4) 下游市场发展推动模拟芯片市场增长

模拟芯片用途广泛，产品应用涉及工业控制、汽车电子、网络设备、消费类电子、移动通信、智能家电等众多领域。广阔的应用领域及相关应用终端的繁荣是模拟芯片产业稳步上升的有力支撑。同时，以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、智能电网、新能源、节能照明等为代表的战略性新兴产业快速发展，成为继计算机、网络通信、消费类电子之后推进集成电路产业发展的新动力。中国内需市场在未来几年将进一步扩大，各种电子终端设备对智能化、节能化的要求不断提高，这将加速电子产品的更新换代，进而推动模拟芯片市场的增长。

(5) 模拟芯片在集成电路产业中的地位日益重要

整机厂商想要使其产品差异化，就需要更多种类模拟芯片产品的配合；同时，在用户体验越来越受重视的今天，电子设备的功能不断升级，对模拟芯片的性能提出了更高的要求。例如高质量音乐播放器实现多声道、立体声、3D 环绕等多种功能需要不同类型音频放大器的支持；LED 显示及照明产业的发展则离不开

LED 驱动技术的创新来推动；此外，能效和功耗是今天电子产品设计的关键因素，电源管理类芯片越来越被重视。可见模拟芯片在集成电路产业中的地位日益重要。

2、不利因素

（1）核心技术薄弱

国内集成电路设计企业在技术积累方面与国外厂商存在较大差距。尽管我国政府和企业愈发重视对集成电路产业的研发投入，但由于技术发展水平、人才培养等方面的滞后性，以及企业资金实力不足等原因，我国集成电路产业的研发力量薄弱、缺乏自主创新能力的状况依然存在。就模拟芯片设计行业而言，在高精度运放、低噪声仪表放大器、高速接口芯片、高性能电源管理、高速 ADC 芯片等高端模拟芯片细分领域，国内企业在设计环境、设计工具、设计人才和设计经验方面与世界先进水平还存在较大差距。

（2）设计人才不足

芯片设计业属于知识密集型行业，尤其是模拟芯片设计业，除需具有丰富的芯片设计专业知识以外，是否熟练掌握芯片制作工艺流程以及半导体器件物理特性也非常重要。相对于美欧等地，大陆范围内经验丰富的模拟芯片设计人才相对稀缺，这是造成国内模拟芯片设计整体技术基础弱、水平较低的主要原因。尽管近年来我国对芯片设计业人员培养力度逐步加大，包括海归在内的专业设计人员的数量也逐年上升，但人才匮乏的情况依然普遍存在，模拟芯片企业需要自主培养设计人才，现已成为当前制约行业发展的主要瓶颈。

核心技术薄弱以及设计人才不足的情况，将随着企业对内自身发展和积累、对外并购整合、积极招聘人才并在多地开设新的研发中心等措施得以逐步改善和解决。

三、行业竞争地位

（一）行业内的主要竞争对手

公司主要模拟芯片的综合性能与世界领先的国际企业的同类产品在同一水平，因此主要竞争对手为全球知名模拟芯片的厂商，具体如下（按公司名称首字母排序）：

1、亚德诺半导体技术有限公司（Analog Devices, Inc.）³

亚德诺半导体技术有限公司（ADI）成立于 1965 年，是世界上历史最悠久的半导体公司之一，目前是数据转换和信号调理技术全球领先的高性能模拟集成电路供应商。在中国市场上，ADI 成立了大中华区客户服务中心，通过其来加快中小型客户市场的开拓速度，加强与客户的沟通和联系；凭借其自身优势，积极参与我国 3G 网络、智能电网、物联网等新兴领域的研发与建设。其主要产品包括：数据转换器、放大器和线性产品、射频（RF）芯片、电源管理产品、基于微机电系统（MEMS）技术的传感器、其他类型传感器以及信号处理产品，包括 DSP 和其他处理器。

2、英飞凌公司（Infineon Technologies）⁴

英飞凌科技公司（Infineon）成立于 1999 年，其前身为西门子集团的半导体部门，主要为有线和无线通信、汽车及工业电子、内存、计算机安全及芯片卡市场提供现金的半导体产品及完整的系统解决方案。公司目前在中国已经拥有 8 家公司和 1700 多名员工，主要产品包括汽车系统芯片、静电放电（ESD）与电磁干扰（EMI）类产品、微控制器（或单片机）、射频与无线控制、安全芯片、传感器芯片、智能卡芯片、收发器、晶体管与二极管等。

3、凌力尔特公司（Linear Technology Corporation）⁵

凌力尔特公司（Linear）成立于 1981 年，是一家设计、制造和销售门类宽泛的标准模拟和混合高性能集成电路的半导体公司。为更好地支持和服务日益增长的中国客户，Linear 在中国市场建立了北京、上海、深圳、香港办事处。其主要产品包括：放大器、电池管理、数据转换器、高频、接口、电压调节器和电压基准。

4、美信集成产品公司（Maxim Integrated Products）⁶

美信集成产品公司（Maxim）成立于 1983 年，是全球范围内模拟和混合信号集成产品的设计、开发与生产领域的领导者之一，致力于为客户提供高集成度的芯片产品。Maxim 非常重视中国市场，在上海和深圳两地设有技术中心，在北京、上海和深圳拥有三个代表处。其主要产品包括：数据转换接口电路、射频

³ 信息来源：<http://www.analog.com/cn/about-adi/corporate-information.html>

⁴ 信息来源：<http://www.cadmm.com/com/infinesale/introduce/>

⁵ 信息来源：<http://www.linear.com.cn/products/>

⁶ 信息来源：<http://www.maximintegrated.com/cn.html>

芯片、时钟与振荡器、电池管理电路、光纤收发器、存储管理、微控制器、运算放大器、电源管理电路、T/E 载波收发器、开关与复用器、传感器、电压基准、自动识别等。

5、意法半导体（STM）⁷

意法半导体（STM）成立于 1987 年，以业内最广泛的产品组合著称，具备多元化的技术、尖端的设计能力、知识产权组合、合作伙伴战略和高效的制造能力。公司的产品战略专注于传感器与功率芯片、汽车芯片和嵌入式处理解决方案。传感器与功率芯片包括 MEMS 和传感器、分立和先进模拟产品；汽车芯片囊括所有主要应用领域，包括动力总成、安全系统、车身和信息娱乐等。嵌入式处理解决方案包括微控制器、数字消费、影像芯片、应用处理器和数字 ASIC 等。

6、德州仪器（Texas Instruments）⁸

德州仪器（TI）成立于 1947 年，主要从事数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售，处于全球模拟集成电路市场的领导地位，在包括数字信号处理器、模数/数模转换器、模拟集成电路等不同产品领域都占据领先地位。目前 TI 的销售、市场、研发以及制造员工遍及中国 16 个城市，其主要产品包括各种放大器、比较器、电源管理、射频 芯片、数据转换、接口电路等模拟集成电路产品和 DSP 数字信号处理产品。

（二）公司的市场地位

公司一直以“多样性、齐套性、细分化”为产品发展战略目标，自设立以来，不断增加新的产品系列，细化产品功能，拓展应用领域，以满足客户不断增加的多样化需求。公司为国内模拟集成电路设计行业知名企业，连续七年（2008-2014 年）获得由 Global Sources 旗下《电子工程专辑》颁发的“十大中国 IC 设计公司品牌”奖（2014 年该奖项更名为“五大中国 IC 设计公司品牌”），公司部分产品曾分别获得由科技部颁发的“国家重点新产品证书”和北京市人民政府颁发的“北京市科学技术奖二等奖”、“北京市科学技术奖三等奖”等荣誉。

公司未来存在较大的成长空间。一方面模拟芯片市场本身在不断增长，另一方面，从全球来看，公司产值在全球模拟芯片市场占比较低，拓展公司现有市场

⁷ 信息来源：http://www.st.com/web/cn/about_st/st_company_overview.htm

⁸ 信息来源：<http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=33988>

份额也存在较大潜力。未来，随着研发实力的进一步提升，销售规模的持续扩大，公司在国内集成电路设计业的行业地位将进一步提升，更多产品达到国际先进水平，将逐步成为国际一流的模拟集成电路设计企业。

（三）公司的竞争优势与劣势

1、竞争优势

（1）技术优势

公司自成立以来，一贯以技术研发为第一要务，经过多年的研发投入和技术积累，在模拟芯片的设计技术上积累了丰富的经验。截至 2015 年 6 月 30 日，公司已形成了多项核心技术，共拥有六十余项集成电路布图设计登记证书、十余项已授权专利。公司拥有北京市科学技术委员会等四部门颁发的“高新技术企业证书”和工信部颁发的“集成电路设计企业认定证书”。2008 年以来，公司连续多年获得由 Global Sources 旗下《电子工程专辑》颁发的“十大中国 IC 设计公司品牌”奖（2014 年该奖项更名为“五大中国 IC 设计公司品牌”）。

公司的核心技术以及自主研发的多款产品已处于先进水平，如静态电流 300nA 的微功耗运算放大器、工作电流 300nA 的超低功耗比较器、输入失调电压典型值 3 μ V 的高精度运算放大器、六阶视频驱动器、1:500 大动态背光 LED 驱动器等产品，在综合性能、质量和可靠性等方面均达到国际同类产品的一流水平。截至 2015 年 6 月 30 日，公司主要核心技术及关键参数如下：

公司主要产品技术参数

序号	技术名称	主要产品技术参数
1	微功耗运算放大器技术	最低静态电流 300nA，最低工作电压 1.4V
2	微功耗比较器技术	工作电流 300nA
3	高精度运算放大器技术	输入失调电压典型值（Vos）3 μ V
4	六阶视频驱动器技术	六阶滤波器
5	高压微功耗线性稳压器(LDO)技术	静态电流 2.2 μ A，36V 高压
6	低功耗升压电源转换器技术	400mA 开关电流，静态电流 20 μ A，可升压至 38V
7	超小型封装线性稳压器(LDO)技术	DFN-1x1(mm x mm)超小型封装，无需专门的旁路电容
8	高速运算放大器技术	增益带宽积达到 1.5GHz
9	低功耗微处理器电源监控芯片技术	静态电流 5 μ A
10	低功耗高压 LED 驱动器技术	可驱动 10 颗串联 LED 灯，静态电流 45 μ A

（2）产品与性能优势

公司的高性能模拟芯片产品以其可靠的质量、优异的性能和多样的类型赢得了整机客户的信赖和赞誉，品牌影响力不断增强。公司产品普遍具有功耗低、抗干扰能力强、抗静电能力强、可靠性高、采用小型绿色环保封装等优点，工作温度范围一般达到工业级（ $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ ），部分达到汽车级（ $-40^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$ ）。公司多款产品的性能指标与国际知名厂商的产品相同或接近，微功耗运算放大器、高精度运算放大器、超低功耗比较器、高阶视频滤波器等产品系列在个别参数指标上甚至超过国外同类产品的指标，打破了国外厂商在这些产品领域的垄断。2011年，公司的高精度运算放大器芯片系列获得了由中国半导体协会等联合颁发的“中国半导体创新产品和技术”大奖，同年高性能高阶视频滤波放大器产品获北京市人民政府颁发的“北京市科学技术奖二等奖”；2012年，公司的多功能低功耗微处理器电源监控芯片获得了由中华人民共和国科技部等联合颁发的“国家重点新产品证书”，2013年，公司的高性能高精度运算放大器芯片产品获北京市人民政府颁发的“北京市科学技术奖三等奖”；同年高效能低功耗电源转换芯片获得了由中华人民共和国科技部等联合颁发的“国家重点新产品证书”，这些技术性奖项的获取在一定程度上体现了公司模拟芯片产品的高性能和创新性。

（3）品质优势

公司秉承“技术先进、质量可靠、顾客满意、持续改进”的品质管理方针，按照半导体集成电路行业的国际标准建立了严格、完善的品质保障体系，在产品的设计研发、晶圆制造、封装测试和成品管理等各个环节建立了相应的质量保障流程和标准，并由各部门负责人严格监督执行，以确保公司产品品质，所有产品材质均符合 REACH/RoHS 绿色环保标准。

（4）多样性优势

公司以“多样性、齐套性、细分化”为发展战略目标，在信号链和电源管理领域自主研发的可供销售产品超过 600 款，横向涵盖十多个产品类别，可满足客户的多元化需求。例如，公司的 LED 背光驱动器类系列产品有并联恒流型、电荷泵型、DC/DC 升压型等，有共阴/共阳、4/6/8 路并联、升压串联 4/6/8/10 颗 LED 灯等多种输出形式，有 TSOT、DFN、TQFN 等不同封装类型。

（5）上下游资源优势

① 供应商资源优势

公司非常注重与供应商保持稳定和持续的战略合作。公司的主要供应商为台积电、长电科技、通富微电、成都宇芯，其中台积电为全球最大晶圆代工厂商，占据世界晶圆代工 50%以上的市场份额，长电科技、通富微电、成都宇芯是全球前列的封装测试厂商或其分支机构。除上述供应商之外，公司也已开始与联电等业内知名的供应商合作。公司积极加强与供应商的资源整合，根据新产品的特殊工艺及封测要求及时与供应商沟通并向其反馈新的市场信息，供应商在提供优质的制造、封测服务的同时，也持续与本公司沟通新工艺、新技术的更新情况，定期进行技术交流，形成了通畅的互馈平台。基于公司良好的成长性、清晰的发展前景和快速增长的采购量，供应商均十分重视与公司的合作，将本公司列为其在大陆的重要客户，在各方面给予公司较大支持。

②客户资源优势

下游客户方面，公司一方面与北高智、茂晶、丰宝、棋港、新得利、赛博联等资深电子元器件经销商结成了长期的合作伙伴关系，并通过经销商的丰富终端客户资源，实现大规模销售。另一方面，公司与中兴、联想、长虹等大型终端客户保持紧密联系，由本公司的市场和技术人员亲自上门与客户沟通，了解客户需求，帮助客户选型，解决技术问题，赢得了客户的长期信赖和积极反馈。优质且广泛的终端客户资源是公司保持快速成长和持续经营的根基和保障。依靠成熟的经销渠道、良好的产品品质和及时的技术支持，公司培育了庞大的终端客户群，公司在客户资源数量和质量上具备明显优势。

市场应用领域	主要终端客户
通讯	联想，中兴，小米，金立，宇龙酷派，华勤，龙旗等
消费类电子	长虹，九洲，创维，康佳，海尔，海信，中兴，HUMAX，PBI 等
工业控制	晶汇，高标，TP-Link，同维，WTD，海康，大华等
医疗仪器	鱼跃，超思等
汽车电子	航盛，TTE 等

（6）人才优势

芯片设计行业是知识密集型行业，人才是此类公司发展不可或缺的关键因素。公司创始人张世龙先生是国内高性能模拟芯片行业的开拓者之一，在业内具有很高的声望，曾获得“国家特聘专家”、“国家千人计划”、“北京市海外高层次

人才”、“中关村高端领军人才”、“中关村十大海归创业之星”、“科技北京百名领军人才”等荣誉称号。公司的技术研发团队、生产管理团队和市场营销团队的核心成员也均由国际资深专家组成，拥有在国际著名半导体公司多年的工作和管理经验。凭借丰富的从业经验、前瞻性的专业视野以及精诚合作的团队精神，上述核心团队为公司造就了宝贵的创新基因和创新文化，成为公司在模拟芯片领域持续创新的源动力。

公司历来倡导“尊重人才、勤奋创新、团队精神、勇于承担责任”的企业文化，为吸引人才并不断发展壮大奠定了基础。在核心创始团队的带领下，公司培养了一批与公司文化和价值观高度一致的优秀模拟芯片设计、生产与销售人才，对公司具有很高的忠诚度，形成了一个极具凝聚力的战斗团队，为公司的不断发展持续注入活力。

2、竞争劣势

公司主要依靠自身的积累发展，虽然公司近年来已发展成为模拟芯片设计行业较具竞争力的企业，但基于公司的客户基础、产品规模，与模拟芯片行业的全球领先的竞争对手相比，公司规模仍然较小，资本实力仍然较弱，公司品牌认知度与世界领先企业相比仍存在一定差距。同时，公司仍要进行大规模持续的业务与技术创新，并积极探索新产品线的开拓，新业务研发与新市场的开拓需要大量且持续的投入，需要公司不断提高资本实力，以应对来自海内外对手的市场竞争。

四、公司主营业务情况

（一）主要产品的生产与销售情况

1、主要产品的产销情况

公司主要产品为信号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片。

（1）主营业务收入分区域构成情况

报告期内公司营业收入分区域构成如下：

单位：万元

地区	2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

地区	2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
大陆	997.76	12.74%	3,126.01	9.59%	2,429.85	9.75%	1,980.12	8.74%
香港	6,551.37	83.67%	28,265.34	86.73%	21,327.28	85.59%	19,721.15	87.03%
台湾	170.46	2.18%	801.60	2.46%	976.63	3.92%	692.50	3.06%
其他	110.49	1.41%	398.52	1.22%	183.28	0.74%	267.54	1.18%
合 计	7,830.09	100.00%	32,591.47	100.00%	24,917.03	100.00%	22,661.31	100.00%

注：以客户所在地作为销售区域进行划分。

（2）各种销售模式的收入构成情况

报告期内，公司产品的各种销售模式下的营业收入情况如下：

单位：万元

项目		2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经销	金额	7,759.48	32,073.37	24,666.39	22,135.77
	比例	99.10%	98.41%	98.99%	97.68%
直销	金额	70.61	518.1	250.64	525.54
	比例	0.90%	1.59%	1.01%	2.32%
合计	金额	7,830.09	32,591.47	24,917.03	22,661.31
	比例	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

（3）主要产品的产能、产量及销量情况

报告期内，公司主要产品的销售情况如下：

年份	项目	信号链产品	电源管理产品	合 计
2015 年 1-3 月	产量（万颗）	10,942.12	17,473.82	28,415.94
	销量（万颗）	8,908.03	16,036.47	24,944.50
	产销率	81.41%	91.77%	87.78%
2014 年度	产量（万颗）	31,201.07	74,496.79	105,697.85
	销量（万颗）	29,726.15	67,623.41	97,349.56
	产销率	95.27%	90.77%	92.10%
2013 年度	产量（万颗）	27,086.36	42,208.29	69,294.65
	销量（万颗）	27,184.50	42,480.59	69,665.09
	产销率	100.36%	100.65%	100.53%
2012 年度	产量（万颗）	25,119.25	40,580.02	65,699.27
	销量（万颗）	24,301.06	37,813.60	62,114.66

年份	项目	信号链产品	电源管理产品	合 计
	产销率	96.74%	93.18%	94.54%

2、报告期内主要产品价格变动情况

报告期内，公司主要产品各年度的平均单价总体呈现略微下降趋势：一方面，产品的平均单价与公司所销售的产品结构有关；另一方面，公司新产品推出时的市场价格一般较好，随着市场的普及和工艺技术水平提高，边际成本降低，销售价格相应下降。具体变动情况如下：

项目		2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
信号链产品	收入（万元）	3,819.28	14,416.20	13,841.23	12,170.35
	销量（万颗）	8,908.03	29,726.15	27,184.50	24,301.06
	单价（元/颗）	0.4287	0.4850	0.5092	0.5008
电源管理产品	收入（万元）	4,010.80	18,175.27	11,075.80	10,490.96
	销量（万颗）	16,036.47	67,623.41	42,480.59	37,813.60
	单价（元/颗）	0.2501	0.2688	0.2607	0.2774

3、报告期内前五名客户的销售情况

公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，报告期内主要客户为经销商。

2015 年第一季度，公司前五名客户情况如下：

序号	客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
1	新得利	1,219.10	15.57%
2	北高智	975.32	12.46%
3	科通	967.56	12.36%
4	威健	914.93	11.68%
5	茂晶	804.50	10.27%
合 计		4,881.41	62.34%

2014 年度，公司前五名客户情况如下：

序号	客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
1	新得利	5,042.16	15.47%
2	北高智	5,015.83	15.39%
3	科通	3,506.45	10.76%

序号	客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
4	赛博联	3,318.10	10.18%
5	棋港	3,262.15	10.01%
合 计		20,144.69	61.81%

2013 年度公司前五名客户情况如下：

序号	客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
1	北高智	4,514.84	18.12%
2	新得利	3,140.18	12.60%
3	茂晶	2,974.66	11.94%
4	丰宝	2,835.01	11.38%
5	赛博联	2,375.55	9.53%
合 计		15,840.24	63.57%

2012 年度公司前五名客户情况如下：

序号	客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
1	北高智	3,820.90	16.86%
2	丰宝	2,936.43	12.96%
3	棋港	2,887.17	12.74%
4	茂晶	2,820.92	12.45%
5	新得利	2,482.12	10.95%
合 计		14,947.54	65.96%

报告期内，公司客户集中度较高，主要集中于一批拥有丰富行业经验及客户资源的经销商，公司与上述客户不存在关联关系。

（二）主要产品的原材料、能源及其供应情况

1、公司最近三年主要产品的成本构成情况

公司不直接从事芯片的生产和加工环节，营业成本主要为晶圆、封装测试成本。报告期内，公司晶圆及封装测试采购情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

项目	2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
晶圆	2,337.23	43.39%	9,240.49	42.89%	5,329.40	39.75%	5,486.73	39.82%
封装测试	3,049.56	56.61%	12,302.90	57.11%	8,076.83	60.25%	8,291.97	60.18%
合计	5,386.79	100%	21,543.40	100%	13,406.23	100%	13,778.70	100%

2、公司报告期内向供应商采购情况

报告期内，公司向供应商采购情况如下：

期间	前五名供应商	采购金额 (万元)	采购内容	占当期采购 总金额比
2015 年 1-3 月	台湾积体电路制造股份有限公司	2,492.95	晶圆、光罩	44.81%
	江苏长电科技股份有限公司	1,711.46	封装、测试	30.77%
	宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司	690.72	封装、测试	12.42%
	南通富士通微电子股份有限公司	647.39	封装、测试	11.64%
	张家港保税区盛永泰电子检测服务有限公司	13.38	封装、测试	0.24%
	合计	5,555.89		99.87%
2014 年	台湾积体电路制造股份有限公司	9,731.51	晶圆、光罩	44.09%
	江苏长电科技股份有限公司	7,755.79	封装、测试	35.14%
	宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司	2,404.42	封装、测试	10.89%
	南通富士通微电子股份有限公司	2,142.69	封装、测试	9.71%
	联华电子股份有限公司	24.06	晶圆	0.11%
	合计	22,058.47		99.93%
2013 年	台湾积体电路制造股份有限公司	5,730.43	晶圆、光罩	41.50%
	江苏长电科技股份有限公司	5,030.17	封装、测试	36.43%
	南通富士通微电子股份有限公司	1,707.29	封装、测试	12.37%
	宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司	1,339.36	封装、测试	9.70%
	合计	13,807.25		100.00%
2012 年	台湾积体电路制造股份有限公司	6,042.98	晶圆、光罩	42.16%
	江苏长电科技股份有限公司	5,487.85	封装、测试	38.28%
	南通富士通微电子股份有限公司	1,431.16	封装、测试	9.98%
	宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司	1,372.96	封装、测试	9.58%
	合计	14,334.95		100.00%

注：因江苏长电科技股份有限公司与江阴长电先进封装有限公司为关联方，上表中统计的发行人与江

苏长电科技股份有限公司的交易金额包含发行人与江阴长电先进封装有限公司的交易金额。

3、主要能源供应情况

公司报告期内所需能源为日常生产经营及办公所需水、电等，主要向当地供水公司及供电局采购，占成本费用比重很小。

五、主要资产情况

（一）固定资产

本公司主要的固定资产为办公家具、电子设备及其他等。截至 2015 年 3 月 31 日，公司的固定资产状况如下表所示：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	净额
运输工具	41.54	11.73	29.81
办公家具	36.22	23.31	12.91
电子设备及其他	961.65	573.25	388.40
合计	1,039.41	608.29	431.12

截至 2015 年 6 月 30 日，公司所使用的办公场所均为租赁房产，具体情况如下：

序号	出租方	用途	租赁期限	租赁面积	地址
1	郭**、刘**、李**、王**	办公	2014 年 10 月 17 日至 2016 年 7 月 16 日	471.02 平方米	北京市海淀区西三环北路 72 号世纪经贸大厦 B 座 16 层 00 号、02、06、10 号房间
2	陈**	办公	2014 年 10 月 17 日至 2016 年 7 月 16 日	124.73 平方米	北京市海淀区西三环北路 72 号世纪经贸大厦 B 座 16 层 08 号房间
3	深圳市九洲电器有限公司	办公	2015 年 5 月 7 日至 2016 年 5 月 6 日	520.00 平方米	深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦八楼 B817-818 室
4	江阴市广信防伪印刷有限公司	仓库、仓管、宿舍	2014 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日	1,200.00 平方米	江阴市东外环路 269 号

序号	出租方	用途	租赁期限	租赁面积	地址
5	江阴市广信防伪印刷有限公司	办公	2015年3月1日至2017年2月28日	400.00 平方米	江阴市东外环路269号
6	杨*、刘*	办公	2014年12月16日至2017年12月15日	294.6 平方米	上海市徐汇区漕溪北路88号1905-06室
7	Essex Corporate Advisory Limited	办公	2014年12月5日至2015年12月4日	-	Room 606 6/F Tower A Hunghom Commercial Centre 39 Ma Tau Wai Road KL
8	哈尔滨高科技创业中心	办公	2015年1月1日至2015年12月31日	2,120 平方米	哈尔滨高新区迎宾路集中区创业大厦太湖北街(路)5号3单元1-4层
9	中濠不动产投资顾问股份有限公司	办公	2014年8月1日至2015年7月31日	18.82 坪	台北市基隆路二段七号五楼之二

（二）无形资产

1、无形资产构成

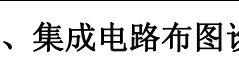
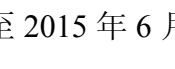
截至2015年3月31日，公司合并资产负债表中主要无形资产为软件，账面价值为180.47万元。

2、商标

截至2015年6月30日，公司境内商标情况如下：

序号	图像	注册号	类型	专用权期限	权利人
1		6522791	第9类	2010.04.07-2020.04.06	圣邦股份
2		6522788	第9类	2010.04.07-2020.04.06	圣邦股份
3	SG MICRO	11256062	第9类	2015.04.07-2025.04.06	圣邦股份

公司拥有以下10项在中国境外的注册商标：

序号	图像	注册号	类型	专用权期限	权利人
1		01653741	第 9 类	2014.07.16-2024.07.15	圣邦股份
2		302641095	第 9 类	2013.06.17-2023.06.16	圣邦股份
3		01653742	第 9 类	2014.07.16-2024.07.15	圣邦股份
4		302641103	第 9 类	2013.06.17-2023.06.16	圣邦股份
5		302967634	第 9 类	2014.04.17-2024.04.16	圣邦股份
6		01686870	第 9 类	2015.01.16-2025.01.15	圣邦股份
7		303055482	第 9 类	2014.07.03-2024.07.02	圣邦股份
8		303055491	第 9 类	2014.07.03-2024.07.02	圣邦股份
9		4738202	第 9 类	2015.05.19-2025.05.18	圣邦股份
10		40-1094554	第 9 类	2015.03.17-2025.03.16	圣邦股份

3、集成电路布图设计登记证书

截至 2015 年 6 月 30 日，公司集成电路布图设计登记证书情况如下：

序号	所有人	设计名称	登记号	申请日	核发日期	他项权利
1.	圣邦股份	SGM4890 喇叭音频放大器	BS. 08500631.9	2008.11.27	2009.02.23	无
2.	圣邦股份	SGM3138 六通道 LED 驱动器	BS. 10500478.2	2010.08.04	2010.10.06	无
3.	圣邦股份	SGM3127 LED 驱动器	BS. 10500487.1	2010.08.04	2010.10.06	无
4.	圣邦股份	SGM3133 共阴四通道 LED 驱动器	BS.10500488.X	2010.08.04	2010.10.06	无
5.	圣邦股份	SGM7222 USB2.0 模拟开关	BS. 10500489.8	2010.08.04	2010.10.06	无
6.	圣邦股份	SGM8922 12.7MHz 轨到轨输出运算放大器	BS.11500755.5	2011.08.08	2011.11.07	无

序号	所有人	设计名称	登记号	申请日	核发日期	他项权利
7.	圣邦股份	SGM9123 3 通道 8MHz 3 阶视频驱动器	BS.11500756.3	2011.08.08	2011.11.07	无
8.	圣邦股份	SGM9116 3 通道 35MHz 3 阶视频驱动器	BS.11500757.1	2011.08.08	2011.11.07	无
9.	圣邦股份	SGM6600 600mA 1.2MHz 同步升压转换器	BS.11500758.X	2011.08.08	2011.11.07	无
10.	圣邦股份	SGM8902 无去耦电容音频驱动器	BS.11500759.8	2011.08.08	2011.11.07	无
11.	圣邦股份	SGM706 多功能微处理器监控电路	BS.11500760.1	2011.08.08	2011.11.07	无
12.	圣邦股份	SGM9119 3 通道 5 阶视频驱动器	BS.11500761.X	2011.08.08	2011.11.07	无
13.	圣邦股份	SGM6502 8 进 6 出视频矩阵开关	BS.11500762.8	2011.08.08	2011.11.07	无
14.	圣邦股份	SGM6501 12 进 9 出视频矩阵开关	BS.11500763.6	2011.08.08	2011.11.07	无
15.	圣邦股份	SGM4996 1.3W 全差分音频功率放大器	BS.11500764.4	2011.08.08	2011.11.07	无
16.	圣邦股份	SGM6603 90%高效率, 1.1A 同步升压开关稳压器	BS.12501019.2	2012.08.03	2012.10.12	无
17.	圣邦股份	SGM6601 低功率 DC-DC 升压转换器	BS.12501020.6	2012.08.03	2012.10.12	无
18.	圣邦股份	SGM6132 3A、28V、1.4MHz 降压转换器	BS.12501021.4	2012.08.03	2012.10.12	无
19.	圣邦股份	SGM8272 高压轨到轨输出运算放大器	BS.12501023.0	2012.08.03	2012.10.12	无
20.	圣邦	SGM4056 高压输入充电器	BS.12501024.9	2012.08.03	2012.10.12	无

序号	所有权人	设计名称	登记号	申请日	核发日期	他项权利
	股份					
21.	圣邦股份	SGM3727 高效率升压 WLED 驱动器	BS.12501025.7	2012.08.03	2012.10.12	无
22.	圣邦股份	SGM3140 降压/升压电荷泵 LED 驱动器	BS.12501026.5	2012.08.03	2012.10.12	无
23.	圣邦股份	SGM9128 4 通道, 6 阶标清/高清视频滤波驱动器	BS.12501027.3	2012.08.03	2012.10.12	无
24.	圣邦股份	SGM2200 高压稳压器	BS.12501028.1	2012.08.03	2012.10.12	无
25.	圣邦股份	SGM8301 100MHz, 高压, 轨到轨输出放大器	BS.12501029.X	2012.08.03	2012.10.12	无
26.	圣邦股份	SGM8941 1.5MHz, 轨到轨输入、输出运算放大器	BS.12501030.3	2012.08.03	2012.10.12	无
27.	圣邦股份	SGM8931 1.5MHz, 轨到轨输出运算放大器	BS.12501031.1	2012.08.03	2012.10.12	无
28.	圣邦股份	SGM8422 2.2MHz 高压, 轨到轨输入/输出放大器	BS.12501032.X	2012.08.03	2012.10.12	无
29.	圣邦股份	SGM2554 配电开关	BS.12501033.8	2012.08.03	2012.10.12	无
30.	圣邦股份	SGM4062 压过流保护集成电路和具有线性稳压器模式的锂离子充电器前端保护集成电路	BS.12501022.2	2012.08.03	2012.10.23	无
31.	圣邦股份	SGM3732 PWM 调光, 38V 升压型 LED 驱动器	BS.13500876.X	2013.07.25	2013.09.03	无
32.	圣邦股份	SGM3780 TDFN-3×2-14L 封装, 2MHz, 1.5A 闪光 LED 驱动器	BS.13500877.8	2013.07.25	2013.09.03	无

序号	所有权人	设计名称	登记号	申请日	核发日期	他项权利
33.	圣邦股份	SGM3717 4Ω, 400MHz 带宽, 双路, 单刀双掷可处理负压信号模拟开关	BS.13500878.6	2013.07.25	2013.09.03	无
34.	圣邦股份	SGM3726 小封装, 带有数字和 PWM 调光的白光 LED 驱动器	BS.13500879.4	2013.07.25	2013.09.03	无
35.	圣邦股份	SGM9140 26MHz Y-C 混合, 色度禁用视频驱动器	BS.13500880.8	2013.07.25	2013.09.03	无
36.	圣邦股份	SGM3206 固定频率的 60mA 电荷泵电压反向器	BS.13500881.6	2013.07.25	2013.09.03	无
37.	圣邦股份	SGM4560 CA 卡电源管理与电平转换器	BS.13500882.4	2013.07.25	2013.09.03	无
38.	圣邦股份	SGM4581 高压, CMOS 模拟多路选择器	BS.13500883.2	2013.07.25	2013.09.03	无
39.	圣邦股份	SGM6012 1.6MHz, 600mA 同步降压转换器	BS.13500884.0	2013.07.25	2013.09.03	无
40.	圣邦股份	SGM4551 双通道双向 I ² C 总线和 SM 总线电压电平转换器	BS.13500885.9	2013.07.25	2013.09.03	无
41.	圣邦股份	SGM6016 1.2A, 1.6MHz 高效同步降压转换器	BS.13500886.7	2013.07.25	2013.09.03	无
42.	圣邦股份	SGM8706 集成基准电压, 1.8V 工作电源微功耗, 轨到轨输入, 推挽式轨到轨输出电压比较器	BS.13500887.5	2013.07.25	2013.09.03	无
43.	圣邦股份	SGM2036 300mA, 低电压, 低压差射频线性稳压器	BS.145010384	2014.10.14	2014.11.14	无
44.	圣邦股份	SGM2557 双通道负载开关	BS.145010392	2014.10.14	2014.11.14	无
45.	圣邦	SGM2578 小封装, 低输入电	BS.145010406	2014.10.14	2014.11.14	无

序号	所有权人	设计名称	登记号	申请日	核发日期	他项权利
	股份	压, 低导通电阻负载开关				
46.	圣邦股份	SGM8743 9ns, 低电压, 3V/5V, 轨到轨单电源输入比较器	BS.145010414	2014.10.14	2014.11.14	无
47.	圣邦股份	SGM6514 16输入8输出交叉式模拟开关	BS.145010422	2014.10.14	2014.11.14	无
48.	圣邦股份	SGM6018 2.6MHz, 600mA 同步射频降压转换器	BS.145010430	2014.10.14	2014.11.14	无
49.	圣邦股份	SGM4552 1 位双向电平转换器	BS.145010449	2014.10.14	2014.11.19	无
50.	圣邦股份	SGM3740 高效率, 4 通道, 38V 升压白光 LED 驱动	BS.145010457	2014.10.14	2014.11.19	无
51.	圣邦股份	SGM3718 0.6 Ω , 低导通电阻, 双路, 单刀双掷可处理负压信号模拟开关	BS.145010465	2014.10.14	2014.11.19	无
52.	圣邦股份	SGM2588 负载开关	BS.145010473	2014.10.14	2014.11.19	无
53.	圣邦股份	SGM40561 高输入电压电池充电器	BS.155004271	2015.05.06	2015.06.05	无
54.	圣邦股份	SGM8142 350nA, 双路, 轨道轨输入输出微功耗运算放大器	BS.15500428X	2015.05.06	2015.06.05	无
55.	香港圣邦	SGM2022 双通道 LDO	BS.08500635.1	2008.11.27	2010.08.26	无
56.	香港圣邦	SGM809 电压检测电路	BS.08500634.3	2008.11.27	2010.08.26	无
57.	香港圣邦	SGM9110 视频驱动器	BS.08500633.5	2008.11.27	2010.08.26	无
58.	香港	SGM3110 LED 驱动器	BS.08500632.7	2008.11.27	2010.08.26	无

序号	所有权人	设计名称	登记号	申请日	核发日期	他项权利
	圣邦					
59.	香港 圣邦	SGM4809 耳机音频放大器	BS.08500630.0	2008.11.27	2009.05.26	无
60.	香港 圣邦	SGM3122 四通道白光 LED 驱动	BS.09500243.X	2009.04.18	2009.09.17	无
61.	香港 圣邦	SGM4054 线性锂电池充电管理芯片	BS.09500242.1	2009.04.18	2009.09.17	无
62.	香港 圣邦	SGM3132LED 驱动器	BS.09500556.0	2009.09.24	2010.03.25	无
63.	香港 圣邦	SGM8552 高精度运算放大器	BS.09500555.2	2009.09.24	2010.03.25	无
64.	香港 圣邦	SGM8042 低功耗、低电压运算放大器	BS.09500554.4	2009.09.24	2010.03.25	无

根据国家知识产权局于核发的《集成电路布图设计登记证书》，公司拥有的 64 项软件产品经审核符合《集成电路布图设计保护条例》和《集成电路布图设计保护条例实施细则》的有关规定，准予登记为集成电路布图设计，布图设计专有权有效期自登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起 10 年。

4、发明及实用新型专利

截至 2015 年 6 月 30 日，公司的以下发明及实用新型专利已取得国家知识产权局核发的《发明专利证书》、《实用新型专利证书》：

序号	专利号	专利名称	专利权利人	专利类型	专利权期限	取得方式	他项权利
1	ZL 201220028547.9	升压电路	圣邦股份	实用新型	2012.01.20-2022.01.19	原始取得	无
2	ZL 201220389222.3	一种双回路限流保护电路	圣邦股份	实用新型	2012.08.07-2022.08.06	原始取得	无
3	ZL 201220339377.6	多档位恒定电流源电路	圣邦股份	实用新型	2012.07.12-2022.07.11	原始取得	无

序号	专利号	专利名称	专利权利人	专利类型	专利权期限	取得方式	他项权利
4	ZL 201220378736.9	芯片的电流检测电路	圣邦股份	实用新型	2012.07.31-2022.07.30	原始取得	无
5	ZL 201220364533.4	DC-DC 升压电路	圣邦股份	实用新型	2012.07.25-2022.07.24	原始取得	无
6	ZL 201220364581.3	DC-DC 升压转换器	圣邦股份	实用新型	2012.07.25-2022.07.24	原始取得	无
7	ZL 201220337064.7	软启动电路	圣邦股份	实用新型	2012.07.11-2022.07.10	原始取得	无
8	ZL 201220588514.X	音视频线路输出驱动器	圣邦股份	实用新型	2012.11.09-2022.11.08	原始取得	无
9	ZL 201320165627.3	一种耳麦自适应连接电路	圣邦股份	实用新型	2013.04.03-2023.04.02	原始取得	无
10	ZL 201420398088.2	具有折返特性的限流电路	圣邦股份	实用新型	2014.07.18-2024.07.17	原始取得	无
11	ZL 201210019563.6	升压方法和电路	圣邦股份	发明	2012.01.20-2032.01.19	原始取得	无
12	ZL 201210120935.4	具有自动电流调节功能的 LED 驱动器	圣邦股份	发明	2012.04.23-2032.04.22	原始取得	无
13	ZL 201210242468.2	恒定电流源电路	圣邦股份	发明	2012.07.12-2032.07.11	原始取得	无
14	ZL 201210271415.3	发光二级管的驱动电路及其驱动控制方法	圣邦股份	发明	2012.07.31-2032.07.30	原始取得	无
15	ZL 201210270630.1	电源控制装置和电源控制系统	圣邦股份	发明	2012.07.31-2032.07.30	原始取得	无
16	ZL 201210279225.6	一种快速响应限流保护电路	圣邦股份	发明	2012.08.07-2032.08.06	原始取得	无
17	ZL 201310097444.7	一种电池应用电量计的电压变化采集电路	圣邦股份	发明	2013.03.25-2033.03.24	原始取得	无
18	ZL201210240833.6	软启动电路及其启动控制方法	圣邦股份	发明	2012.7.11-2032.7.10	原始取得	无

序号	专利号	专利名称	专利权利人	专利类型	专利权期限	取得方式	他项权利
19	ZL201220317949.0	LED 驱动器和 DC/DC 升压转换器	圣邦股份	实用新型	2012.6.29-2022.6.28	原始取得	无

（三）其他对发行人经营发生作用的资源要素

2010 年 12 月 15 日，工业和信息化部向圣邦有限核发了《集成电路设计企业认定证书》（编号：工信部电子认 0366-2010B 号），认定圣邦有限为集成电路设计企业。该《集成电路设计企业认定证书》已通过 2011 年度年检。2012 年 12 月 18 日，工业和信息化部已就圣邦股份因整体变更为股份公司而导致名称变更情况，向圣邦股份核发了《集成电路设计企业认定证书》（编号：工信部电子认 0588-2012B 号），认定圣邦股份为集成电路设计企业。该《集成电路设计企业认定证书》（编号：工信部电子认 0588-2012B 号）已通过 2013 年度及 2014 年度年检。

六、技术与研发情况

（一）公司核心技术情况

1、发行人拥有的主要核心技术

序号	核心技术名称	主营业务产品应用	技术来源	创新形式	是否形成专利或软件著作权
1	高速运算放大器技术	便携式电子设备、机顶盒、通信设备等	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 25
2	低噪声运算放大器技术	便携式电子设备、工业控制、测试设备、通信设备	自主开发	原始创新	否
3	通用运算放大器技术	消费类电子设备、工业、车载电子设备等	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 26, 28
4	低功耗运算放大器技术	手持电子设备、工业、医疗设备等	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 19, 64

序号	核心技术名称	主营业务产品应用	技术来源	创新形式	是否形成专利或软件著作权
5	高精度运算放大器技术	仪器仪表、医疗器械、工业控制等	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 6，27，63
6	微功耗运算放大器技术	便携式电子设备、消费类电子设备	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 54
7	微功耗比较器技术	便携式电子设备	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 42，46
8	耳机音频功率放大器技术	手机、MP3/MP4、GPS、PDA、笔记本电脑	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 59；“实用新型/发明专利”序号 9
9	喇叭音频功率放大器技术	手机、MP3/MP4、GPS、PDA、笔记本电脑	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 1，10，15；“实用新型/发明专利”序号 8
10	高性能视频驱动器技术	便携式电子设备、家用电器、机顶盒等	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 7，8，12，13，14，23，35，57；“实用新型/发明专利”序号 8
11	模拟信号开关技术	便携式电子设备、消费类电子设备	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 5，33，38，47，51
12	逻辑电平转换技术	便携式电子设备、消费类电子设备	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 37，40，49
13	微处理器电源监测电路技术	微处理器系统、智能系统、工业控制等	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 11，56

序号	核心技术名称	主营业务产品应用	技术来源	创新形式	是否形成专利或软件著作权
14	低压差线性稳压器技术	手机、数码相机、PDA、MP3、便携式电子设备等	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 24, 43, 55；“实用新型/发明专利”序号 15
15	DC/DC 降压转换器技术	便携式电子设备、消费类电子设备	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 18, 39, 41, 48；“实用新型/发明专利”序号 3, 7, 13
16	DC/DC 升压转换器技术	便携式电子设备、消费类电子设备	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 9, 16, 17, 36；“实用新型/发明专利”序号 1, 5, 6, 11, 18
17	锂电池充电管理芯片技术	手机、MP3/MP4、PDA、蓝牙、便携式电子设备等	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 20, 53, 61；“实用新型/发明专利”序号 17
18	白光 LED 驱动器技术	便携式电子设备、消费类电子设备	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 2, 3, 4, 21, 22, 31, 34, 50, 58, 60, 62；“实用新型/发明专利”序号 12, 14, 19
19	LED 闪光灯驱动器技术	便携式电子设备、消费类电子设备	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 32
20	负载开关技术	便携式电子设备、消费类电子设备	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 29, 44, 45, 52；“实用新型/发明专利”序号 2, 10, 16

序号	核心技术名称	主营业务产品应用	技术来源	创新形式	是否形成专利或软件著作权
21	过压保护技术	便携式电子设备、消费类电子设备、工业控制、医疗器械等	自主开发	原始创新	是：“集成电路布图设计登记证书”序号 30；“实用新型/发明专利”序号 4

2、研发项目进展情况和拟达到的目标

公司紧跟当代电子信息产业的最新发展动态和用户的新需求，持续开发新的产品系列以及性能更高、应用更广的升级换代产品，不断开拓以智能手机、平板电脑、手持电子设备、汽车电子为代表的移动互联网终端、节能照明等新领域和新市场。公司将一如既往的不断增加研发投入，扩大研发队伍，注重技术创新，继续加强在核心技术上的技术储备。公司目前储备的在研项目包括：

序号	在研项目名称	技术来源	应用领域	项目进展	拟达到目标
1	高压 DC/DC 电源转换器技术	自主创新	消费类电子、工业、医疗等领域	在研阶段	采用高压 BCD 工艺实现 DC/DC 电源转换器（包括升压和降压型）系列产品的产业化
2	高压锂电池充电器技术	自主创新	智能手机、平板电脑、电力银行、GPS 等	在研阶段	采用高压 BCD 工艺实现锂电池充电器系列产品的产业化
3	升压型闪光灯 LED 驱动技术	自主创新	智能手机、平板电脑、数码相机等	在研阶段	采用升压结构及开关模式开发用于闪光灯 LED 的驱动电路系列产品
4	高压 LED 驱动技术	自主创新	智能手机、数码相机、平板电脑、GPS、背光驱动等	在研阶段	采用高压 BCD 工艺实现升压结构的 LED 驱动器系列产品的产业化
5	高压运算放大器技术	自主创新	工业仪器仪表、能源系统等	在研阶段	采用高压工艺实现高性能运算放大器系列产品的产业化
6	电源管理单元	自主创新	通讯设备，消费类电子产品等	在研阶段	多通道、高效能、低功耗电源管理单元系列产品的产业化
7	SIMO 电源技术	自主创新	电池管理、功率器件驱动等	在研阶段	采用独创的单电感多输出电源架构实现 SIMO 电源系列产品的产业化

3、核心技术产品收入总额及占营业收入的比例

报告期内公司的核心技术产品收入总额及占营业收入的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
核心技术产品收入	7,830.09	32,591.47	24,917.03	22,661.31
占营业收入比例	100%	100%	100%	100%

（二）公司研发人员及研发费用情况

1、研发人员情况

报告期内，公司的核心研发人员稳定，研发人员数量和比重稳定增长，具体情况见下表：

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
研发人员数量	117	118	116	90
占总人数比重	57.35%	58.71%	56.86%	46.88%

公司通过采取有效的激励机制和人才保护措施，加强了核心技术人员的稳定性，近两年来公司的核心技术人员未出现重大变动。

2、研发费用情况

公司高度重视研发工作，在研发方面保持较高投入水平。报告期内公司研发费用占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
研发费用	879.31	2,796.80	1,948.46	1,664.09
营业收入	7,830.09	32,519.47	24,917.03	22,661.31
研发费用占营业收入比重	11.23%	8.58%	7.82%	7.34%

报告期内公司研发费用构成如下：

单位：万元

研发费用构成	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
工资及社保	575.34	1,778.76	1,314.24	999.51
耗材	138.32	441.05	275.06	336.05

研发费用构成	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
无形资产摊销	22.13	77.84	70.71	62.78
房租水电物业	41.73	122.20	82.35	60.56
折旧费用	35.17	120.01	70.68	85.10
其他	66.62	256.93	135.42	120.09
合计	879.31	2,796.80	1,948.46	1,664.09

七、特许经营权情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司不存在特许经营的情况。

八、境外经营情况

公司的境外经营主体为香港圣邦，主要负责海外销售业务。该公司的详细情况参见“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人控股子公司及分公司情况”。

九、未来发展与规划

（一）未来发展规划及发展目标

1、公司发展战略

公司的总体发展战略是：以市场为导向、以创新为驱动，以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则，对公司未来发展进行审慎严谨布局，坚持自主研发，攻克一批关键技术，升级现有芯片的同时研发公司新一代的高性能模拟集成电路技术，推出在性能、功耗、可靠性等方面具有国际领先水平，在价格、品质、技术支持等方面具备较强国际竞争力及良好产业化前景的新一代模拟集成电路芯片，不断巩固公司在国内模拟芯片行业的领先地位，努力成为世界模拟芯片行业的一流品牌，实现我国在自主高性能模拟集成电路技术领域的飞跃。

2、未来三年公司具体业务发展目标

公司未来三年的具体发展目标是：通过建设研发中心，加强自主创新的研发能力；通过开拓产品线、提升产品性能和拓宽产品应用领域，提升公司核心竞争力；通过不断完善和优化专业化营销体系和管理流程，提升企业的品牌知名度，扩大区域及行业的覆盖，积极开拓国内外市场。

本业务发展目标是公司基于过往的经营轨迹并结合宏观经济形势以及行业发展状况，对未来三年公司业务发展做出的审慎规划。由于行业竞争激烈且发展迅速，本发展规划的实现存在一定程度的不确定性，因此不排除根据公司的实际经营状况、宏观经济情况和行业发展变化对本业务发展目标进行调整和完善的可能性。

（二）公司拟采取的业务发展计划

1、增强成长性，提升未来盈利能力

随着模拟芯片应用市场的快速发展，公司目前主要经营的模拟芯片设计业务迎来了高速成长的机遇。芯片的升级换代要求更细化的功能、更高的性能和更广泛的应用。公司未来将通过系列化产品的研发并快速推向市场，使业务快速增长。利用现有的技术与市场优势，不断推出高性能、高品质、高附加值的产品，有效扩大市场服务网络，提升客户满意度，使得公司产品的整体毛利率维持在合理水平。充分发挥公司在技术和产业化方面的优势，适时涉足新的产品市场和应用领域，开辟新的利润增长点。

2、增强自主创新能力，提升核心竞争优势

通过电源管理类模拟芯片开发及产业化项目和信号链类模拟芯片开发及产业化项目的实施，研发一系列具有完全自主知识产权的高性能、高品质的模拟集成电路系列产品并实现产业化，产生一批新的核心技术并申报集成电路布图设计证书及专利。通过研发中心项目的建设和实施，进一步提升公司模拟芯片开发技术水平，探寻并开发全新的产品线。以“世界一流的可靠性、一致性”为技术发展准绳，以“多样性、齐套性、细分化”为产品发展战略目标，稳固并提升公司的核心竞争优势，增强可持续发展能力。

（三）实现上述计划所依据的假设条件

1、国家宏观政治、经济、法律和社会环境处于正常发展状态，国家关于集成电路设计行业相关的法规、政策等无重大不利变化。

2、公司股票发行顺利，募集资金及时到位。

3、我国集成电路设计行业持续快速发展，行业技术水平不断提高，行业竞

争状况良好，上下游行业均未出现影响行业发展的重大不利情况。

4、公司各项经营业务所遵循的国家及地方的现行法律、法规、行业规定无重大变化，行业和市场环境无重大恶化。

5、公司无重大经营决策失误和严重影响公司正常运作的重大人事变动。

6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（四）实现上述计划面临的主要困难

1、资金制约。短期内国家实行适度紧缩的货币政策，银行融资成本较高，难度较大，如果募集资金无法及时到位，将对公司业务发展带来不利影响。

2、人力资源制约。新业务拓展、产品研发将引致对高端技术人才和高级技术工人的大量需求。公司目前的人才储备尚不能满足公司战略发展目标的要求。

（五）公司确保实现规划和目标拟采用的方法或途径

本公司将采用以下方法确保实现上述计划：

1、公司将继续坚持“以市场为导向、以创新为驱动”的经营理念，提升技术创新能力、产品开发能力和客户服务能力，认真实施研发和营销等方面的系统规划，努力实现收入规模和利润水平的快速增长。

2、本次发行股票将为实现上述发展计划所需的建设资金提供支持，公司将认真组织募集资金投资项目的实施，促进上述目标的实现：力争尽快建成研发中心，完成电源管理类模拟芯片开发及产业化项目和信号链类模拟芯片开发及产业化项目的产品研发和产业化进程，实现公司产品升级和结构优化；加大营销体系建设力度，扩大品牌影响力，拓展公司产品市场覆盖范围；不断提高公司的行业竞争力，达到预期效益。

3、公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步提高公司治理、风险控制和财务管理的能力，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理体制的升级创新。

4、根据公司的人才引进计划，加快对优秀人才特别是技术人才、市场营销人才和管理人才的引进，并优化公司的人员结构，进一步提高公司的产品技术含量、产品销售能力和运营管理水平，确保公司总体经营目标的实现。

5、以本次股票发行为契机，进一步提高公司的社会知名度和市场影响力，提升公司的品牌价值，充分利用公司的现有优势并整合其他各种资源，积极进行海内外市场开拓，提高公司产品的市场占有率。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）公司同业竞争情况

公司控股股东鸿达永泰主要从事投资业务，未从事与公司相同、相似业务，不存在同业竞争情况，鸿达永泰除持有公司股权外，还持有北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）3.64%的权益，此外无其他对外投资情形。

公司实际控制人为张世龙，张世龙除持有鸿达永泰 100%股权外，未控制其他公司。

（二）关于避免同业竞争的承诺

1、发行人的控股股东鸿达永泰出具《避免同业竞争的承诺函》承诺如下：

“本公司北京鸿达永泰投资管理有限责任公司，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”）的控股股东，就避免与圣邦股份发生同业竞争的相关事项，特出具承诺函如下：

一、截至本承诺函出具之日，本公司未控制除圣邦股份以外的其他企业。

二、本公司自身没有以任何形式从事与圣邦股份及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

三、如圣邦股份之股票在境内证券交易所上市，则本公司作为圣邦股份的实际控制人，将采取有效措施，并促使本公司自身、本公司将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与圣邦股份或其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持权益或利益，亦不会以任何形式支持圣邦股份及其下属企业以外的他人从事与圣邦股份及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，及以其他方式介入（不论直接或间接）任何与圣邦股份或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

四、凡本公司自身、本公司将来参与投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与圣邦股份及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司自身以及本公司控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予圣邦股份或其下属企业。

五、凡本公司自身及本公司将来参与投资的企业在承担科研项目过程中形成任何与圣邦股份及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，其将优先转让予圣邦股份或其下属企业。

本公司在本承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。”

2、公司实际控制人张世龙出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“本人张世龙，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”）的实际控制人，就避免与圣邦股份发生同业竞争的相关事项，特出具承诺函如下：

一、本人自身没有以任何形式从事与圣邦股份及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

二、如圣邦股份之股票在境内证券交易所上市，则本人作为圣邦股份的实际控制人，将采取有效措施，并促使本人自身、本人将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与圣邦股份或其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益，亦不会以任何形式支持圣邦股份及其下属企业以外的他人从事与圣邦股份及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，及以其他方式介入（不论直接或间接）任何与圣邦股份或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

三、凡本人自身、本人将来参与投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与圣邦股份及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人自身以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予圣邦股份或其下属企业。

四、凡本人自身及本人将来参与投资的企业在承担科研项目过程中形成任何与圣邦股份及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，其将优先转让予圣邦股份或其下属企业。

本人在本承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。”

二、关联方及关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》和《创业板上市规则》等关于关联方和关联关系的有关规定，目前公司的关联方主要有：

1、控股股东、实际控制人及其控制的企业

序号	关联方名称	说明
1	张世龙	实际控制人
2	鸿达永泰	控股股东、实际控制人控制企业

2、子公司

公司拥有一家全资子公司香港圣邦，香港圣邦拥有一家全资子公司 SG Micro Japan Kabushiki Kaisha。

3、持有公司 5%以上股份的主要股东

序号	关联方名称	说明
1	鸿达永泰	持有公司 28.13%股份
2	宝利鸿雅	持有公司 12.95%股份
3	哈尔滨珺霖	持有公司 12.09%股份
4	盈富泰克	持有公司 9.84%股份
5	世纪维盛	持有公司 9.84%股份
6	弘威国际	持有公司 8.00%股份
7	荣基香港	持有公司 5.31%股份

4、关联自然人及其他关联方

公司关联自然人为公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员。公司的其他关联企业包括公司关联自然人控制的企业，及担任董事、高级管理人员的企业；或其他根据实质重于形式原则判断能够对公司产生重大影响的主体。主要情况如下：

序号	姓名	与发行人的关系	涉及企业
1	张世龙	董事长、总经理	持有鸿达永泰 100%股权
2	Wen Li	张世龙配偶	持有弘威国际 100%股权
3	张 勤	董事、副总经理、 董事会秘书	持有宝利鸿雅 100%股权
4	林 林	董事	持有哈尔滨珺霖 100%股权
5	Cong Wang	主要个人投资者	持有荣基香港 100%股权
6	李书锋	独立董事	担任中央民族大学教授
			担任张家界源发水电开发有限公司董事长
			担任北京源发智信管理咨询有限责任公司董事长，并持有其 80%股权
7	王 涌	独立董事	担任中国政法大学教授
			担任浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事
			担任第一拖拉机股份有限公司监事
			担任中科创达软件股份有限公司独立董事
			担任威海光威复合材料股份有限公司独立董事
			担任北京信威通信科技集团股份有限公司独立董事
			担任北京市隆安律师事务所兼职律师
8	林明安	副总经理	持有鹏成国际 46.95%股权
9	张海冰	副总经理	持有盈华锐时 84.53%股权
10	张 绚	财务总监	持有盈华锐时 1.24%股权，高迪达天 0.79%股权
11	赵媛媛	职工监事代表	担任盈华锐时执行事务合伙人
12	刘 明	监事	担任高迪达天执行事务合伙人
13	卞晓蒙	监事会主席	担任金华添达执行事务合伙人

5、报告期内曾经的关联企业

公司在搭建红筹架构时曾经设立了相关海外公司，随着红筹架构的解除，公司注销了相关海外公司。报告期内公司注销的相关企业情况如下：

序号	企业名称	注册地	处置前股权结构	注销时间
1	Best	英属维尔京群岛	张世龙持有其 100%股权	2013 年 2 月 21 日
2	Coretech	英属维尔京群岛	林林、张勤、Cong Wang、Anmei Shen、林哲伟和汤涵宇分别持股 43.23%、35.61%、10.58%、8.42%、1.62%和 0.54%	2012 年 12 月 27 日
3	SG Micro Limited	开曼群岛	Best 持有其 54.22%股权，Coretech 持有 45.78%股权	2012 年 10 月 19 日
4	Sea Fine	英属维尔京群岛	SG Micro Limited 持有其 100%股权	2012 年 3 月 6 日

（二）关联交易

1、关联担保

2014 年 12 月，公司实际控制人为本公司借款提供保证担保，情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
张世龙	圣邦股份	1,000,000.00	2014-12-05	2015-08-12	履行完毕

2、关键管理人员薪酬

2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月，公司支付的董事、监事、高级管理人员的税前薪酬总额分别为 418.61 万元、439.03 万元、408.76 万元和 153.09 万元。

三、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见

（一）报告期内关联交易制度的执行情况

公司生产经营体系独立、完整，上不存在依赖关联方的情形；股份公司设立以来，公司的关联交易均严格履行了《公司章程》和《关联交易决策制度》等文件的规定，不存在损害股东及公司利益的情形。

（二）独立董事关于关联交易的意见

独立董事对报告期内关联交易履行程序的合法性及交易价格的公允性发表意见如下：

“1、公司在报告期内与关联方发生的关联交易金额较小，对其财务状况和经营成果无重大影响，关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。2、公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平合理的原则，关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易定价客观公允，内容合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。3、公司已在《公司章程》、《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》及《独立董事工作制度》等各项治理规章制度中规定了关联交易公允的决策程序，为保护中小股东的利益，避免不公允交易提供了制度保障。”

第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理

一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况

（一）董事会成员

张世龙，男，1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士学位。曾任铁道部专业设计院工程师、德州仪器工程师、哈尔滨圣邦总经理、圣邦有限董事长兼总经理。2012 年 4 月至今，任圣邦股份董事长、总经理，同时担任公司控股股东鸿达永泰执行董事、公司全资子公司香港圣邦董事、公司股东宝利鸿雅监事。张世龙先生曾先后荣获“中关村高端领军人才”、“北京市海外高层次人才，北京市特聘专家”、“中关村十大海归创业之星”、“国家千人计划”、“国家特聘专家”、“科技北京百名领军人才”等荣誉。

张勤，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任哈尔滨圣邦副总经理、圣邦有限董事兼副总经理。2012 年 4 月至今，任圣邦股份董事、副总经理、董事会秘书，同时担任公司全资子公司香港圣邦董事、公司股东宝利鸿雅执行董事。张勤与张世龙为表兄妹关系。

林林，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任哈尔滨圣邦副总经理、圣邦有限行政工作负责人。2012 年 4 月至今，任圣邦股份董事，同时担任公司全资子公司香港圣邦董事、公司股东哈尔滨珺霖执行董事及经理。

李书锋，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学院，博士学位，教授。1986 年 7 月至 1990 年 12 月担任湖南省宜章县第一中学教师，1991 年 1 月至 1998 年 8 月担任湖南科技大学经济系讲师，2002 年 9 月至 2005 年 12 月担任湖南大学会计学院副教授。2004 年 9 月至今担任中央民族大学教授。2012 年 10 月至今任北京源发智信管理咨询有限责任公司董事长、2004 年 8 月至今任张家界源发水电开发有限公司董事长。2012 年 4 月至今，任圣邦股份独立董事。李书锋的兼职单位除因兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

王涌，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法

大学研究生院，主修民商法学，教授，博士学位。1986年8月至1990年9月曾在江苏省盐城团市委，1990年9月至1993年9月任职盐城市人事局；1998年8月至今任职于中国政法大学。现任中国政法大学教授、商法研究所所长，兼任浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事、威海光威复合材料股份有限公司独立董事、第一拖拉机股份有限公司监事、中科创达软件股份有限公司独立董事、北京信威通信科技集团股份有限公司独立董事、北京市隆安律师事务所兼职律师。2012年4月至今，任圣邦股份独立董事。王涌的兼职单位除因兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

（二）监事会成员

卞晓蒙，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学软件与微电子学院软件工程专业，硕士研究生。曾任圣邦有限IT部经理。2012年4月至今，任圣邦股份监事会主席、IT部经理，同时担任公司股东金华添达执行事务合伙人。

赵媛媛，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财贸学院计算机基础及应用专业，大专学历。2011年11月至2012年4月任圣邦有限总经理办公室特别助理。2012年4月至今，任圣邦股份职工代表监事、总经理办公室特别助理，同时担任公司股东盈华锐时执行事务合伙人。

刘明，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学机械设计与制造专业，本科学历。2007年1月至2012年4月任圣邦有限客户服务代表。2012年4月至今，任圣邦股份监事、客户服务代表，同时担任公司股东高迪达天执行职务合伙人。

（三）高级管理人员

张世龙，总经理，简历详见本节之“一、（一）董事会成员”。

张勤，副总经理、董事会秘书，简历详见本节之“一、（一）董事会成员”。

林明安，男，1955年出生，中国台湾籍，毕业于美国威利米特大学，阿特金森管理研究生院，MBA，主修财务运营管理。1980年5月至1988年7月任National Semiconductor Corp. 美国 Santa Clara 晶圆事业部财务总监，1988年8月至1993年1月Mosel Vitelic Corp.（美国和台湾）总公司主计长，1993年2

月至 1994 年 4 月任 Harmonic Inc. 美国总公司主计长，1994 年 5 月至 2001 年 1 月 Silicon Magic Inc. 美国总公司财务长及共同创办人，2001 年 2 月至 2002 年 11 月任 Digital Quake Inc. 美国总公司财务长，2003 年 8 月至 2005 年 8 月任 Thermacore Taiwan Inc. 台湾公司财务长，2005 年 9 月至 2007 年 5 月任上海方泰电子科技有限公司财务兼运营副总裁，2007 年至 2012 年 4 月任圣邦有限副总经理。2012 年 4 月至今，任圣邦股份副总经理，同时担任公司股东鹏成国际董事。

张海冰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任成都电业局工程师、德州仪器设计工程师、圣邦有限副总经理。2012 年 4 月至今，任圣邦股份副总经理。

张绚，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学会计学专业，注册会计师，本科学历。曾任京都天华会计师事务所有限公司高级经理、北京弘毅远方投资顾问有限公司高级顾问，2011 年 8 月至 2012 年 4 月圣邦有限财务总监。2012 年 4 月至今，任圣邦股份财务总监。

（四）其他核心人员

姚若亚，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任北京电力高等专科学校信息系主任、北京交通大学电子信息学院通信系副主任、北京超思电子技术公司技术部经理、深圳市理邦精密仪器有限公司总工兼多参数产品线总监、圣邦有限首席科学家，战略发展总监。2012 年 4 月至今，任圣邦股份首席科学家，战略发展总监。

谭磊，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学无线电电子学专业，本科学历。1983 年 7 月至 1996 年 5 月任核工业部北京核仪器厂第二和第四研究室副主任，1996 年 9 月至 2008 年 5 月任美国美信集成产品公司北京办事处中国区现场应用工程经理，2008 年 5 月至 2009 年 7 月任香港研诺逻辑科技有限公司北京代表处中国区现场应用工程总监，2009 年 11 月至 2011 年 5 月任技领半导体(上海)有限公司电源管理产品线总监，2011 年 5 月至 2012 年 4 月任圣邦有限现场应用工程总监。2012 年 4 月至今任圣邦股份现场应用工程总监。

徐前江，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学凝聚态物理专业，硕士研究生。1995 年至 1997 年任台湾联华电子股份有限公

司集成电路设计工程师，1998年至2001年任美国国家半导体公司上海办事处高级应用工程师，2002年至2006年任美国英特矽尔半导体有限公司上海办事处高级应用工程师，2007年1月至2012年4月圣邦有限市场总监。2012年4月至今，任圣邦股份市场总监。

公司董事、监事、高级管理人员中，除张世龙与张勤为表兄妹外，不存在其他亲属关系。

公司董事、监事、高级管理人员已熟悉我国股票发行上市的相关法律法规及其法定义务责任。

二、董事、监事的提名与选聘情况

2012年4月26日，公司召开创立大会由股东共同选举张世龙、张勤、林林、李书锋、王涌为公司第一届董事会成员。2012年4月26日，公司创立大会选举卞晓蒙、刘明为第一届监事会成员，2012年4月10日，公司第一届职工代表大会第一次会议选举赵媛媛为第一届职工代表监事。

2015年5月4日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司同意张世龙先生、张勤女士、林林先生任公司第二届董事会的非独立董事；同意李书锋先生、王涌先生任公司第二届董事会独立董事；审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司同意卞晓蒙女士、刘明女士任公司第二届监事会监事，2015年3月30日，公司职工代表大会选举赵媛媛为第二届职工代表监事。

三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况

截至2015年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接、间接持有公司股份情况如下：

姓名	持股形式	间接持股公司名称	在股东公司的持股比例	股东公司在本公司的持股比例
张世龙	间接	鸿达永泰	100.00%	28.13%
Wen Li	间接	弘威国际	100.00%	8.00%
张勤	间接	宝利鸿雅	100.00%	12.95%

姓名	持股形式	间接持股公司名称	在股东公司的持股比例	股东公司在本公司的持股比例
林林	间接	哈尔滨珺霖	100.00%	12.09%
卞晓蒙	间接	金华添达	0.65%	2.89%
赵媛媛	间接	盈华锐时	0.76%	2.48%
刘明	间接	高迪达天	0.85%	2.08%
林明安	间接	鹏成国际	46.95%	1.96%
张海冰	间接	盈华锐时	84.53%	2.48%
张绚	间接	盈华锐时	1.24%	2.48%
		高迪达天	0.79%	2.08%
姚若亚	间接	金华添达	2.62%	2.89%
谭磊	间接	金华添达	1.64%	2.89%
		盈华锐时	0.24%	2.48%
		高迪达天	0.11%	2.08%
徐前江	间接	金华添达	15.96%	2.89%

注：Wen Li 与张世龙系夫妻关系

截至 2015 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属除上述持股情况，不存在其他直接、间接持有公司股份的情况。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所持有的公司股份不存在质押或被冻结的情况。

公司董事、监事、高级管理人员已熟悉我国股票发行上市的相关法律法规及其法定义务责任。

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均不存在与公司业务相关及与公司存在利益冲突的对外投资。

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况

2012 年、2013 年和 2014 年，公司董事、监事、高级管理人员的税前薪酬总额分别为 418.61 万元、439.03 万元和 408.76 万元，占年度利润总额的比例分别为 8.49%、8.17%和 5.92%。

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2014 年在公司领取薪酬情况如下：

姓 名	在公司任职情况	2014 年薪酬情况 (万元)	备注
张世龙	董事长、总经理	59.67	在公司领薪
张 勤	董事、副总经理、董事会秘书	50.07	在公司领薪
林 林	董事	26.16	在公司领薪
李书锋	独立董事	7.20	在公司领薪
王 涌	独立董事	7.20	在公司领薪
卞晓蒙	监事会主席	18.67	在公司领薪
赵媛媛	职工代表监事	20.66	在公司领薪
刘 明	监事	18.10	在公司领薪
林明安	副总经理	55.60	在公司领薪
张海冰	副总经理	78.16	在公司领薪
张 绚	财务总监	67.27	在公司领薪
姚若亚	核心技术人员	56.27	在公司领薪
谭 磊	核心技术人员	67.27	在公司领薪
徐前江	核心技术人员	65.98	在公司领薪

六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议以及协议的履行情况

除独立董事外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订了《劳动合同》、《信息保密和创造归属确认书》。

截至 2015 年 6 月 30 日，上述协议和承诺均得以良好履行。

七、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

近两年内，公司的董事、监事、高级管理人员未发生变动。

八、股东大会、董事会、监事会等机构和人员的运行情况

（一）报告期内发行人公司治理存在的主要缺陷及改进情况

报告期内，部分专门委员会会议的通知时间未严格按照相关议事规则的规定执行，公司未来将严格按照《公司法》及公司指定的相关议事规则召开相应会

议。

（二）报告期内发行人股东大会、董事会、监事会的实际运行情况

报告期内，除存在个别会议未按照《公司章程》的规定提前发出通知外，公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等规范运作。截至 2015 年 6 月 30 日，公司共召开了 12 次股东大会、16 次董事会和 10 次监事会。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会或高级管理人员不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，依据《中国证监会关于在上市公司设立独立董事指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等要求严格履行独立董事职责，出席公司董事会会议，参与讨论决策有关重大事项。

独立董事参与董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会的工作。

（四）审计委员会及其他专门委员会的人员构成及运行情况

公司董事会下设的审计委员会成员为李书锋、王涌、张世龙，其中李书锋为专业会计人士，任审计委员会召集人。

公司董事会下设的薪酬与考核委员会成员为李书锋、王涌、张世龙，其中李书锋任召集人。

公司董事会下设的提名委员会成员为王涌、李书锋、张世龙，其中王涌任召集人。

公司董事会下设的战略委员会成员为张世龙、李书锋、王涌，其中张世龙任召集人。

报告期内，公司上述委员会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委

员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。截至 2015 年 6 月 30 日，公司审计委员会共召开了 11 次会议，薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议，提名委员会共召开 4 次会议，战略委员会共召开 3 次会议。

九、发行人内部控制制度情况

（一）公司管理层的自我评价

公司董事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。截止 2015 年 3 月 31 日，公司已经按照企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

（二）注册会计师的鉴证意见

发行人会计师认为，公司于 2015 年 3 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

十、发行人报告期内违法违规情况

报告期内，公司严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定开展经营，不存在违法违规行为，也不存在被主管机关处罚的情况。

十一、发行人近三年资金占用及担保情况

报告期内，公司不存在资金或资产被控股股东、实际控制人及其所控制的企业占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其所控制的企业提供担保的情形。

十二、发行人资金管理、对外投资、担保政策及执行情况

（一）资金管理制度安排及执行情况

公司在《财务管理制度》对资金管理作出了专门的规定。报告期内，公司所

有资金管理都按照上述制度执行。

（二）对外投资政策、制度安排及执行情况

公司 2015 年第二次临时股东大会通过了《对外投资制度》，对公司对外投资的审批权限，对外投资管理的组织机构、对外投资的具体管理方式、对外投资的转让与收回、对外投资的人事管理、对外投资的财务管理及审计、重大事项报告及信息披露等事宜作出规定。

报告期内，公司所有对外投资的决策都按上述规定履行了必要的程序。

（三）对外担保政策、制度安排及执行情况

公司 2015 年第二次临时股东大会通过了《对外担保决策制度》，对公司对外担保的基本原则、对外担保的审批权限及程序、担保的风险管理、对外担保的信息披露等事宜作出规定。

报告期内，公司所有对外担保的决策都按上述规定履行了必要的程序。

十三、投资者权益保护的相关措施

公司通过制定《公司章程》及《股东大会议事规则》明确了股东的权利及履行相关权利的程序。股东的权利包括：按照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委托股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；以及对三会进行合法性监督、起诉等各项权利，对股东收益权、知情权、表决权、处置权、监督权等在制度上提供了保障。

同时，公司制定了《信息披露制度》以规范公司的信息披露方式及内容，拟在首次公开发行股票并上市之日起执行，该制度明确要求对于证券及衍生品种交易价格将可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，公司应在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所；信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、

定期报告和临时报告等。从而为公司本次公开发行上市后切实保障投资者权益做好了充分的准备和制度安排。

此外，《公司章程（草案）》中规定，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。对董事、监事的选举，公司可以采取累积投票制，在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。公司将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。

未来公司将根据国家有关法律法规规定，进一步完善中小投资者单独计票等机制。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

第九节 财务会计信息与管理层分析

本节内容可能含有前瞻性描述，该类前瞻性描述包含了部分不确定事项，可能与公司的最终经营结果不一致。投资者应结合公司经审计的财务报告一并阅读本章节。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
货币资金	181,816,082.96	178,033,564.54	142,370,392.44	127,226,240.50
应收票据	-	-	-	-
应收账款	10,044,031.15	16,486,052.98	22,573,341.24	16,217,723.34
预付款项	1,997,679.80	109,566.00	154,276.00	116,235.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	383,615.22	387,001.01	1,615,405.68	6,074,572.97
存货	65,605,015.40	57,516,369.65	37,190,240.36	42,462,113.36
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	4,465,399.09	6,411,125.32	1,806,979.74	2,265,094.82
流动资产合计	264,311,823.62	258,943,679.50	205,710,635.46	194,361,980.19
可供出售金融资产	-	-	-	-
固定资产	4,311,200.46	4,507,499.66	3,379,973.48	3,193,481.84
在建工程	-	-	-	-
无形资产	1,804,749.76	2,074,347.64	2,657,024.93	1,771,775.05
长期待摊费用	6,993,089.26	7,728,159.39	5,315,458.23	4,854,848.88
递延所得税资产	5,632,747.24	4,261,185.57	4,320,032.57	3,111,232.14
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	18,741,786.72	18,571,192.26	15,672,489.21	12,931,337.91
资产总计	283,053,610.34	277,514,871.76	221,383,124.67	207,293,318.10
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付票据	-	-	-	-
应付账款	47,213,129.38	54,896,452.05	31,325,781.08	28,044,552.15
预收款项	1,175,785.30	449,941.33	14,638.05	103,640.48
应付职工薪酬	7,834,536.03	12,105,853.20	10,778,848.19	9,397,077.46
应交税费	3,879,615.66	2,745,929.60	4,463,904.33	3,049,274.24
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	3,460,974.51	2,377,540.46	1,453,920.62	2,503,750.05
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	64,564,040.88	73,575,716.64	48,037,092.27	43,098,294.38
预计负债	4,176,537.93	4,416,905.96	3,407,507.49	2,260,817.76
递延收益	10,350,000.00	5,590,000.00	2,730,000.00	1,230,000.00
递延所得税负债	269,414.82	310,864.10	-	-
非流动负债合计	14,795,952.75	10,317,770.06	6,137,507.49	3,490,817.76
负债合计	79,359,993.63	83,893,486.70	54,174,599.76	46,589,112.14
股本	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	25,496,825.78	25,496,825.78	25,496,825.78	25,496,825.78
其他综合收益	-2,916,848.79	-3,164,329.43	-3,259,536.41	-1,695,615.24
盈余公积	14,897,989.93	14,897,989.93	10,289,625.81	6,474,728.43
未分配利润	121,215,649.79	111,390,898.78	89,681,609.73	85,428,266.99
归属于母公司所有者权益合计	203,693,616.71	193,621,385.06	167,208,524.91	160,704,205.96
所有者权益合计	203,693,616.71	193,621,385.06	167,208,524.91	160,704,205.96
负债和所有者权益总计	283,053,610.34	277,514,871.76	221,383,124.67	207,293,318.10

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年	2013年	2012年
一、营业收入	78,300,855.89	325,914,689.24	249,170,325.42	226,613,108.88
减：营业成本	46,309,748.68	194,340,974.06	136,582,700.62	123,050,041.20
营业税金及附加	489,539.44	1,649,809.59	1,429,537.68	1,315,843.19
销售费用	6,454,670.32	25,397,958.78	24,322,923.38	22,578,726.93

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
管理费用	12,201,968.31	39,368,049.13	30,523,939.18	26,908,390.05
财务费用	-574,993.29	-4,345,373.38	-297,453.82	-606,878.94
资产减值损失	1,490,125.10	4,294,328.70	5,107,449.51	4,523,704.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润	11,929,797.33	65,208,942.36	51,501,228.87	48,843,281.48
加：营业外收入	-	3,786,906.20	2,204,923.00	491,470.00
减：营业外支出	-	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额	11,929,797.33	68,995,848.56	53,706,151.87	49,334,751.48
减：所得税费用	2,105,046.32	6,678,195.39	5,637,911.75	2,352,793.92
四、净利润	9,824,751.01	62,317,653.17	48,068,240.12	46,981,957.56
归属于母公司股东的净利润	9,824,751.01	62,317,653.17	48,068,240.12	46,981,957.56
少数股东损益	-	-	-	-
五、其他综合收益	247,480.64	95,206.98	-1,563,921.17	-122,135.19
六、综合收益总额	10,072,231.65	62,412,860.15	46,504,318.95	46,859,822.37
归属于母公司股东的综合收益总额	10,072,231.65	62,412,860.15	46,504,318.95	46,859,822.37
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
七、每股收益	-	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	0.2183	1.3848	1.0682	1.0440
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	86,812,238.04	338,449,625.46	249,716,766.75	240,143,334.56
收到的税费返还	6,074,945.28	16,679,105.37	16,349,028.50	12,286,701.27
收到其他与经营活动有关现金	421,543.76	7,712,979.64	4,208,237.12	1,875,798.36
经营活动现金流入小计	93,308,727.08	362,841,710.47	270,274,032.37	254,305,834.19
购买商品、接受劳务支付的现金	70,059,811.33	216,015,954.62	145,810,470.46	146,034,379.80

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
支付给职工以及为职工支付的现金	15,592,415.29	41,868,287.02	36,800,683.03	31,100,832.16
支付的各项税费	3,172,937.64	10,507,906.17	7,515,564.08	5,898,388.59
支付其他与经营活动有关现金	5,871,576.05	19,988,018.06	18,039,546.30	18,922,879.48
经营活动现金流出小计	94,696,740.31	288,380,165.87	208,166,263.87	201,956,480.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,388,013.23	74,461,544.60	62,107,768.50	52,349,354.16
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,409.84	6,849,029.61	5,967,940.85	7,531,602.87
投资支付的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	201,409.84	6,849,029.61	5,967,940.85	7,531,602.87
投资活动产生的现金流量净额	-201,409.84	-6,849,029.61	-5,967,940.85	-7,531,602.87
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	1,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关现金	5,000,000.00	2,790,000.00	1,432,000.00	-
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	3,790,000.00	1,432,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,997.78	36,000,000.00	40,000,000.00	13,500,000.00
支付其他与筹资活动有关现金	-	-	-	386,187.14
筹资活动现金流出小计	17,997.78	36,000,000.00	40,000,000.00	13,886,187.14
筹资活动产生的现金流量净额	4,982,002.22	-32,210,000.00	-38,568,000.00	-13,886,187.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	389,939.27	260,657.11	-2,427,675.71	-162,038.73
五、现金及现金等价物净增加额	3,782,518.42	35,663,172.10	15,144,151.94	30,769,525.42
加：期初现金及现金等价物余额	178,033,564.54	142,370,392.44	127,226,240.50	96,456,715.08
六、期末现金及现金等价物余额	181,816,082.96	178,033,564.54	142,370,392.44	127,226,240.50

二、审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月的财务数据进行了审计，并出具了“致同审字(2015)第 110ZA4557 号”标准无保留意见的审计报告。

三、主要会计政策和会计估计

（一）收入

1、收入确认原则

（1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①、收入的金额能够可靠地计量；②、相关的经济利益很可能流入企业；③、交易的完工程度能够可靠地确定；④、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

2、收入确认的具体方法

公司销售模拟芯片的产品收入均属于销售商品收入，且不用安装。在相关产品发出并确认客户已经收到时，依据合同约定的价格条款确认当期实现的收入。

（二）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

3、按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

确定组合的依据	
账龄分析法组合	账龄状态
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年，以下同）	1%	1%
1-2 年	30%	30%
2-3 年	100%	50%
3 年以上	100%	100%

（三）存货

1、存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品。

2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（四）固定资产

1、固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类

固定资产的年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
运输设备	4	-	25.00%
办公家具	5	-	20.00%
电子设备及其他	3-5	-	20.00%-33.33%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节“三、主要会计政策和会计估计”之部分“（九）资产减值”。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能

够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

5、固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

6、大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（五）无形资产

1、无形资产为软件。

2、无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	摊销年限
软件	2-5 年

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本节“三、主要会计政策和会计估计”之部分“（九）资产减值”。

（六）研究开发支出

1、本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

2、研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

3、开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

（七）政府补助

1、政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

2、对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

3、与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

4、对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

5、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

6、已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（九）资产减值

对子公司、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

1、于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

2、可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

3、当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

4、就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

5、减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十）长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（十一）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- 1、该义务是本公司承担的现时义务；
- 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（十二）会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正

1、重要会计政策变更

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称企业会计准则第37

号)，除企业会计准则第 37 号在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。

报告期内，本公司不存在因会计政策变更导致的重大影响。

2、报告期内不存在会计估计变更。

四、主要税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%

注：根据《中华人民共和国香港特别行政区税务局税务条例释义及执行指引第21号（修订本）》的规定，在评定香港业务从事商品或货物买卖交易所得利润的来源地时，如有关买卖合约在香港达成，所得利润须在港课税，如有关买卖合约在香港以外的地方达成，所得利润不须在港课税。香港圣邦的买卖合约在香港以外的地方达成，因此香港圣邦不需缴纳所得税。

（二）税收优惠及文件

1、所得税

根据北京市海淀区国家税务局《关于对圣邦微电子（北京）有限公司申请享受高新技术企业所得税减免税问题的批复》（海国税减免外字[2008]第 4008 号），本公司从 2007 年起减按 15 % 缴纳企业所得税，2007 至 2009 年免缴企业所得税，2010 年至 2012 年减半缴纳企业所得税，执行 7.5% 的税率。

公司于 2009 年 6 月 12 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局认定为高新技术企业。

公司于 2012 年通过了高新技术企业复审，并于 2012 年 5 月 24 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，编号为 GF201211000015，有效期三年，在此期

间减按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。2013 年、2014 年执行 15% 的税率。

2、增值税

根据财政部、国家税务总局颁布的“财税[2011]131 号”《关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》和“财税[2012]71 号”《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》的规定，本公司从事向境外提供技术转让服务取得的收入，符合条件的，免征增值税。

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改增值税试点的通知》（财税字[2013]106 号）规定，本公司从事向境外提供技术转让服务取得的收入，符合条件的，免征增值税。

3、营业税

根据财政部、国家税务总局颁布的“财税字[1999]273 号”《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》规定，公司从事技术转让业务取得的收入，符合条件的，免征营业税。

五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	346.14	220.49	49.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-	32.55	-	-
非经营性损益对利润总额的影响合计	-	378.69	220.49	49.15
减：所得税影响数	-	51.92	33.07	3.69

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司的非经常性损益净额	-	326.77	187.42	45.46
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	982.48	5,905.00	4,619.40	4,652.74

报告期内，公司非经常性损益主要由政府补助构成。报告期内各期，公司扣除所得税影响后的非经常性损益分别为 45.46 万元、187.42 万元、326.77 万元和 0.00 万元，占当期净利润的比例分别为 0.97%、3.90%、5.24%和 0.00%。

六、主要财务指标

（一）主要财务指标

主要财务指标	2015 年 1-3 月/ 2015 年 3 月 31 日	2014 年/ 2014 年 12 月 31 日	2013 年/ 2013 年 12 月 31 日	2012 年/ 2012 年 3 月 31 日
资产负债率（合并）	28.04%	30.23%	24.47%	22.47%
资产负债率（母公司）	28.81%	30.05%	24.65%	19.45%
流动比率	4.09	3.52	4.28	4.51
速动比率	3.08	2.74	3.51	3.52
应收账款周转率	5.84	16.52	12.72	10.93
存货周转率	0.75	4.10	3.43	3.23
息税折旧摊销前利润(万元)	1,262.26	7,140.89	5,565.05	5,132.53
归属于发行人股东的净利润(万元)	982.48	6,231.77	4,806.82	4,698.20
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	982.48	5,905.00	4,619.40	4,652.74
利息保障倍数	663.85	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量(元)	-0.03	1.65	1.38	1.16
每股净现金流量(元)	0.08	0.79	0.34	0.68
归属于公司普通股股东的每股净资产(元)	4.53	4.30	3.72	3.57
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例	0.89%	1.07%	1.59%	1.10%

注：上述财务指标的具体计算公式如下：

- 1、资产负债率=总负债/总资产
- 2、流动比率=流动资产/流动负债
- 3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销
- 7、利息保障倍数=(税前利润+利息支出)/利息支出
- 8、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 9、每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
- 10、归属于公司普通股股东的每股净资产=期末股东权益合计/期末股本总额
- 11、无形资产(土地使用权除外)占净资产比例=无形资产(扣除土地使用权)/期末净资产

(二) 净资产收益率和每股收益

根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

项目	净资产收益率	每股收益(元)	
	加权平均	基本	稀释
2015年1-3月			
归属于公司普通股股东的净利润	4.95%	0.2183	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.95%	0.2183	-
2014年			
归属于公司普通股股东的净利润	35.13%	1.3848	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33.28%	1.3122	-
2013年			
归属于公司普通股股东的净利润	29.93%	1.0682	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.76%	1.0265	-
2012年			
归属于公司普通股股东的净利润	32.62%	1.0440	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32.31%	1.0339	-

注:由于不存在稀释事项,稀释每股收益与基本每股收益一致

七、盈利能力分析

(一) 公司的收入与盈利总体情况

公司收入与盈利总体情况

单位:万元

项目	2015年1-3月	2014年	2013年	2012年
----	-----------	-------	-------	-------

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
营业收入	7,830.09	32,591.47	24,917.03	22,661.31
营业成本	4,630.97	19,434.10	13,658.27	12,305.00
营业毛利	3,199.11	13,157.37	11,258.76	10,356.31
期间费用	1,808.16	6,042.06	5,454.94	4,888.02
营业利润	1,192.98	6,520.89	5,150.12	4,884.33
利润总额	1,192.98	6,899.58	5,370.62	4,933.48
净利润	982.48	6,231.77	4,806.82	4,698.20

（二）营业收入构成及变化原因分析

1、营业收入产品分类

报告期内，公司营业收入全部来自于芯片产品的销售，公司的芯片产品分为信号链产品和电源管理产品两类，具体收入构成如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
信号链产品	3,819.28	48.78%	14,416.20	44.23%	13,841.23	55.55%	12,170.35	53.71%
电源管理产品	4,010.80	51.22%	18,175.27	55.77%	11,075.80	44.45%	10,490.96	46.29%
合计	7,830.09	100.00%	32,591.47	100.00%	24,917.03	100.00%	22,661.31	100.00%

报告期内，公司主要产品销售情况良好，收入逐年增长。2014 年以来，随着电源管理类产品销售收入大幅增加，公司收入较 2013 年增加 7,674.44 万元，增长 30.80%。

2、营业收入地域分布

香港为传统的电子元器件交易集散地之一，报告期内各期，公司销售给香港地区客户收入占营业收入的比例分别为 87.03%、85.59%、86.73%和 83.67%，收入的构成情况具体如下：

按地域分类的收入构成情况

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

项目	2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
大陆	997.76	12.74%	3,126.01	9.59%	2,429.85	9.75%	1,980.12	8.74%
香港	6,551.37	83.67%	28,265.34	86.73%	21,327.28	85.59%	19,721.15	87.03%
台湾	170.46	2.18%	801.60	2.46%	976.63	3.92%	692.50	3.06%
其他	110.49	1.41%	398.52	1.22%	183.28	0.74%	267.54	1.17%
合计	7,830.09	100.00%	32,591.47	100.00%	24,917.04	100.00%	22,661.31	100.00%

3、营业收入变动分析

报告期内，公司主要产品的销量与价格变化情况具体如下：

公司主要产品销量及价格变化情况

项目		2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
信号链产品	收入（万元）	3,819.28	14,416.20	13,841.23	12,170.35
	销量（万颗）	8,908.03	29,726.15	27,184.50	24,301.06
	单价（元/颗）	0.4287	0.4850	0.5092	0.5008
电源管理产品	收入（万元）	4,010.80	18,175.27	11,075.80	10,490.96
	销量（万颗）	16,036.47	67,623.41	42,480.59	37,813.60
	单价（元/颗）	0.2501	0.2688	0.2607	0.2774

报告期内，公司不断推出新产品，既有产品销售逐年趋稳，两类主要产品销售额呈逐年增长趋势。

（1）信号链产品

报告期内各期，公司信号链产品销售收入分别为 12,170.35 万元、13,841.23 万元、14,416.20 万元和 3,819.28 万元，占销售收入的比例分别为 53.71%、55.55%、44.23%和 48.78%。

2013 年，公司信号链产品销售收入较 2012 年上升 1,670.88 万元，上升 13.73%；销售单价（每颗）较 2012 年上升 0.0083 元，上升 1.67%；销量较 2012 年增加 2,883.44 万颗，增长 11.87%。

2014 年，公司信号链产品销售收入较 2013 年上升 574.97 万元，上升 4.15%；销售单价（每颗）较 2013 年下降 0.0242 元，下降 4.75%；销量较 2013 年上升 2,541.65 万颗，上升 9.35%。

报告期内，公司通过持续研发、开拓新产品及拓展现有产品的销售规模，信号链产品销售数量逐年增长，信号链产品销售收入相应逐年增长。

（2）电源管理产品

报告期内各期，公司电源管理产品销售收入分别为 10,490.96 万元、11,075.80 万元、18,175.27 万元和 4,010.80 万元，占销售收入的比例分别为 46.29%、44.45%、55.77%和 51.22%。

2013 年，公司电源管理产品销售收入较 2012 年上升 584.84 万元，上升 5.57%；销售单价（每颗）较 2012 年下降 0.0167 元，下降 6.02%；销量较 2012 年上升 4,666.99 万颗，上升 12.34%。

2014 年，公司电源管理产品销售收入较 2013 年上升 7,099.47 万元，上升 64.10%；销售单价（每颗）较 2013 年上升 0.0080 元，上升 3.09%；销量较 2013 年上升 25,142.82 万颗，上升 59.19%。

公司电源管理产品收入增长幅度较大的主要原因为电源管理类产品细分种类多，用途广泛，发展空间较大，随着国内手机市场高速发展，2014 年公司 LED 驱动产品销量大幅增加。

（三）毛利率及成本分析

公司毛利、成本及毛利率情况

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
营业收入	7,830.09	32,591.47	24,917.03	22,661.31
同期增长率	-	30.80%	9.95%	-
营业成本	4,630.97	19,434.10	13,658.27	12,305.00
同期增长率	-	42.29%	11.00%	-
毛利总额	3,199.11	13,157.37	11,258.76	10,356.31
同期增长率	-	16.86%	8.71%	-
综合毛利率	40.86%	40.37%	45.19%	45.70%

2013 年，公司营业收入较 2012 年上升 9.95%，营业成本和毛利总额也相应上升，2013 年公司营业成本为 13,658.27 万元，同比上升 11.00%，毛利总额为 11,258.76 万元，同比上升 8.71%。2013 年公司综合毛利率为 45.19%，较 2012

年差别不大。

2014 年，公司营业收入较 2013 年上升 30.80%，营业成本和毛利总额也相应上升，2014 年公司营业成本为 19,434.10 万元，同比上升 42.29%，毛利总额为 13,157.37 万元，同比上升 16.86%。2014 年公司毛利率为 40.37%，较 2013 年下降 4.81 个百分点，主要原因为随着国内手机市场高速发展，2014 年公司 LED 驱动产品销量大幅增加，该等产品的毛利率相对较低所致。

公司毛利率与可比公司对比情况

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
北京君正	59.65%	55.46%	48.66%	47.75%
福星晓程	62.22%	47.56%	52.30%	53.64%
欧比特	46.58%	45.76%	46.99%	37.79%
国民技术	34.73%	39.18%	38.09%	35.94%
国内公司平均值	50.79%	46.99%	46.51%	43.78%
ADI*	66.36%	65.76%	64.82%	64.36%
Linear	76.04%	75.80%	75.16%	74.99%
Maxim	56.32%	57.47%	59.39%	60.57%
TI	57.65%	56.93%	52.14%	49.65%
Silergy	54.29%	54.54%	51.76%	47.71%
国际公司平均值	62.13%	62.10%	60.65%	59.46%
本公司	40.86%	40.37%	45.19%	45.70%

注：国内可比公司数据引自WIND数据库，国外可比公司数据引自Capital IQ数据库，其中ADI公司数据为其近三个财年数据及最近一期财务数据。

选择上述国外公司作为可比公司，主要是由于其为模拟芯片生产和销售的世界领先企业，部分产品系列与公司有重合；而国内几家上市公司，如北京君正、福星晓程、欧比特、国民技术，其主要产品虽与公司存在较大差异，但其主营业务从大行业上与公司相同，且其为国内上市公司，有公开披露数据，因此选择上述公司为可比公司。

报告期内，公司综合毛利率与国内可比公司相比处于中等水平，低于国际可比公司，主要因为 ADI、TI 等公司均为行业内国际巨头，具有产品种类多、研发能力强、市场占有率高等优势，并且具有淘汰低毛利产品线的技术实力和资本实力，引领行业话语权，以此保持其高毛利率。随着公司技术实力与市场占有率

进一步提升，公司的毛利率水平仍有提升空间。

1、毛利率分析

报告期内，公司各产品的毛利及毛利率情况如下：

公司各产品的毛利及毛利率情况

单位：万元

类别	2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年		2012 年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
信号链产品	1,872.93	49.04%	7,217.82	50.07%	6,908.60	49.91%	6,078.59	49.95%
电源管理产品	1,326.18	33.07%	5,939.55	32.68%	4,350.16	39.28%	4,277.72	40.78%
合计	3,199.11	40.86%	13,157.37	40.37%	11,258.76	45.18%	10,356.31	45.70%

（1）信号链产品毛利率

报告期内各期，公司信号链产品的毛利分别为 6,078.59 万元、6,908.60 万元、7,217.82 万元和 1,872.93 万元，毛利率分别为 49.95%、49.91%、50.07%和 49.04%，具体情况如下：

信号链产品单位售价及成本情况

项目	数量 (万颗)	收入 (万元)	单位售价 (元/颗)	成本 (万元)	单位成本 (元/颗)	毛利率
2015年1-3月	8,908.03	3,819.28	0.4287	1,946.35	0.2185	49.04%
2014年	29,726.15	14,416.20	0.4850	7,198.38	0.2422	50.07%
2013年	27,184.50	13,841.23	0.5092	6,932.63	0.2550	49.91%
2012年	24,301.06	12,170.35	0.5008	6,091.76	0.2507	49.95%

报告期内，公司信号链产品单位售价与单位成本总体呈略微下降趋势，与电子元器件产品的价格趋势一致，产品毛利率基本保持稳定。

（2）电源管理产品

报告期内各期，公司电源管理产品的毛利分别为 4,277.72 万元、4,350.16 万元、5,939.55 万元和 1,326.17 万元，毛利率分别为 40.78%、39.28%、32.68%和 33.07%，具体情况如下：

电源管理产品单位售价及成本情况

项目	数量 (万颗)	收入 (万元)	单位售价 (元/颗)	成本 (万元)	单位成本 (元/颗)	毛利率
2015年1-3月	16,036.47	4,010.80	0.2501	2,684.63	0.1674	33.07%
2014年	67,623.41	18,175.27	0.2688	12,235.72	0.1809	32.68%
2013年	42,480.59	11,075.80	0.2607	6,725.64	0.1583	39.28%
2012年	37,813.60	10,490.96	0.2774	6,213.24	0.1643	40.78%

2013年，公司电源管理产品单位售价较2012年下降0.0167元，降幅为6.02%，单位成本减少0.0060元，降幅为3.65%，毛利率较2012年下降1.50个百分点，毛利率水平与上年差别不大。

2014年，公司电源管理产品单位售价较2013年上升0.0080元，增幅为3.09%，单位成本上升0.0226元，增幅为14.29%，毛利率较2013年下降6.60个百分点，主要原因为随着国内手机市场高速发展，2014年公司LED驱动产品销量大幅增加，该等产品的单位成本和单位售价相对较高但毛利率相对较低，毛利率较低的LED驱动产品收入占比提高导致公司电源管理产品毛利率降低。

2、成本及敏感性分析

（1）营业成本的构成分析

公司营业成本构成

单位：万元

项目	2015年1-3月		2014年		2013年		2012年	
晶圆	1,756.07	37.92%	7,654.34	39.39%	5,094.20	37.30%	4,343.39	35.30%
封装测试	2,751.73	59.42%	11,200.17	57.63%	8,079.05	59.15%	7,484.97	60.83%
其他	123.18	2.66%	579.58	2.98%	485.03	3.55%	476.64	3.87%
合计	4,630.97	100.00%	19,434.10	100.00%	13,658.27	100.00%	12,305.00	100.00%

报告期内各期，公司原材料晶圆成本占生产成本的比例分别为35.30%、37.30%、39.39%和37.92%；封装测试费占生产成本的比例分别为60.83%、59.15%、57.63%和59.42%。

（2）营业成本的变动分析

报告期内，成本变动主要与晶圆成本及封装测试费成本有关，公司芯片产品的单位销售成本变化情况如下：

公司单位销售成本

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
晶圆	0.0704	0.0786	0.0731	0.0699
封装测试	0.1103	0.1151	0.1160	0.1205
其他	0.0049	0.0060	0.0070	0.0077
合计	0.1857	0.1996	0.1961	0.1981

报告期内各期，公司产品单位销售成本分别为 0.1981 元、0.1961 元、0.1996 元和 0.1857 元，各期间单位销售成本波动原因如下：

① 晶圆成本

报告期内公司营业成本中包含的晶圆成本如下：

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
晶圆成本（万元）	1,756.07	7,654.34	5,094.20	4,343.39
销量（万颗）	24,944.50	97,349.56	69,665.09	62,114.66
单位晶圆成本（元/颗）	0.0704	0.0786	0.0731	0.0699

晶圆采购价格随着公司采购量大幅增长，供应商给予公司的优惠也随之增长，因此晶圆采购价格会有所下降；但公司为提高竞争力，逐渐开发性能较强、工艺较为复杂的新产品，此类产品单片晶圆采购成本较高导致晶圆采购单价上升，因此 2012 以来，公司晶圆采购单价较前一年度略有上升。

报告期内公司晶圆的采购单价如下：

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
采购金额（万元）	2,344.41	9,264.55	5,329.40	5,486.73
采购数量（万颗）	33,670.68	117,075.27	70,091.45	75,473.42
采购单价（元/颗）	0.0696	0.0791	0.0760	0.0727

② 封装测试成本

报告期内公司营业成本中包含的封装测试成本如下：

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
封装测试成本（万元）	2,751.72	11,200.17	8,079.05	7,484.97
销售数量（万颗）	24,944.50	97,349.56	69,665.09	62,114.66

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
单位封装测试成本（元/颗）	0.1103	0.1151	0.1160	0.1205

2012 年以来，公司开展版图设计改进、优化封装测试程序、尝试寻找最优封装类型、根据各封装厂的特点择优选择性价比高者等措施降低成本，因此报告期内单位封装测试成本有所下降。

（3）敏感性分析

①主要产品价格变动的敏感系数

报告期内，公司主要产品的平均销售价格变动对营业利润及毛利率的敏感系数如下：

公司主要产品价格变动的敏感系数

产品	2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年		2012 年	
	对营业利润的影响	对毛利率的影响	对营业利润的影响	对毛利率的影响	对营业利润的影响	对毛利率的影响	对营业利润的影响	对毛利率的影响
信号链产品	2.93%	0.69%	2.06%	0.66%	2.44%	0.69%	2.26%	0.64%
电源管理产品	3.10%	0.74%	2.60%	0.83%	1.92%	0.54%	1.93%	0.55%

以 2014 年为例，公司信号链产品平均销售价格上升 1%，公司的营业利润将上升 2.06%，毛利率将上升 0.66%；电源管理类产品销售价格上升 1%，公司的营业利润将上升 2.60%，毛利率将上升 0.83%。

②主要产品成本变动的敏感系数

报告期内，公司主要产品的平均成本变动对营业利润及毛利率的敏感系数如下：

公司主要产品成本变动的敏感系数

产品	2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年		2012 年	
	对营业利润的影响	对毛利率的影响	对营业利润的影响	对毛利率的影响	对营业利润的影响	对毛利率的影响	对营业利润的影响	对毛利率的影响
信号链产品	-1.61%	-0.61%	-1.10%	-0.54%	-1.35%	-0.61%	-1.23%	-0.58%
电源管理产品	-2.23%	-0.84%	-1.87%	-0.92%	-1.31%	-0.59%	-1.25%	-0.59%

以 2014 年为例，公司信号链平均成本上升 1%，公司的营业利润将下降

1.10%，毛利率将下降 0.54%；电源管理产品平均成本上升 1%，公司的营业利润将下降 1.87%，毛利率将下降 0.92%。

③ 成本变动的敏感系数

报告期内，公司主要原材料变动对营业利润及毛利率的敏感系数如下：

公司成本变动的敏感系数

产品	2015 年 1-3 月		2014 年		2013 年		2012 年	
	对营业利润的影响	对毛利率的影响	对营业利润的影响	对毛利率的影响	对营业利润的影响	对毛利率的影响	对营业利润的影响	对毛利率的影响
晶圆	-1.47%	-0.56%	-1.16%	-0.57%	-0.98%	-0.44%	-0.88%	-0.42%
封装测试	-2.31%	-0.87%	-1.72%	-0.85%	-1.57%	-0.71%	-1.53%	-0.72%
其他	-0.10%	-0.05%	-0.09%	-0.04%	-0.09%	-0.03%	-0.10%	-0.05%

以 2014 年为例，公司晶圆价格上升 1%，公司的营业利润将下降 1.16%，毛利率将下降 0.57%；封装测试价格上升 1%，公司的营业利润将下降 1.72%，毛利率将下降 0.85%；其他成本价格上升 1%，公司的营业利润将下降 0.09%，毛利率下降 0.04%。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用具体情况如下：

公司期间费用构成

单位：万元

项目		2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
销售费用	金额	645.47	2,539.80	2,432.29	2,257.87
	占营业收入比例	8.24%	7.79%	9.76%	9.96%
管理费用	金额	1,220.20	3,936.80	3,052.39	2,690.84
	占营业收入比例	15.58%	12.08%	12.25%	11.87%
财务费用	金额	-57.50	-434.54	-29.75	-60.69
	占营业收入比例	-0.73%	-1.33%	-0.12%	-0.27%
合计	金额	1,808.16	6,042.06	5,454.94	4,888.02
	占营业收入比例	23.09%	18.54%	21.89%	21.57%

1、销售费用分析

（1）销售费用变动分析

报告期内，公司销售费用主要由销售人员薪酬、运输费和市场推广费构成。报告期内各期，公司销售费用分别为 2,257.87 万元、2,432.29 万元、2,539.80 万元和 645.47 万元，占当期营业收入的比例分别为 9.96%、9.76%、7.79%和 8.24%，2014 年公司销售费用占比较低，主要由于当年收入大幅增加所致。

销售费用构成

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
职工薪酬	426.76	1,619.18	1,593.38	1,505.66
运输费	64.70	302.48	234.60	227.44
市场推广费	75.03	347.47	318.49	266.34
租赁费	29.70	94.80	100.08	89.96
其他	49.28	175.87	185.75	168.47
合计	645.47	2,539.80	2,432.29	2,257.87

销售费用 2013 年较 2012 年增加 174.42 万元，增幅 7.72%；2014 年较 2013 年增加 107.51 万元，增幅 4.42%。销售费用增加的主要原因为①销售人员工资水平有所增加；②为进一步提升公司的品牌影响力，推广费有所增加；③产品运输费随着销售收入的增长而增长。

（2）同行业公司比较情况

公司销售费用率与可比公司对比情况

公司名	销售费用率			
	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
可比上市公司				
北京君正	2.39%	3.73%	2.00%	3.56%
福星晓程	9.55%	5.71%	3.90%	3.76%
欧比特	5.65%	5.50%	5.25%	7.80%
国民技术	11.75%	13.37%	11.13%	7.87%
可比上市公司平均值	7.34%	7.08%	5.57%	5.75%
本公司	8.24%	7.79%	9.76%	9.96%

报告期内，公司销售费用率分别为 9.96%、9.76%、7.79%和 8.24%，公司销售费用率略高于同行业可比公司平均值，主要是公司与上述公司的产品及发展阶段不同所致。

2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用主要由管理人员薪酬、研发费用构成。报告期内各期，公司管理费用分别为 2,690.84 万元、3,052.39 万元、3,936.80 万元和 1,220.20 万元，占当期营业收入的比例分别为 11.87%、12.25%、12.08%和 15.58%。

管理费用构成

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
研发费用	879.31	2,796.80	1,948.46	1,664.09
职工薪酬	191.45	706.90	723.57	626.99
专业服务费	83.28	144.23	159.84	126.36
房租水电物业	29.12	103.63	85.06	78.76
差旅及交通费	14.62	84.30	56.47	65.01
其他	22.43	100.95	79.00	129.63
合计	1,220.20	3,936.80	3,052.39	2,690.84

2013 年公司管理费用较 2012 年增加 361.55 万元，增幅 13.44%；2014 年较 2013 年增加 884.41 万元，增幅 28.97%。管理费用增加的主要原因为公司加大研发投入，研发费用逐年增加。2013 年公司研发费用较 2012 年增加 284.37 万元，增加 17.09%；2014 年较 2013 年增加 848.34 万元，增加 43.54%。

3、财务费用分析

报告期内，公司财务费用主要由利息收入和汇兑损益构成，具体情况如下：

财务费用构成

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
利息支出	1.80	-	-	-
利息收入	42.15	418.16	193.53	95.32
汇兑净损益	-19.10	-25.85	154.80	26.43
其他	1.96	9.48	8.98	8.20

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
合计	-57.50	-434.54	-29.75	-60.69

公司财务费用 2013 年较 2012 年增加 30.94 万元，2014 年较 2013 年减少 404.79 万元；主要为公司定期存款增加，利息收入增长，同时受汇率变动的影响，公司的汇兑净损益随之产生波动。

（五）利润表其他项目分析

1、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失主要为计提的坏账准备以及对部分存货计提的存货跌价准备。公司资产减值损失的具体情况如下：

公司资产减值损失情况

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
坏账损失	-13.06	-4.71	14.08	-78.82
存货跌价损失	162.08	434.15	496.66	531.19
合计	149.01	429.43	510.74	452.37

2、营业外收支

报告期内，营业外收入主要为公司取得的各项政府补助，未发生营业外支出，公司营业外收支的具体情况如下：

公司营业外收支情况

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
营业外收入	-	378.69	220.49	49.15
其中：政府补助	-	346.14	220.49	49.15
其他	-	32.55	-	-
营业外支出	-	-	-	-
营业外收支净额	-	378.69	220.49	49.15

报告期内各期，公司取得各项政府补助计入营业外收入的总额分别为 49.15 万元、220.49 万元、378.69 万元和 0 万元，分别占当年销售收入的 0.22%、0.88%、1.16%和 0%，占比很小。

（六）公司的盈利来源分析与盈利的持续性

1、营业利润是公司盈利的主要来源

报告期内，公司盈利主要来源于主营业务——信号链产品及电源管理产品所产生的营业利润。

营业利润占利润总额比例情况

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年	2013年	2012年
营业利润	1,192.98	6,520.89	5,150.12	4,884.33
利润总额	1,192.98	6,899.58	5,370.62	4,933.48
营业利润/利润总额	100.00%	94.51%	95.89%	99.00%

2、盈利质量分析

报告期内，公司净利润主要来自于主营业务，对政府补贴等非经常性损益的依赖很小，盈利质量较高。公司扣除非经常性损益后净利润与净利润的比较情况如下：

扣除非经常性损益后净利润与净利润比例情况

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年	2013年	2012年
扣除非经常性损益后的净利润	982.48	5,905.00	4,619.40	4,652.74
净利润	982.48	6,231.77	4,806.82	4,698.20
扣除非经常性损益后的净利润/净利润	100.00%	94.76%	96.10%	99.03%

3、影响持续盈利能力的主要因素

对公司持续盈利能力产生影响的主要因素包括但不限于：公司保持持续创新的能力、供应商和客户目前较为集中、原材料及封测加工价格波动、市场竞争存在加剧可能性、税收优惠政策变化、汇率波动、募集资金投资项目管理和实施情况、外贸政策或环境发生变化等。同时公司在“第四节 风险因素”中对主要风险因素进行了分析和披露。

经核查，发行人的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大不利变化；发行人的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大不利变化；发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大不利变化；发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性

的客户不存在重大依赖；发行人最近一年的净利润不存在主要来自合并财务报表范围以外的投资收益的情况。保荐机构认为：发行人具备持续盈利能力。

（七）缴纳税项

1、企业所得税

报告期各期，公司企业所得税费用分别为 235.28 万元、563.79 万元、667.82 万元和 210.50 万元，占利润总额的比例分别为 4.77%、10.50%、9.68%和 17.65%，具体情况如下：

企业所得税费用情况

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
当期所得税费用	351.81	630.85	684.67	426.48
递延所得税费用	-141.30	36.97	-120.88	-191.20
所得税费用合计	210.50	667.82	563.79	235.28
所得税费用/利润总额	17.65%	9.68%	10.50%	4.77%

报告期内，公司企业所得税与利润总额的具体关系如下：

企业所得税费用与利润总额的关系

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
利润总额	1,192.98	6,899.58	5,370.62	4,933.48
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*适用税率）	298.24	1,034.94	805.59	370.01
适用税率	25%	15%	15%	7.5%
某些子公司适用不同税率的影响	-185.22	-243.51	-148.79	50.24
对以前期间当期所得税的调整	-	-	-0.52	-
不可抵扣的成本、费用和损失	3.27	21.25	15.68	5.56
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-	-	-119.92
可抵扣差异项目计提当期所得税费用和递延所得税资产税率不同的影响	94.21	-	-	-35.64
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-	-144.86	-112.21	-39.23
其他	-	-	4.04	4.26
所得税费用	210.50	667.82	563.79	235.28

2012 年-2014 年公司为企业所得税，在该期间公司执行 15%的企业所得税

优惠税率。2015 年 5 月公司高新技术企业证书到期，高新技术企业资质正在审核过程中。

如果按法定企业所得税税率 25%计算，公司 2012 年-2014 年享有的企业所得税税收优惠金额分别为 909.17 万元、376.20 万元和 445.22 万元，占当期利润总额的比例分别为 18.43%、7.00%和 6.45%。报告期内公司所得税税收优惠占利润总额的比例逐年下降，其经营成果对所得税优惠政策不存在重大依赖。

2、营业税金及附加

报告期内各期，公司营业税金及附加占利润总额的比例分别为 2.67%、2.66%、2.40%和 4.10%，具体情况如下：

营业税金及附加情况

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
城市维护建设税	28.56	96.24	83.39	76.76
教育费附加	12.24	41.25	35.74	32.90
地方教育附加	8.16	27.50	23.83	21.93
营业税金及附加合计	48.95	164.98	142.95	131.58
营业税金及附加占利润总额的比例	4.10%	2.40%	2.66%	2.67%

3、增值税

报告期内，公司增值税的缴纳情况如下：

公司增值税缴纳情况

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
期初未交数	-	-	10.41	-82.35
本期应缴数	26.30	82.78	63.57	128.38
本期缴纳数	26.30	82.78	73.98	35.63
期末未交数	-	-	-	10.41

八、财务状况分析

（一）资产分析

1、资产构成分析

报告期内，公司资产总体结构如下：

公司资产总体构成

单位：万元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	26,431.18	93.38%	25,894.37	93.31%	20,571.06	92.92%	19,436.20	93.76%
非流动资产	1,874.18	6.62%	1,857.12	6.69%	1,567.25	7.08%	1,293.13	6.24%
资产总计	28,305.36	100.00%	27,751.49	100.00%	22,138.31	100.00%	20,729.33	100.00%

报告期内各期末，公司资产总额分别为 20,729.33 万元、22,138.31 万元、27,751.49 万元和 28,305.36 万元，其中，流动资产占资产总额的比例分别为 93.76%、92.92%、93.31%和 93.38%，公司资产流动性较强。

2、流动资产分析

公司流动资产包括货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货和其他流动资产，具体构成情况如下：

公司流动资产构成

单位：万元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	18,181.61	68.79%	17,803.36	68.75%	14,237.04	69.21%	12,722.62	65.46%
应收账款	1,004.40	3.80%	1,648.61	6.37%	2,257.33	10.97%	1,621.77	8.34%
预付账款	199.77	0.76%	10.96	0.04%	15.43	0.07%	11.62	0.06%
其他应收款	38.36	0.15%	38.70	0.15%	161.54	0.79%	607.46	3.13%
存货	6,560.50	24.82%	5,751.64	22.21%	3,719.02	18.08%	4,246.21	21.85%
其他流动资产	446.54	1.69%	641.11	2.48%	180.70	0.88%	226.51	1.17%
合计	26,431.18	100.00%	25,894.38	100.00%	20,571.06	100.00%	19,436.19	100.00%

（1）货币资金

报告期内，公司货币资金构成及变动情况如下：

公司货币资金构成

单位：万元

项目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金	5.10	0.03%	4.13	0.02%	2.22	0.02%	3.84	0.03%
银行存款	18,176.51	99.97%	17,799.23	99.98%	14,234.81	99.98%	12,718.78	99.97%
合计	18,181.61	100.00%	17,803.36	100.00%	14,237.04	100.00%	12,722.62	100.00%

报告期内各期末，公司货币资金分别为 12,722.62 万元、14,237.04 万元、17,803.36 万元和 18,181.61 万元，占流动资产的比例分别为 65.46%、69.21%、68.75%和 68.79%。其中，2013 年和 2014 年分别较上期末变动 1,514.42 万元和 3,566.32 万元，变动比例分别为 11.90%和 25.05%。公司货币资金增幅较大，主要由于公司业务发展态势良好，货币资金逐渐累积所致。

(2) 应收账款

公司应收账款情况

单位：万元

应收账款	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
账面原值	1,014.55	1,665.26	2,280.14	1,638.15
坏账准备	10.15	16.65	22.80	16.38
账面价值	1,004.40	1,648.61	2,257.34	1,621.77
账面价值/流动资产	3.80%	6.37%	10.97%	8.34%
账面价值/营业收入	12.83%	5.06%	9.06%	7.16%

报告期内各期末，公司应收账款分别为 1,621.77 万元、2,257.34 万元、1,648.61 万元和 1,004.40 万元，占流动资产的比例分别为 8.34%、10.97%、6.37%和 3.80%。

① 应收账款变动分析

2013 年末，公司应收账款为 2,257.34 万元，较 2012 年末增加 635.57 万元，增幅为 39.19%，2014 年末，公司应收账款为 1,648.61 万元，较 2013 年末减少 608.73 万元，降幅为 26.97%。公司对客户的选择及信用管理严格，应收账款回款及时，周转较快。报告期各期末，应收账款总体呈下降趋势，其中 2013 年末应收账款上升的主要原因为由于春节等因素 2013 年末账期内的收入较多，相应期末应收账款增加。

② 应收账款坏账准备计提情况

公司对单项金额重大（期末余额 200 万元（含 200 万元）以上）的应收账款和单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的应收账款单独进行减值测试，并计提坏账；对单项测试未减值的应收账款，按照账龄组合计提坏账准备。2015 年 3 月 31 日，公司计提坏账准备的情况如下：

公司按账龄组合计提的坏账准备情况

单位：万元

账龄	余额	占比	计提比例	坏账准备
1 年以内	1,014.55	100.00%	1.00%	10.15
合计	1,014.55	100.00%	1.00%	10.15

③应收账款主要客户情况

2015 年 3 月 31 日公司应收账款主要客户情况

单位：万元

单位名称	金额	账龄	占应收账款余额的比例
棋港	209.90	1 年以内	20.69%
威健	190.45	1 年以内	18.77%
丰宝	114.54	1 年以内	11.29%
中兴康讯	99.66	1 年以内	9.82%
茂晶	83.68	1 年以内	8.25%
合计	698.23	1 年以内	68.82%

2014 年末公司应收账款主要客户情况

单位：万元

单位名称	金额	占应收账款余额的比例
北高智	382.87	22.99%
赛博联	244.98	14.71%
棋港	221.30	13.29%
丰宝	174.74	10.49%
中兴康讯	156.33	9.39%
合计	1,180.22	70.87%

2013 年末公司应收账款主要客户情况

单位：万元

单位名称	金额	占应收账款余额的比例
北高智	389.44	17.08%
新得利	371.07	16.27%

单位名称	金额	占应收账款余额的比例
赛博联	293.90	12.89%
威健	228.41	10.02%
丰宝	198.94	8.73%
合计	1,481.76	64.99%

2012 年末公司应收账款主要客户情况

单位：万元

单位名称	金额	占应收账款余额的比例
丰宝	379.00	23.14%
北高智	256.18	15.64%
茂晶	187.95	11.47%
中兴康讯	169.48	10.35%
品佳	117.52	7.17%
合计	1,110.13	67.77%

(3) 预付账款

报告期内各期末，公司预付账款分别为 11.62 万元、15.43 万元、10.96 万元和 199.77 万元，占流动资产的比例分别为 0.06%、0.07%、0.04%和 0.76%，预付账款的金额总体较小。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司预付账款主要单位情况如下：

公司预付账款主要单位

单位：万元

单位名称	金额	占预付款项总额的比例	账龄	主要内容
北京华峰测控技术有限公司	86.48	43.29%	1 年以内	设备款
讯程国际贸易（上海）有限公司	37.50	18.77%	1 年以内	设备款
深圳市易商仪器有限公司	30.27	15.15%	1 年以内	设备款
绍兴宏邦电子科技有限公司	14.89	7.45%	1 年以内	设备款
昆山庆声电子科技有限公司	14.60	7.31%	1 年以内	设备款
小计	183.74	91.98%	-	-

(4) 其他应收款

报告期内各期末，公司其他应收款分别为 607.46 万元、161.54 万元、38.70 万元和 38.36 万元，占流动资产的比例分别为 3.13%、0.79%、0.15%和 0.15%。

2012 年、2013 年其他应收款金额较大的原因系公司应收北京市海淀区国税局出口退税款 409.09 万元和 135.90 万元。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司其他应收款主要单位情况如下：

公司其他应收款主要单位

单位：万元

单位名称	余额	占其他应收款 余额的比例	账龄	主要内容
刘*	13.71	24.99%	1 年以内	房租押金
深圳九州电器有限公司	8.91	16.24%	2-3 年	房租押金
北京中经大厦物业管理有限公司	6.34	11.56%	3 年以上	房租押金
上海华太物业管理有限公司	3.68	6.71%	1 年以内	物业费押金
哈尔滨电业局道里供电局	2.00	3.65%	2-3 年	押金
小计	34.64	63.15%	-	-

(5) 存货

公司存货金额及占比情况

单位：万元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
存货	6,560.50	5,751.64	3,719.02	4,246.21
占流动资产比例	24.82%	22.21%	18.08%	21.85%
占资产总额比例	23.18%	20.73%	16.80%	20.48%

报告期内各期末，公司存货的账面价值分别为 4,246.21 万元、3,719.02 万元、5,751.64 万元和 6,560.50 万元，占流动资产的比例分别为 21.85%、18.08%、22.21% 和 24.82%，公司存货形成的来源为：1）公司根据销售需求提前备货；2）封装厂尚未加工完毕而产生的在产品；3）公司对晶圆等主要原材料保有了一定的库存量。报告期内公司存货的具体构成情况如下：

公司存货构成情况

单位：万元

项目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	1,890.29	28.81%	1,670.57	29.05%	1,101.32	29.61%	1,734.26	40.84%
在产品	1,405.86	21.43%	1,166.24	20.27%	924.66	24.86%	220.12	5.19%
库存商品	3,264.35	49.76%	2,914.83	50.68%	1,693.04	45.52%	2,291.83	53.97%
合计	6,560.50	100.00%	5,751.64	100.00%	3,719.02	100.00%	4,246.21	100.00%

①报告期内公司各期存货变动的具体情况如下：

公司存货 2013 年末较 2012 年末减少 527.19 万元，降幅为 12.42%，主要为库存商品的减少，下降的主要原因为 2013 年末公司发货较多，相应存货减少。

公司存货 2014 年末较 2013 年末增加 2,032.62 万元，增幅为 54.65%，主要为公司 2014 年销售收入较 2013 年增长较快，增幅达 30.80%，公司根据对下一阶段市场需求预测，其中电源管理类产品需求会大幅增加，因此相应增加了库存商品的备货所致。

②报告期内，公司存货跌价准备的计提情况如下：

公司存货跌价准备计提情况

单位：万元

存货跌价准备	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
期初余额	950.34	856.47	856.38	688.58
本期计提金额	162.08	433.37	496.66	529.79
本期转销金额	83.16	339.50	496.57	361.99
期末余额	1,029.26	950.34	856.47	856.38

报告期内，公司按照存货可变现净值与账面价值的差异计提存货跌价准备。根据集成电路市场更新换代较快的行业特点，公司一直以来保持较为谨慎的存货跌价准备计提政策。在计提存货跌价准备时，综合考虑了预计售价、既往销量、库存数量等因素，对于可能发生减值的存货足额计提了存货跌价准备。存货跌价准备计提情况如下：

公司存货跌价准备计提情况

单位：万元

项目	2015 年 1 月 1 日	本年计提	本年减少		2015 年 3 月 31 日
			转回	转销	
原材料	188.24	0.33		4.77	183.80
库存商品	762.10	161.75		78.39	845.46
合计	950.34	162.08		83.16	1,029.26
项目	2014 年 1 月 1 日	本年计提	本年减少		2014 年 12 月 31 日
			转回	转销	
原材料	214.94	28.20		54.90	188.24
库存商品	641.53	405.17		284.60	762.10
合计	856.47	433.37		339.50	950.34

项目	2013 年 1 月 1 日	本年计提	本年减少		2013 年 12 月 31 日
			转回	转销	
原材料	131.65	121.61		38.32	214.94
库存商品	724.73	375.05		458.25	641.53
合计	856.38	496.66		496.57	856.47
项目	2012 年 1 月 1 日	本年计提	本年减少		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
原材料	83.87	98.04		50.26	131.65
库存商品	604.71	431.75		311.73	724.73
合计	688.58	529.79		361.99	856.38

（6）其他流动资产

报告期内各期末，公司其他流动资产分别为 226.51 元、180.70 万元、641.11 万元和 446.54 万元，占流动资产的比例分别为 1.17%、0.88%、2.48%和 1.69%。报告期内其他流动资产波动较大的原因系公司待抵扣进项税变动所致。

公司其他流动资产构成情况

单位：万元

项目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
待抵扣进项税	358.98	80.39%	566.10	88.30%	134.02	74.17%	162.27	71.64%
房租	52.45	11.75%	40.00	6.24%	20.12	11.13%	21.58	9.53%
网络服务费	12.66	2.83%	9.34	1.46%	7.40	4.10%	9.34	4.12%
待摊费用	22.45	5.03%	25.67	4.00%	19.16	10.60%	33.32	14.71%
合计	446.54	100.00%	641.11	100.00%	180.70	100.00%	226.51	100.00%

3、非流动资产分析

公司非流动资产主要为固定资产、无形资产、长期待摊费用和递延所得税资产构成，具体情况如下：

公司非流动资产构成

单位：万元

项目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	431.12	23.00%	450.75	24.27%	338.00	21.57%	319.35	24.70%
无形资产	180.47	9.63%	207.43	11.17%	265.70	16.95%	177.18	13.70%

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期待摊费用	699.31	37.31%	772.82	41.61%	531.55	33.92%	485.48	37.54%
递延所得税资产	563.27	30.05%	426.12	22.95%	432.00	27.56%	311.12	24.06%
合计	1,874.18	100.00%	1,857.12	100.00%	1,567.25	100.00%	1,293.13	100.00%

（1）固定资产

公司主要从事模拟芯片的设计和銷售，属于轻资产类型的公司，报告期内，公司固定资产主要是电子设备，固定资产主要构成情况如下：

单位：万元

固定资产类别	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
运输工具	29.81	6.91%	32.41	7.19%	3.15	0.93%	4.73	1.48%
办公家具	12.91	2.99%	10.42	2.31%	12.55	3.71%	17.18	5.38%
电子设备及其他	388.40	90.09%	407.92	90.50%	322.30	95.36%	297.44	93.14%
合计	431.12	100.00%	450.75	100.00%	338.00	100.00%	319.35	100.00%

公司固定资产目前使用状况良好，不存在非正常的闲置或未使用现象，未发现减值迹象。

（2）无形资产

公司无形资产主要是软件。报告期内，公司无形资产未发现减值迹象，未计提减值准备。

公司无形资产情况

单位：万元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
1) 账面原值小计	622.27	622.27	585.47	406.75
软件	622.27	622.27	585.47	406.75
2) 累计摊销小计	441.80	414.84	319.77	229.57
软件	441.80	414.84	319.77	229.57
3) 账面净值小计	180.47	207.43	265.70	177.18
软件	180.47	207.43	265.70	177.18

（3）长期待摊费用

公司长期待摊费用情况

单位：万元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
模具	678.37	97.01%	748.96	96.91%	513.22	96.55%	480.90	99.06%
装修	12.88	1.84%	14.97	1.94%	18.32	3.45%	4.59	0.94%
其他	8.06	1.15%	8.89	1.15%	-	-	-	-
合计	699.31	100.00%	772.82	100.00%	531.55	100.00%	485.48	100.00%

(4) 递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产及递延所得税负债主要由资产减值准备、递延收益、未支付的工资薪金支出、预提及暂估费用等引起的可抵扣暂时性差异，具体情况如下：

公司递延所得税资产、递延所得税负债形成情况

单位：万元

引起暂时性差异资产/负债项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
引起暂时性差异的资产项目								
资产减值准备	71.00	12.61%	68.51	16.68%	55.07	12.75%	51.58	16.58%
递延收益	155.25	27.56%	83.85	19.68%	40.95	9.48%	-	-
未支付的工资薪金支出	78.31	13.90%	46.73	10.97%	142.79	33.05%	124.29	39.95%
购入摊销年限小于税法规定的资产	14.99	2.66%	14.27	3.35%	15.03	3.48%	19.55	6.28%
预计负债	34.70	6.16%	31.15	7.31%	18.52	4.29%	9.78	3.14%
预提及暂估费用	209.01	37.11%	181.61	42.62%	159.64	36.95%	105.93	34.05%
合计	563.27	100.00%	426.12	100.00%	432.00	100.00%	311.12	100.00%
引起暂时性差异的负债项目								
固定资产累计折旧差异	26.94	100.00%	31.09	100.00%	-	-	-	-

上述递延所得税资产是由于税法与会计在确认收益、费用或损失的时间不同而产生的会计利润与应税所得之间的时间性差异所产生的。

（二）负债分析

1、负债构成分析

报告期内，公司负债的总体结构如下：

公司负债结构

单位：万元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	6,456.40	81.36%	7,357.57	87.70%	4,803.71	88.67%	4,309.83	92.51%
非流动负债	1,479.60	18.64%	1,031.78	12.30%	613.75	11.33%	349.08	7.49%
负债总计	7,936.00	100.00%	8,389.35	100.00%	5,417.46	100.00%	4,658.91	100.00%

报告期内各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 92.51%、88.67%、87.70%和 81.36%，流动负债为公司负债的主要构成部分。

2、流动负债分析

报告期内，公司流动负债的具体构成如下：

公司流动负债构成

单位：万元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	100.00	1.55%	100.00	1.36%	-	-	-	-
应付账款	4,721.31	73.13%	5,489.65	74.61%	3,132.58	65.21%	2,804.46	65.07%
预收款项	117.58	1.82%	44.99	0.61%	1.46	0.03%	10.36	0.24%
应付职工薪酬	783.45	12.13%	1,210.59	16.45%	1,077.88	22.44%	939.71	21.80%
应交税费	387.96	6.01%	274.59	3.73%	446.39	9.29%	304.93	7.08%
其他应付款	346.10	5.36%	237.75	3.23%	145.39	3.03%	250.38	5.81%
合计	6,456.40	100.00%	7,357.57	100.00%	4,803.71	100.00%	4,309.84	100.00%

（1）短期借款

报告期内各期末，公司短期借款余额分别为 0 万元、0 万元、100.00 万元和 100.00 万元，占流动负债的比例分别为 0.00%、0.00%、1.36%和 1.55%。该借款

系公司 2014 年向华夏银行股份有限公司北京中关村支行取得的短期借款所致，借款期限为 1 年。

（2）应付账款

公司应付账款情况

单位：万元

项目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付原材料采购款项	1,268.55	26.87%	1,480.06	26.96%	507.62	16.20%	616.13	21.97%
应付封装加工费款项	3,452.76	73.13%	4,009.59	73.04%	2,624.95	83.80%	2,188.33	78.03%
合计	4,721.31	100.00%	5,489.65	100.00%	3,132.58	100.00%	2,804.46	100.00%

公司应付账款主要为原材料采购和封装加工形成的应付款项。报告期内各期末，公司应付账款分别为 2,804.46 万元、3,132.58 万元、5,489.65 万元和 4,721.31 万元。2013 年公司应付账款较上年末增加 328.12 万元，增幅为 11.70%；2014 年公司应付账款较上年末上升 2,357.07 万元，增幅为 75.24%；增加的主要原因系公司销售增加，相应的原材料及产品加工增加所致。

（3）预收账款

报告期内各期末，公司预收账款分别为 10.36 万元、1.46 万元、44.99 万元和 117.58 万元，占流动负债的比例分别为 0.24%、0.03%、0.61%和 1.82%，金额及占比均较小。

（4）应付职工薪酬

报告期内各期末，公司应付职工薪酬分别为 939.71 万元、1,077.88 万元、1,210.59 万元和 783.45 万元，占流动负债的比例分别为 21.80%、22.44%、16.45%和 12.13%。应付职工薪酬逐年上升的原因主要系公司调整员工工资所致。

（5）应交税费

报告期内各期末，公司应交税费分别为 304.93 万元、446.39 万元、274.59 万元和 387.96 万元，占流动负债的比例分别为 7.08%、9.29%、3.73%和 6.01%具体情况如下：

公司应交税费构成

单位：万元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
增值税							10.41	3.41%
企业所得税	362.80	93.51%	239.77	87.32%	367.59	82.35%	258.25	84.69%
城市维护建设税	0.29	0.07%	8.03	2.92%	33.90	7.59%	9.85	3.23%
其他税费	24.87	6.41%	26.80	9.76%	44.90	10.06%	26.41	8.67%
合计	387.96	100.00%	274.59	100.00%	446.39	100.00%	304.93	100.00%

(6) 其他应付款

报告期内各期末，公司其他应付款余额分别为 250.38 万元、145.39 万元、237.75 万元和 346.10 万元，占流动负债的比例分别为 5.81%、3.03%、3.23%和 5.36%。报告期内，公司其他应付款主要为预提的服务费，应付运费等。

3、非流动负债分析

(1) 预计负债

预计负债核算内容为计提的退换货准备。公司每月根据销售情况按照固定比例计提退货准备，报告期内计提和使用情况如下：

公司预计负债计提情况

单位：万元

预计负债	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
期初余额	441.69	340.75	226.08	187.88
本期计提金额	126.40	483.52	276.29	252.67
本期使用金额	150.43	382.58	161.62	214.47
期末余额	417.65	441.69	340.75	226.08

(2) 递延收益

报告期内各期，公司递延收益，余额分别为 123.00 万元、273.00 万元、559.00 万元和 1,035.00 万元，主要由政府补助项目产生，具体情况如下：

公司递延收益详细情况

单位：万元

类别	2015年 3月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
国家创新基金		-	63.00	63.00

类别	2015年 3月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
文化创意产业专项资金		-	60.00	60.00
面向智能终端收发模块的高效高频电源转换芯片研制	150.00	150.00	150.00	-
科技北京百名领军人才培养工程	60.00	60.00	-	-
高压高精度运算放大器芯片系列研发	180.00	180.00	-	-
多功能低功耗微处理器电源监控芯片系列研发及产业化	95.00	95.00	-	-
用于智能可穿戴设备的低功耗电源管理芯片的应用示范	50.00	74.00	-	-
面向移动智能终端的新一代电池及电源管理芯片研发项目	500.00			
合计	1,035.00	559.00	273.00	123.00

（三）偿债能力分析

报告期内，公司资产负债率、流动比率、速动比率、息税折旧摊销前净利润、利息保障倍数等主要偿债能力指标如下：

公司主要偿债能力指标

指标	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
资产负债率（合并）	28.04%	30.23%	24.47%	22.47%
流动比率	4.09	3.52	4.28	4.51
速动比率	3.08	2.74	3.51	3.52
息税折旧摊销前利润（万元）	1,262.26	7,140.89	5,565.05	5,132.53
利息保障倍数	663.85	-	-	-

注：2014 年，公司短期借款为 100 万元，但无利息保障倍数原因主要系短期借款为 2014 年 12 月 22 日取得，未确认利息支出。

1、资产负债率（合并）

报告期内各期末，公司资产负债率分别为 22.47%、24.47%、30.23%和 28.04%，资产负债率总体水平不高。公司资产负债率指标与同行业上市公司对比情况如下：

公司资产负债率与可比公司对比情况

公司名称	资产负债率			
	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
可比上市公司				

公司名称	资产负债率			
	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
北京君正	0.87%	1.40%	1.11%	2.50%
福星晓程	6.39%	7.84%	6.94%	5.08%
欧比特	7.28%	11.45%	6.28%	2.42%
国民技术	5.00%	5.30%	4.65%	5.58%
可比上市公司平均值	4.88%	6.50%	4.75%	3.89%
本公司	28.04%	30.23%	24.47%	22.47%

报告期内，公司资产负债率大幅高于可比公司平均值，主要因为该指标是表征资产和负债相对规模的指数，而公司所处行业为轻资产行业，有长期负债较小、资产负债率相对较低等特点，可比公司进行上市融资后，大规模股权融资促使其业务近年来不断发展，资产逐渐积累，而负债增长较少甚至负增长，使得其资产负债结构大幅优化。

2、流动比率与速动比率

报告期内各期末，公司流动比率分别为 4.51、4.28、3.52 和 4.09，速动比率分别为 3.52、3.51、2.74 和 3.08，公司短期偿债能力良好，公司流动比率和速动比率均低于同行业上市公司，对比情况如下：

公司流动比率和速动比率与可比公司对比情况

公司名称	流动比率				速动比率			
	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
可比上市公司								
北京君正	136.57	76.46	144.00	78.50	128.78	72.08	135.60	74.69
福星晓程	9.13	7.23	9.75	16.30	6.72	5.12	7.80	12.98
欧比特	8.92	5.33	11.95	34.50	6.86	4.15	9.59	29.99
国民技术	20.93	19.30	23.51	17.30	19.70	18.15	22.34	16.37
可比上市公司平均值	43.89	27.08	47.30	36.65	40.52	24.88	43.83	33.51
本公司	4.09	3.52	4.28	4.51	3.08	2.74	3.51	3.52

报告期内，与可比公司相比，公司流动比率和速动比率较低，原因与上述资产负债率分析相似。对比可比公司上市前一年的流动比率和速动比率表明，公司流动比率与速动比率高于同行业，具体情况如下：

可比公司上市前一年的流动比率和速动比率情况

公司名称	流动比率	速动比率
北京君正	2.41	1.93
福星晓程	2.48	2.15
欧比特	2.95	2.54
国民技术	2.69	1.96
平均比率	2.63	2.14

(四) 资产周转能力分析

报告期内，公司的应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率等资产周转能力指标具体情况如下：

公司主要资产周转能力指标

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
应收账款周转率	5.84	16.52	12.72	10.93
存货周转率	0.75	4.10	3.43	3.23
总资产周转率	0.28	1.31	1.16	1.09

1、应收账款周转率

报告期内各期，公司应收账款周转率分别为 10.93、12.72、16.52 和 5.84，公司应收账款周转率与同行业可比上市公司对比情况如下：

公司应收账款周转率与可比公司对比情况

公司名称	应收账款周转率			
	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
可比上市公司				
北京君正	3.62	6.75	6.32	4.39
福星晓程	0.41	1.70	2.14	1.92
欧比特	0.38	1.47	1.40	1.58
国民技术	0.51	2.16	2.51	2.33
可比上市公司平均值	1.23	3.02	3.09	2.56
本公司	5.84	16.52	12.72	10.93

报告期内，公司应收账款周转率高于可比公司，主要因为公司对客户的选择及信用管理严格，应收账款回款较为及时。

2、存货周转率

报告期内各期，公司存货周转率分别为 3.23、3.43、4.10 和 0.75，公司存货周转率与同行业可比上市公司对比情况如下：

公司存货周转率与可比公司对比情况

公司名	存货周转率			
	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
可比上市公司				
北京君正	0.11	0.49	0.93	1.29
福星晓程	0.12	0.67	0.73	0.84
欧比特	0.31	1.18	1.23	2.16
国民技术	0.51	1.84	2.01	1.89
可比上市公司平均值	0.26	1.05	1.23	1.55
本公司	0.75	4.10	3.43	3.23

报告期内，公司存货周转率高于可比公司，主要因为公司逐渐完善存货管理体系，同时业务规模不断增加所致。

3、总资产周转率

报告期内各期，公司总资产周转率分别为 1.09、1.16、1.31 和 0.28，公司总资产周转率与同行业可比公司对比情况如下：

公司总资产周转率与可比公司对比情况

公司名称	总资产周转率			
	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
可比上市公司				
北京君正	0.01	0.05	0.09	0.10
福星晓程	0.05	0.19	0.23	0.24
欧比特	0.06	0.25	0.23	0.26
国民技术	0.04	0.15	0.15	0.15
可比上市公司平均值	0.04	0.16	0.17	0.18
本公司	0.28	1.31	1.16	1.09

报告期内，公司总资产周转率高于可比公司，主要为可比公司进行上市融资后总资产规模大幅增加，增速大于收入增速所致。可比公司上市前一年的总资产周转率分别为 1.28、0.85、0.84 和 1.86，平均总资产周转率为 1.21，公司总资产

周转率处于行业中等水平。

（五）所有者权益变动情况

报告期内，公司所有者权益持续增长，主要是因为利润增长所致，公司所有者权益变动具体情况如下：

公司所有者权益变动情况

股东权益	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
资本公积	2,549.68	2,549.68	2,549.68	2,549.68
其他综合收益	-291.68	-316.43	-325.95	-169.56
盈余公积	1,489.80	1,489.80	1,028.96	647.47
未分配利润	12,121.56	11,139.09	8,968.16	8,542.83
归属于母公司股东权益	20,369.36	19,362.14	16,720.85	16,070.42
股东权益合计	20,369.36	19,362.14	16,720.85	16,070.42

1、股本及资本公积情况

报告期内，公司股本和资本公积未发生变动，其中，资本公积为公司整体变更为股份有限公司时未折股部分计入股本溢价。

2、盈余公积变动情况

报告期内，公司根据《公司章程》按发行人母公司税后净利润的 10%提取盈余公积，具体情况如下：

公司盈余公积变动情况

单位：万元

年度	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2012 年	241.58	473.95	68.06	647.47
2013 年	647.47	381.49	-	1,028.96
2014 年	1,028.96	460.84	-	1,489.80
2015 年 1-3 月	1,489.80	-	-	1,489.80

注：2012 年度盈余公积减少是本公司整体变更为股份有限公司时，以 2011 年 11 月 30 日经审计净资产为基础折股，相应减少法定盈余公积 68.06 万元。

3、未分配利润变动情况

报告期内，公司未分配利润具体变动情况如下：

公司未分配利润变动情况

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
期初未分配利润	11,139.09	8,968.16	8,542.83	6,281.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	982.48	6,231.77	4,806.82	4,698.20
减：提取法定盈余公积	-	460.84	381.49	473.95
应付普通股股利	-	3,600.00	4,000.00	1,350.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	612.52
期末未分配利润	12,121.56	11,139.09	8,968.16	8,542.83

九、现金流量分析

（一）现金流量具体情况

报告期内，公司现金流量具体情况如下：

公司现金流量情况

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	9,330.87	36,284.17	27,027.40	25,430.58
经营活动现金流出小计	9,469.67	28,838.02	20,816.63	20,195.65
经营活动产生的现金流量净额	-138.80	7,446.15	6,210.78	5,234.94
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计	20.14	684.90	596.79	753.16
投资活动产生的现金流量净额	-20.14	-684.90	-596.79	-753.16
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	500.00	379.00	143.20	-
筹资活动现金流出小计	1.80	3,600.00	4,000.00	1,388.62
筹资活动产生的现金流量净额	498.20	-3,221.00	-3,856.80	-1,388.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38.99	26.07	-242.77	-16.20
五、现金及现金等价物净增加额	378.25	3,566.32	1,514.42	3,076.95
加：期初现金及现金等价物余额	17,803.36	14,237.04	12,722.62	9,645.67
六、期末现金及现金等价物余额	18,181.61	17,803.36	14,237.04	12,722.62

1、经营活动产生的现金流量分析

公司经营活动产生的现金流量净额与净利润对比情况如下：

公司现金流量净额与净利润对比情况

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年	合计
经营活动产生的现金流量净额	-138.80	7,446.15	6,210.78	5,234.94	18,753.07
净利润	982.48	6,231.77	4,806.82	4,698.20	16,719.26
差异	-1,121.28	1,214.39	1,403.95	536.74	2,033.81
其中：资产减值准备	149.01	429.43	510.74	452.37	1,541.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41.11	146.23	104.32	115.31	406.97
无形资产摊销	26.96	95.07	90.19	83.75	295.98
长期待摊费用摊销	73.15	281.35	233.97	140.63	729.11
财务费用	-17.92	-25.85	154.80	16.20	127.24
递延所得税资产减少	-137.16	5.88	-120.88	-191.20	-443.35
递延所得税负债增加	-4.14	31.09	0.00	0.00	26.94
存货的减少	-961.56	-2,465.13	30.52	-1,412.48	-4,808.64
经营性应收项目的减少	658.47	285.24	-215.07	833.42	1,562.06
经营性应付项目的增加	-949.20	2,431.08	615.35	498.73	2,595.95

报告期内各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 5,234.94 万元、6,210.78 万元、7,446.15 万元和-138.80 万元，与同期净利润的差额分别为 536.74 万元、1,403.95 万元、1,214.39 万元和-1,121.28 万元。影响公司经营活动产生的现金流量与公司实现净利润之间差异的主要因素是存货项目、经营性应收项目和经营性应付项目，具体情况如下：

（1）存货项目的影响

报告期内各期，公司存货的变动金额分别为-1,412.48 万元、30.52 万元、-2,465.13 万元和-961.56 万元，对公司经营活动产生的现金流量的合计影响数为-4,808.64 万元。报告期末存货变动的具体情况参见本节“八、（一）、2、（5）存货”。

（2）经营性应收项目的影响

报告期内各期，公司经营性应收项目对经营活动产生的现金流量的影响合计

数为 1,562.06 万元，其中主要是应收账款项目的影响。

报告期内各期，公司应收账款变动额分别为-862.36 万元、635.56 万元、-608.72 万元和-644.20 万元。报告期内应收账款变动的具体情况参见本节“八、（一）、2、（2）应收账款”。

（3）经营性应付项目的影响

报告期内各期，公司经营性应付项目对经营活动产生的现金流量的影响合计数为 2,595.95 万元，主要系公司扩大采购规模导致应付账款规模增加，以及应交税费的相应增加所致。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

公司投资活动产生的现金流量

单位：万元

现金流量	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
收回投资收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20.14	684.90	596.79	753.16
投资支付的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	20.14	684.90	596.79	753.16
投资活动产生的现金流量净额	-20.14	-684.90	-596.79	-753.16

报告期内，公司为保持相对合理的资产结构、产品及研发竞争力，与公司业务规模的发展态势相适应，公司增加了在电子设备、模具等方面的投入。报告期内各期，公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为 753.16 万元、596.79 万元、684.90 万元和 20.14 万元。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

公司筹资活动产生的现金流量

单位：万元

现金流量	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2012 年
取得借款收到的现金	-	100.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	500.00	279.00	143.20	-
筹资活动现金流入小计	500.00	379.00	143.20	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.80	3,600.00	4,000.00	1,388.62
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	38.62
筹资活动现金流出小计	1.80	3,600.00	4,000.00	1,388.62
筹资活动产生的现金流量净额	498.20	-3,221.00	-3,856.80	-1,388.62

报告期内各期，筹资活动现金流入主要为增加的银行借款及政府补助，筹资活动现金流出为向股东支付红利。

（二）未来重大资本性支出计划

根据行业发展以及公司自身业务发展的需求，公司拟用本次募集资金投资建设电源管理类模拟芯片开发及产业化项目等三个项目，该等项目投资规模为 34,467.00 万元。项目具体情况参见本招股说明书“第十节 募集资金运用”的相关内容。

十、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司第二届董事会第二次会议于 2015 年 5 月 11 日审议通过关于公司 2014 年度利润分配方案的议案，对 2014 年度可供股东分配的净利润中的 4,000.00 万元进行现金分红。2015 年 5 月 26 日，公司 2015 年第一次临时股东大会作出决议，同意对 2014 年度可供股东分配的净利润中的 4,000.00 万元，按照公司股东于 2014 年末的股权比例进行分配。上述股利已经于 2015 年 6 月分配完毕。

（二）或有事项

截至 2015 年 3 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至2015年3月31日，公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

公司不可撤销的经营租赁合约情况

单位：万元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2015.3.31	2014.12.31
资产负债表日后第1年	375.47	308.50
资产负债表日后第2年	133.88	168.52
资产负债表日后第3年	36.56	53.22
合 计	545.91	530.23

十一、股利分配情况

（一）最近三年公司股利分配情况

2012年6月29日，公司2012年第一次临时股东大会做出决议，同意对2011年度可供股东分配的净利润中的1,350.00万元，按照公司股东于2011年末的股权比例进行分配。上述股利已经于2012年分配完毕。

2013年5月10日，公司2013年第一次临时股东大会做出决议，同意对2012年度可供股东分配的净利润中的4,000.00万元，按照公司股东于2012年末的股权比例进行分配。上述股利已经于2013年分配完毕。

2014年6月2日，公司2014年第一次临时股东大会做出决议，同意对2014年度可供股东分配的净利润中的3,600.00万元，按照公司股东于2013年末的股权比例进行分配。上述股利已经于2014年分配完毕。

（二）发行后股利分配政策

2015年6月25日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议并通过了公司上市之后生效的《公司章程（草案）》，对发行上市后的利润分配事项进行了明确规定。

“公司的利润分配，应遵守以下规定：

（一）公司利润分配政策的基本原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全

体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红方式，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司每年至少进行一次利润分配，每连续三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

（二）公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期分红。

（三）差异化的现金分红政策

1、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。

3、公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3000 万元；

（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于公司当年度实现的可分配利润的 20%；

（4）中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。

满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

（四）公司发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

（五）公司利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

（六）利润分配方案应履行的审议程序：公司利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。公司利润分配方案由董事会拟定后应由董事会充分论证审议通过后提交股东大会审议批准，股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（七）利润分配政策决策具体机制：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经 1/2 以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事 1/2 以上表决通过，并发

表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（八）公司因前述第（三）项规定的重大投资计划或重大现金支出的情形发生而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确认用途及预计投资收益等事项进行专项说明，在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（九）利润分配政策的调整：公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者公司外部经营环境发生重大变化，确需调整本章程规定的现金分红政策时，董事会需就调整或变更利润分配政策的可行性进行充分论证，形成专项决议后，提交公司股东大会批准，股东大会审议时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，独立董事应当对此发表独立意见，监事会亦应对此发表意见。公司提出调整利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对股东利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明调整的原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（十）公司利润分配方案的实施：公司董事会须在股东大会批准后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。

（十一）公司利润分配方案的披露：

1、公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。公司董事会未做出年度现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年

实现的可分配利润的 10%的，应当在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，监事会亦应对此发表意见。

2、公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。”

（三）发行前滚存利润的分配

公司于 2015 年 6 月 25 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》的议案：首次公开发行 A 股前公司合并报表范围内累积的滚存未分配利润由首次公开发行完成后的新老股东共同享有。

第十节 募集资金运用

一、本次募集资金投资项目计划

本次募投项目的实际资金需要量为 34,467 万元，若募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施；在本次募集资金到位前，公司可根据项目实际情况使用自筹资金先行投入，在募集资金到位后再对先前投入的自筹资金进行置换。

2015 年 6 月 25 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》和《关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司募集资金管理办法（2015 年修订）>的议案》。根据该等议案，本公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。募集资金拟投资项目投入计划及项目审批情况如下：

单位：万元

序号	资金使用的具体用途	预计募集资金数额	预计投资规模	备案文号
1	电源管理类模拟芯片开发及产业化项目	13,969	13,969	京海淀发改（备）[2015]104号
2	信号链类模拟芯片开发及产业化项目	14,399	14,399	京海淀发改（备）[2015]105号
3	研发中心建设	6,099	6,099	京海淀发改（备）[2015]103号
合计		34,467	34,467	-

上述募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务，是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。其中，电源管理类模拟芯片开发及产业化项目主要集中研究和开发电源管理类系列芯片，即根据当今模拟集成电路高精度、低功耗、小封装、高抗干扰能力等发展趋势及市场需求，强化公司在电源管理类模拟芯片的技术深度和技术积累程度，形成一批具有世界先进水平的电源管理类模拟集成电路产品并实现产业化；信号链类模拟芯片开发及产业化项目拟实施信号链类模拟芯片的开发及产业化，主要集中研究和开发信号链类系列芯片，强化公司在信号链类模

拟芯片的技术深度和技术积累程度；研发中心建设项目在公司现有技术研发中心基础上，扩大公司研发规模并进行技术升级，提高公司产品的研发效率、缩短产品研发、制造周期，提升公司核心竞争力。

根据项目规划，圣邦股份已租赁北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心第三座 13 层（1301-1307 室），总面积 1423.18 平方米，用于前述三个募集资金投资项目的建设，租赁期为 2015 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

二、募集资金投资项目简介

（一）电源管理类模拟芯片开发及产业化项目

1、项目背景

本项目拟实施电源管理类模拟芯片的开发及产业化，主要集中研究和开发电源管理类系列芯片。根据当今模拟集成电路高效率、低功耗、小封装、高抗干扰能力等发展趋势及市场需求，强化公司在电源管理类模拟芯片的技术深度和技术积累程度，在线性稳压器技术、开关型稳压器技术、锂电池充电管理技术、LED 背光驱动器技术、LED 闪光灯驱动器技术、MOSFET 驱动技术、马达驱动技术、高抗干扰能力、高静电防护能力、小型封装等方面取得技术突破，形成一批具有世界先进水平的电源管理类模拟集成电路产品并实现产业化。

2、项目的可行性

（1）技术可行

公司自成立以来，一直具有很强的研发能力。在本项目开发过程中，公司将严格遵循项目开发流程，加强对项目进程的管理和控制，同时增加相关技术人员数量，从技术上确保项目的顺利实施。

目前，公司在模拟集成电路技术和产品研发方面具有较好的基础，已经具备电源管理类模拟集成电路系列芯片产品的研发和技术储备，为高端模拟集成电路系列产品的开发打下了良好的技术基础。

因此，从技术上来看，本项目是可行的。

（2）财务可行

从资金来源上看，本项目所需资金全部由募股资金来解决，因而从资金来源上是有保证的。从市场前景来看，本项目产品属于高端模拟集成电路产品，市场前景广阔，有很强的抗风险能力，经济效益良好。从核心技术攻关来看，其核心技术研发能弥补高端集成电路技术长期被国外垄断的局面，能够为高端产品研发提供助力，有利于促进我国集成电路的发展。

因此，从财务上来看，本项目是可行的。

（3）管理可行

本项目将由专业的研发团队和高素质的管理团队来共同完成，该团队有着多年项目开发经验的积累，能及时管控项目的进度，把握项目实施质量。同时，公司具有一套完整的项目开发流程，能准确把握项目信息和实施进程，及时解决开发过程中出现的各种问题。

本项目的实施将严格遵循开发流程，加强管理和流程控制，确保顺利实施。因此，从管理上来看，本项目是可行的。

3、投资方案概述

根据项目规划，圣邦股份公司已租赁北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心第三座 13 层（1301-1307 室），总面积 1423.18 平方米，将其中的 523.18 平方米经适当装修改造后，用于本项目建设。

（1）项目建设内容

本项目拟实施电源管理类模拟芯片的开发及产业化，主要集中研究和开发电源管理类系列芯片。根据当今模拟集成电路高效率、低功耗、小封装、高抗干扰能力等发展趋势及市场需求，强化公司在电源管理类模拟芯片的技术深度和技术积累程度，在线性稳压器技术、开关型电源转换器技术、锂电池充电管理技术、LED 背光驱动器技术、LED 闪光灯驱动器技术、MOSFET 驱动技术、负载开关技术、OVP 过压保护技术、高抗干扰能力、高静电防护能力、小型封装等方面取得技术突破，形成一批具有世界先进水平的电源管理类模拟集成电路产品并实现产业化。

（2）项目实施进度

本项目建设期为三年。建设期分为设备购置、研发人员招聘和电源管理类模拟芯片的开发任务，第四年进入电源管理类模拟芯片的生产和销售阶段。

（3）投资计划

本项目投资规模为 13,969 万元，拟由上市募集资金承担。项目第一年到第三年分别投入 4,192 万元、3,381 万元和 3,806 万元，具体资金用途如下表所示：

序号	费用名称	合计
一	工程费	1,894.06
1	房屋租赁费用	572.88
2	房屋装修费用	110.80
3	设备购置及安装费	1,210.38
二	工程建设其他费	34.41
三	预备费	154.28
四	开发投资	9,296.26
1	开发费用	4,851.47
1.1	模具	3,164.00
1.2	测试费	632.80
1.3	材料	1,054.67
2	开发人员薪酬	4,444.79
五	铺底流动资金	2,590.15
六	项目投资规模	13,969.16

（4）拟购置设备基本情况

电源管理类模拟芯片开发及产业化项目拟购置设备主要包括台式示波器、全自动静电测试系统、探针测试台等。

序号	设备名称	数量	单价（万元）	总计（万元）	其中：增值税（万元）
1	台式示波器	10	15	150	21.79
2	高性能示波器	5	13	65	9.44
3	全自动静电测试系统	1	125	125	18.16
4	探针测试台 Probe Station	1	100.9	100.9	14.66
5	自动测试机台	4	56	224	32.55
6	NI PXI 自动测试机	5	15	75	10.90
7	其他			347.25	50.46
	合计			1,087.15	157.96

（二）信号链类模拟芯片开发及产业化项目

1、项目背景

本项目拟实施信号链类模拟芯片的开发及产业化，主要集中研究和开发信号链类系列芯片。根据当今模拟集成电路高速度、高精度、低功耗、小封装、抗干扰等发展趋势及市场需求，强化公司在信号链类模拟芯片的技术深度和技术积累程度，在高精度放大器技术、高速运放技术、微功耗放大器和比较器技术、高阶视频滤波技术、高抗干扰能力、高静电防护能力、小型封装等方面取得进一步的技术突破，形成一批具有世界先进水平的信号链类模拟集成电路产品并实现产业化。

2、项目的可行性

（1）技术可行

公司自成立以来，一直具有很强的研发能力。在本项目开发过程中，公司将严格遵循项目开发流程，加强对项目进程的管理和控制，同时增加相关技术人员数量，从技术上确保项目的顺利实施。

目前，公司在模拟集成电路技术和产品研发方面具有较好的基础，已经具备信号链类模拟集成电路系列芯片产品的研发和技术储备，为高性能模拟集成电路系列产品的开发打下了良好的技术基础。

因此，从技术上来看，本项目是可行的。

（2）财务可行

从资金来源上看，本项目所需资金全部由募股资金来解决，因而从资金来源上是有保证的。从市场前景来看，本项目产品属于高性能模拟集成电路产品，市场前景广阔，有很强的抗风险能力，经济效益良好。从核心技术攻关来看，其核心技术研发能弥补高性能集成电路技术长期被国外垄断的局面，能够为高端产品研发助力，有利于促进我国集成电路的发展。

因此，从财务上来看，本项目是可行的。

（3）管理可行

本项目将由专业的研发团队和高素质的管理团队来共同完成，凭借他们多年

积累的项目开发经验，能及时管控项目的进度，把握项目实施质量。同时，公司具有一套完整的项目开发流程，能准确把握项目信息和实施进程，及时解决开发过程中出现的各种问题。

本项目的实施将严格遵循开发流程，加强管理和流程控制，确保顺利实施。因此，从管理上来看，本项目是可行的。

3、投资方案概述

本项目建设地点位于北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心第三座 13 层（1301-1307 室），总面积为 1423.18 平方米，将其中的 600 平方米经适当装修改造后，用于本项目建设。

（1）项目建设内容

信号链模拟芯片研究开发能力建设。租赁办公场地 600 平方米，进行适当装修改造，主要装修内容为：吊顶、铺设防静电地面，墙面粉刷等。购置信号链模拟芯片研究开发所必须的仪器设备（包括软件）276 台（套），硬件设备主要包括：技术研究设备、检测试验仪器、研发设备和适合的环境配置设备等；软件主要包括：实验室的专业试验、检测设备和分析软件等，还包括研发工具、办公软件等软件。平均增加研发相关人员 70 名，提高信号链模拟芯片研究开发能力。在研发产品的基础上,通过将芯片的晶圆生产外包给晶圆厂、将芯片的封装测试外包给封装测试商的生产外包的形式扩大公司芯片生产规模并产业化。

（2）项目实施进度

本项目建设期为三年。建设期分为设备购置、研发人员招聘和信号链类模拟芯片的开发任务，第四年进入信号链模拟芯片的生产和销售阶段。

（3）投资计划

本项目投资规模为 14,399 万元，拟由上市募集资金承担。项目第一年到第三年分别投入 4,517 万元、3,509 万元、4,304 万元，具体资金用途如下表所示：

序号	费用名称	合计
一	工程费	2,190.42
1	房屋租赁费用	657.00

2	房屋装修费用	120.00
3	设备购置及安装费	1,413.42
二	工程建设其他费	38.86
三	预备费	178.34
四	开发投资	9,922.25
1	开发费用	4,416.00
1.1	模具	2,880.00
1.2	测试费	576.00
1.3	材料	960.00
2	开发人员薪酬	5,506.25
五	铺底流动资金	2,068.95
六	项目投资规模	14,398.81

（4）拟购置设备基本情况

信号链类模拟芯片开发及产业化项目拟购置设备主要包括高性能服务器、台式示波器、视频分析仪、全自动静电测试系统、探针测试台、自动测试机台等。

（三）研发中心建设项目

1、项目背景

作为一家高新技术企业，圣邦股份公司高度重视技术研发，目前已连续研发出了线性稳压器技术、LED 驱动器技术、锂电池充电器技术、微处理器监控电路技术、高性能运算放大器技术等多项核心技术，开发出了数百种产品并取得了良好的销售业绩。

随着信息技术及其产业的迅速发展，特别是微电子技术的日新月异，这对处在 3C（计算机、网络通信和消费类电子）应用领域占有重要地位的模拟集成电路提出了高性能、低功耗、高抗干扰能力、小封装等更高的性能和技术要求。而高性能模拟芯片的设计不仅要求有丰富的设计经验和技能，同时还要有高度自动化的电子设计环境和完善的元器件库，必须考虑到电磁干扰（EMI）、电源干扰、静电干扰等干扰因素。因此，作为微电子技术的核心之一，模拟集成电路设计将更加趋向于高信噪比（SNR）、高电源抑制比（PSRR）、低失真、高 ESD 保护能力、高可靠性和高稳定性等技术趋势。

2、项目的可行性

（1）公司具有良好的研发基础

公司自成立以来，一直非常重视设计研发，取得了显著成绩，获得了诸多荣誉，即 2009 年荣获“国家高新技术企业”、“中关村高新技术企业”及“海淀创新企业”称号，2010 年荣获“集成电路设计企业”称号，2012 年荣获“2011 中关村新锐百强企业”、“2011 中关村高成长企业 TOP100”称号，并获得了“2011 年度北京市科学技术进步二等奖”、“2013 年度北京市科学技术奖三等奖”、“北京市设计创新中心”、“北京市专利试点企业”、“海淀区 2014-2015 年度重点企业”等荣誉。公司历年来及时根据市场反馈持续地对既有产品进行技术改造，同时也十分注重新平台、新功能的研究开发。多年的研发经验及追求创新的研发理念是公司产品不断进步和提高客户满意度的重要保障。公司技术水平在行业内处于领先地位，为项目建设奠定了有力基础。

（2）公司重视新技术与产品的研发，科研成果转化

公司一直以技术进步和研发创新为持续发展的根本，通过大力研发投入支持新技术和产品的研发，同时公司也非常注重科研成果转化，截止到 2015 年 6 月，公司已获得集成电路布图证书 64 项，已授权的发明专利 8 项，已授权的实用新型专利 11 项，另有 15 项发明专利正在申请中并已通过初审。

（3）建立积极的研发创新激励机制

为让理念真正落实到对研发人员的物质与精神奖励上，公司制定了一套较为合理、完善的研发人员奖励制度。通过对技术研发创新体系和制度的不断完善，公司创造了一个良好的技术研发创新环境，并形成一种尊重知识、尊重人才、崇尚创新的文化环境和氛围，为本项目的开展奠定了良好的基础。

3、投资方案概述

根据项目规划，圣邦股份公司已租赁北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心第三座 13 层（1301-1307 室），总面积为 1423.18 平方米，并规划 300 平方米，经相应配套装修后，用于本研发中心建设。

（1）项目建设内容

本项目主要是建设 3 个技术实验室，各实验室具体研发内容及方案如下：

模拟芯片设计技术实验室。致力于高性能模拟集成电路芯片设计、生产、封

装及测试相关技术的研究与开发，特别是针对采用高电压（10 伏以上）工艺的模拟芯片产品的研发及降低芯片整体功耗等前沿技术的研究。本实验室将与晶圆厂以及封测厂商紧密合作，掌握高压模拟集成电路工艺技术特点，同时通过一系列具体的高压模拟集成电路产品的研发，熟悉、掌握、建立和完善高压模拟集成电路设计、生产、封装测试的完整过程，为高压模拟集成电路产品的批量开发和产业化奠定基础。

模拟芯片专用 EDA（Electronic Design Automation 电子设计自动化）技术实验室。从事对高性能 CMOS 模拟集成电路设计起到核心支持和保障作用的自动化电子设计软硬件环境以及各种元器件和封装模型库的建设和完善。特别是在已有的通用集成电路 EDA 软件的基础上针对公司的高性能 CMOS 模拟集成电路设计的特点和需求进行改造和升级。

模拟芯片质量和可靠性技术实验室。在现有可靠性基础上进一步深化和拓展与芯片质量和可靠性相关的各项研发，特别是有关 CMOS 模拟集成电路 ESD 保护电路的原理和性能提升等相关的研究和技术开发。本实验室在对研究并结合实际产品进行流片和测试后，通过理论和经验相结合的反复试验和验证，积累经验并掌握提高 ESD 保护电路效果的技术与方法。同时还可以承担部分芯片失效分析论证工作。

同时，根据项目规划，本项目拟购置硬件设备 135 台（套）、软件 46 套。

（2）项目的实施进度

项目建设周期为 3 年。第 1 年，主要是根据研发任务要求配置研发场地，购置必要的研发硬件、软件，招募研发人才，开展相关技术调研，建立研发初步方案。第 2 年，按照既定的研发任务全面深入展开研发工作，优化技术研发路径，攻克相关技术难点，适度开展对外技术合作。第 3 年，按计划继续完成全部研发任务，申请技术专利，实现研发目标。

（3）投资计划

根据项目进度计划安排，项目第 1 年投入 2,077 万元，第 2 年投入 1,890 万元，第 3 年投入 2,132 万元，具体资金用途如下表所示：

序号	费用名称	合计
一	工程费	1,287.69
1	房屋租赁费用	328.50
2	房屋装修费用	75.00
3	设备购置及安装费	884.19
二	工程建设其他费	25.32
三	预备费	105.04
四	开发投资	4,681.00
1	开发费用	1,380.00
1.1	模具	900.00
1.2	测试费	180.00
1.3	材料	300.00
2	开发人员薪酬	3,301.00
五	项目投资规模	6,099.04

第十一节 其他重要事项

一、重要合同

截至2015年6月30日，公司已签署的、对公司的生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的正在履行的合同如下：

（一）销售合同

报告期内，公司与北高智、茂晶等主要经销商签订了经销商授权协议，授权经销商在规定范围内进行产品销售，在该等协议下，经销商根据下游需求向公司发出订单，公司根据订单数量安排发货。该等经销商授权协议为长期协议，如合同任意一方未提出终止，则合同有效期限自动延展。

序号	合同签订对方	经销商品范围	合同生效日
1	新得利电子零件有限公司 深圳市新得时利电子科技有限公司	集成电路产品	2012-06-01
2	科通国际（香港）有限公司 科通通信技术（深圳）有限公司	集成电路产品	2012-06-01
3	棋港电子有限公司	集成电路产品	2012-06-01
4	赛博联电子有限公司 深圳市赛博联电子有限公司	集成电路产品	2012-06-01
5	丰宝贸易香港有限公司 上海市丰宝电子信息科技有限公司	集成电路产品	2012-06-01
6	北高智科技有限公司 深圳市北高智电子有限公司	集成电路产品	2012-06-01
7	威健实业国际有限公司 威健国际贸易（上海）有限公司	集成电路产品	2012-06-01
8	帕太集团有限公司 帕太国际贸易（上海）有限公司	集成电路产品	2012-06-01
9	迈亿科技有限公司	集成电路产品	2012-06-01
10	茂纶股份有限公司	集成电路产品	2012-06-01
11	茂晶有限公司 深圳茂晶骏龙有限公司	集成电路产品	2012-06-01

（二）采购合同

报告期内，公司与台积电签订了关于晶圆供应的长期框架协议，根据订单要求向公司供应晶圆。

序号	货物名称	供货方	合同签署日
1	晶圆和其他服务	台湾积体电路制造股份有限公司	2012年

公司与成都宇芯、通富微电等主要供应商签订了长期框架协议，提供晶圆并根据实际需求向供应商发出订单，由封装厂进行封装测试，并根据公司要求发货。

序号	供货内容	供货方	签约主体	合同签署日	履行期限
1	封装测试	宇芯（成都）集成电路封装测试	圣邦股份、香港圣邦	2012-12-04	2012年12月4日起两年，到期自动延期两年
2	封装测试	南通富士通微电子有限公司	圣邦股份	2012-07-27	2012年7月27日起两年，到期自动延期两年
3	封装测试	江苏长电科技股份有限公司	香港圣邦	2014-08-01	2014年8月5日起一年
4	封装测试	江苏长电科技股份有限公司	圣邦股份	2014-08-01	2014年8月26日起一年，到期自动延展一年
5	封装测试	江阴长电先进封装有限公司	圣邦股份、香港圣邦	2012-08-10	2012年8月10日起三年

（三）借款合同

2014年12月5日，圣邦微电子与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签署《最高额融资合同》，合同约定自2014年12月5日至2015年12月5日，圣邦微电子可申请使用的最高融资额度为人民币100万元，同时由华夏银行股份有限公司北京中关村支行与公司实际控制人张世龙签订《个人最高额保证合同》对此融资合同进行担保。

2014年12月19日，圣邦微电子与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签署《流动资金借款合同》，借款金额为人民币100万元，借款期限自2014年12月22日至2015年12月22日，该笔借款已于2015年8月12日提前偿还。

（四）担保合同

2014年12月5日，公司实际控制人张世龙与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签署《个人最高额保证合同》，合同约定为编号YYB27（融资）20140075

的《最高额融资合同》担保，担保的最高债权额为人民币100万元，涉及的借款已于2015年8月12日偿还。

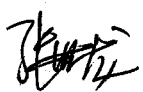
报告期内，公司不存在对外担保的情况。

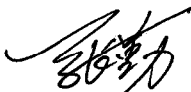
第十二节 有关声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

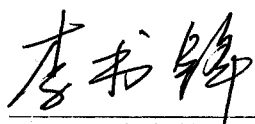
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

本公司全体董事签名：


张世龙

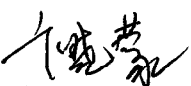

张勤


林林


李书锋


王涌

本公司全体监事签名：

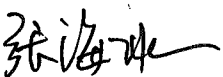

卞晓蒙

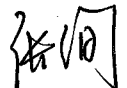

赵媛媛


刘明

本公司除董事、监事以外的全体高级管理人员签名：


林明安


张海冰

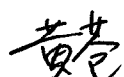

张绚



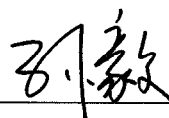
二、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

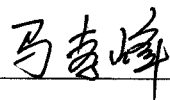


黄 苍



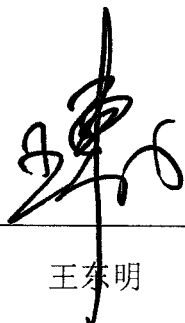
孙 毅

项目协办人：

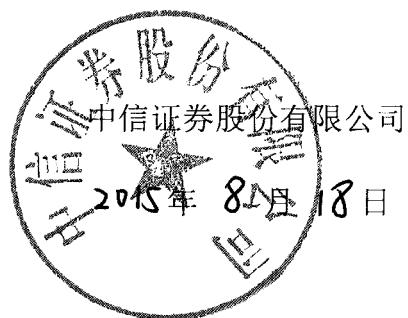


马孝峰

法定代表人：



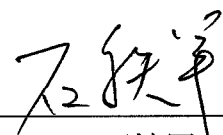
王东明

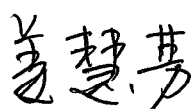


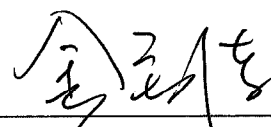
三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

经办律师：

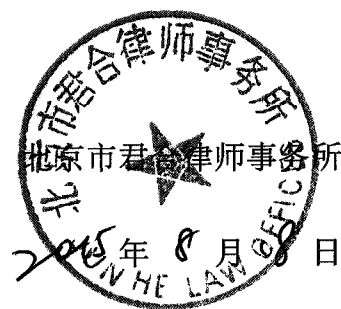

石铁军


姜慧芳


金劬劬

律师事务所负责人：

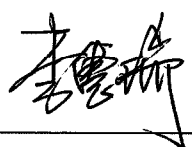

肖微



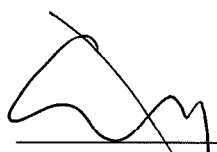
四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：


李惠琦
傅智勇

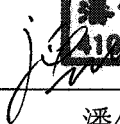
会计师事务所负责人：

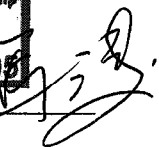

徐华

五、资产评估机构声明

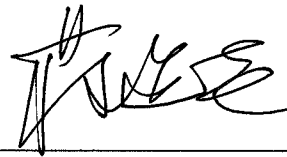
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师：


中国注册
资产评估师
潘仕文
41070064
潘仕文


中国注册
资产评估师
马涛
13000003
马涛

资产评估机构负责人：

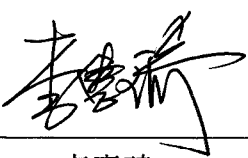
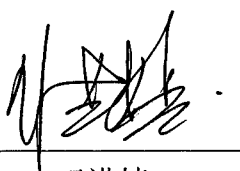

蒋建英



六、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

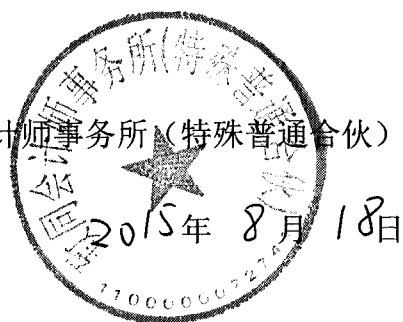
经办注册会计师：


李惠琦
王洪婕

验资机构负责人：


徐华

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



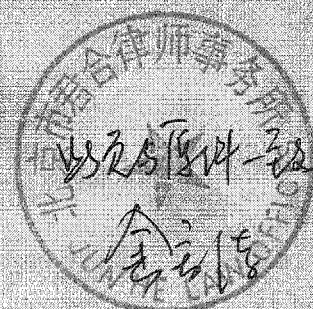
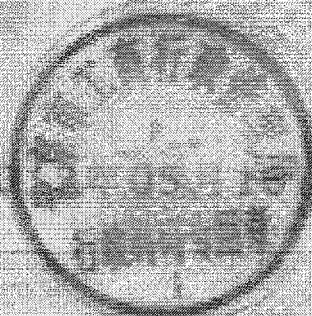
名称变更通知

京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）

京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年5

月16日经我办核准，名称变更为京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）

特此通知



第十三节 附 件

一、备查文件

- （一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；
- （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；
- （三）发行人控股股东和实际控制人对招股说明书的确认意见；
- （四）财务报表及审计报告；
- （五）内部控制鉴证报告；
- （六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （七）法律意见书及律师工作报告；
- （八）公司章程（草案）；
- （九）中国证监会核准本次发行的文件；
- （十）其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅时间

工作日上午：09:30 - 11:30 下午：13:30 - 16:30

三、文件查阅地址

发行人：圣邦微电子（北京）股份有限公司

地 址：北京市海淀区西三环北路 72 号院 B 座 1608 房间

电 话：010-51799720 传 真：010-51798175

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

地 址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

电 话：010-60838709 传 真：010-60836960